

**| GESCHÄFTSBERICHT 2003**

## DIE GESCHÄFTSJAHRE 2002 UND 2003 AUF EINEN BLICK

| Millionen Euro                   | 2002  | 2003   |
|----------------------------------|-------|--------|
| Auftragseingang netto            | 104,5 | 101,0  |
| Auftragsbestand netto            | 32,4  | 33,9   |
| Nettoumsatz                      | 127,5 | 92,6   |
| Eigenkapital                     | 118,5 | 102,4  |
| Eigenkapitalquote                | 68%   | 64%    |
| Net Cash                         | 13,4  | 23,6   |
| Free Cash Flow                   | -0,1  | 4,5    |
| Rohertrag nach Umgliederungen    | 47,9  | 36,4   |
| Rohertragsmarge                  | 37,6% | 39,4%  |
| EBITDA                           | -9,4  | -11,0  |
| EBITDA-Marge                     | -7,4% | -11,9% |
| EAT (Ergebnis nach Steuern)      | -8,9  | -14,6  |
| EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro) | -0,60 | -0,97  |
| Anzahl der Mitarbeiter           | 878   | 716    |

## **| INHALT**

**Editorial** 4

**Bericht des Aufsichtsrats** 8

**1. Highlights 2003** 10

**2. Neue Technologien** 12

**3. Produktlinien** 18

**4. Starke Partnerschaften** 27

**5. Investor Relations** 30

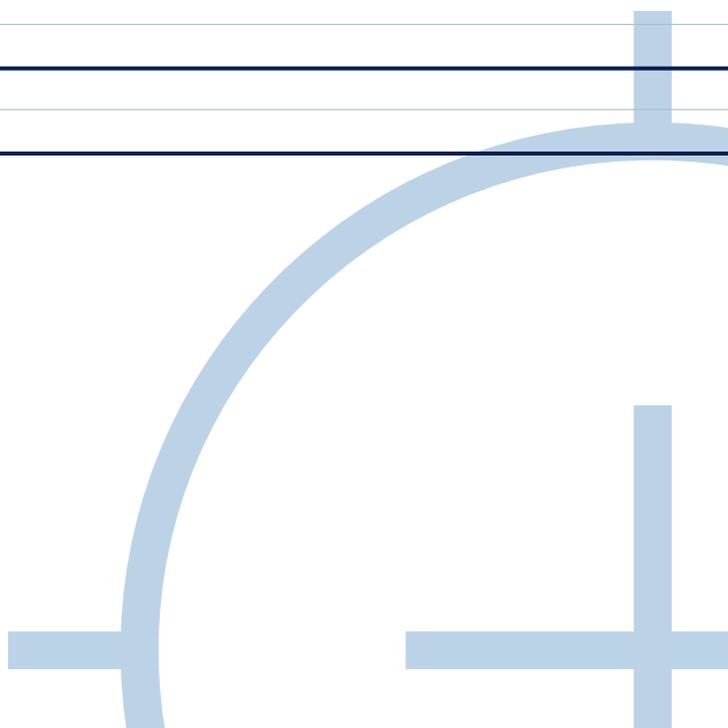
**Corporate Governance** 33

**Konzernlagebericht und Lagebericht** 34

**Konzernabschluss** 52

**Konzernanhang** 60

**Bestätigungsvermerk** 91



## EDITORIAL

### **Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,**

die mittlerweile viel zitierte Halbleiterkrise hat 2002 und leider auch 2003 tiefe Spuren hinterlassen. Zwar waren wir ursprünglich für das erste Halbjahr 2003 nicht optimistisch, erwarteten aber – ohne dabei euphorisch gewesen zu sein – für das zweite Halbjahr zumindest eine leichte Belebung des Geschäfts. Letztendlich war aber auch das zweite Halbjahr enttäuschend, wobei insbesondere das vierte Quartal weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist.

Dies drückt sich auch in den Zahlen für 2003 aus, die nochmals deutlich unter das Niveau von 2002 gefallen sind. Der Umsatz ging um weitere 27% von 127,5 Mio. Euro auf 92,6 Mio. Euro zurück; hier setzte der Verfall des US-Dollars gegenüber dem Euro zu einem für uns denkbar ungünstigen Zeitpunkt ein. In der Folge verschlechterte sich das EBIT um 0,7 Mio. Euro auf -17,1 Mio. Euro, so dass sich unsere Restrukturierungsmaßnahmen aus 2002 sowie der weitere Mitarbeiterabbau im Frühjahr 2003 aufgrund des Umsatzrückgangs letztendlich nicht im Ergebnis niederschlagen konnten.

Vor dem Hintergrund der Ergebniserwartung haben wir 2003 unser Hauptaugenmerk auf den Cash Flow gerichtet, wo wir unser kommuniziertes Ziel – einen zumindest ausgeglichenen Free Cash Flow (operativer Cash Flow abzüglich Investitionen) – erreichten. Wir sind der Ansicht, dass es in derartigen Phasen unserer Industrie von

höchster Bedeutung ist, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten und zu sichern. Aus diesem Grund haben wir auch im November 2003 die Wandel- und Optionsanleihe begeben, um ausreichende finanzielle Ressourcen für die kommende Geschäftsbelebung bereitzustellen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Ergebnisse in der Halbleiterindustrie immer eine Berg- und Talfahrt darstellen – sie ist wohl die Industrie mit den ausgeprägtesten Zyklen; und es nicht ersichtlich, dass dies künftig anders wird. Üblicherweise geht jedem Aufschwung eine Anschubfinanzierung voraus, in der die notwendigen Produkte hergestellt werden. Hier spüren wir eine Veränderung im Kundenverhalten. Während in der Vergangenheit bei Auslastungsgraden von etwa 85% Erweitungsinvestitionen getätigt wurden, verschiebt sich dieser Grenzwert auf deutlich über 90%. So verkürzt der Kunde die Liefertermine, was für die Zulieferer – also auch SÜSS MicroTec – eine weitere Herausforderung darstellt, da so das Investitionsrisiko verstärkt auf uns abgewälzt wird. Hier ermöglicht nur ein enger Kontakt zum Kunden eine realistische Einschätzung der Situation und eine gute Disposition in der Produktion. Unser Ziel ist es, diese Problematik so zu lösen, dass wir einerseits nicht die Risiken einer zu hohen kapitalbindenden Vorproduktion tragen müssen und andererseits den Kunden akzeptable Lieferzeiten anbieten können.

Die Prognosen unserer Kunden, führender Research Institute, Analysten und der Fachpresse geben Anlass

zur Erwartung, dass im laufenden Geschäftsjahr 2004 die von den Halbleiterindustrie-Zulieferern nahezu herbeigesehnte nachhaltige Erholung eintritt. Auch die veröffentlichten Zahlen unserer Kunden bestätigen eine Geschäftsbelebung und erste Hersteller von Backend-Equipment spüren diese bereits jetzt. Die gesamte wirtschaftliche Situation und die Qualität dieser positiven Prognosen veranlasst uns zur Annahme, dass wir an diesem Aufschwung ebenfalls partizipieren werden.

Wir haben im äußerst schwierigen Marktumfeld der letzten zwei Jahre "den Kopf nicht in den Sand gesteckt", sondern diese Zeit intensiv zu Forschungs- und Entwicklungszwecken genutzt. Ziel war, durch die Erforschung neuer Technologien den äußerst anspruchsvollen Roadmaps unserer Industrie für die nächsten Jahre so weit wie möglich entgegen zu kommen und somit die technologische Positionierung unserer Produkte weiter zu verbessern. In 2003 brachten wir dann auch zwei bedeutende neue Technologien zur Marktreife:

- "SupraYield": Die erste Vollfeldbelichtung, die lithographisch Strukturen unter 1 Mikrometer darstellen kann – hiermit haben wir die wesentliche technologische Lücke unserer Mask Aligner zum Konkurrenzverfahren der Stepper geschlossen;

und

- "nanoPREP": Eine Innovation, die das direkte Verbinden von Wafern ohne Einsatz aufwendiger Vaku-

umverfahren bei niedrigen Temperaturen ermöglicht und mit der wir erfolgreich den wachsenden Bonder-Markt bedienen.

Diese beiden neuen Technologien treffen genau den Puls der Zeit: Mobile technische Geräte wie Laptop, Handy, Organizer werden unaufhaltsam kleiner und leistungsfähiger; die Anforderungen an technische Hilfsmittel wie Drucker, Sensoren für alle möglichen Funktionen immer größer; neue Technologien bei den Flachbildschirmen eröffnen große Potenziale auf dem Gebiet des Home Entertainments – alle diese Entwicklungen bedürfen neuer Produktionstechniken – denn sie sind mit den herkömmlichen Lösungen nicht mehr darstellbar.

"SupraYield" und "nanoPREP" werden diesen Anforderungen gerecht. Die Technologien resultieren unmittelbar aus unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden und zeigen, dass unser bereits seit Jahren verfolgter Ansatz der Applikationsarbeit richtig ist. Nur wenn man sich der technischen Herausforderungen der Kunden annimmt und sich diese zu Eigen macht, ist man in der Lage, den Bedarf des Kunden umfassend zu decken. Zu diesem Zweck haben wir in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Know-how über die verschiedenen relevanten Fertigungsprozesse aufgebaut. Gemeinsame Prozessentwicklungen und -weiterentwicklungen mit den Kunden führen bei positivem Entwicklungsergebnis zu einer sehr hohen Akzeptanz der dabei verwendeten Produktionsgeräte, was sich dann in der Regel auch erleichternd bei der Auftragsverhandlung auswirkt.

## I EDITORIAL

Für eine gute Anwendungsunterstützung bei unseren Kunden sind umfangreiche Informationen über die entsprechende Technologie und Training in den verschiedenen Arbeitsschritten unabdingbar. Das erste große Projekt einer derartigen Schulungsarbeit war SECAP (Semiconductor Equipment Consortium for Advanced Packaging), das sich aus Vorträgen über unsere Technologien bei Kunden, vor allem in Asien, entwickelte. Heute ist SECAP nahezu eine Institution und viele unserer Kunden wissen, dass sie mit Hilfe von SECAP ihr Prozessverständnis und damit die Fähigkeit, ihr Produktionsergebnis weiter zu optimieren, erheblich verbessern können. Seit April 2003 steht beispielsweise eine vollständige 300mm-Bumping-Linie für Advanced Packaging bei der Firma Unitive in Taiwan, die von anderen potenziellen Kunden als Demonstrations- oder Testlinie intensiv genutzt wird.

Aufgrund dieses Erfolgs haben wir im Frühjahr 2003 ein weiteres Konsortium gegründet. MEMUNITY ist das erste Test Forum für die Mikrosystemtechnik, ein SÜSS MicroTec-Markt, in dem wir großes Wachstumspotenzial sehen. In diesem Konsortium werden von einem Konsortialpartner angepasste Testverfahren für spezifische Mikrosysteme entwickelt, die in vielen Fällen eine erheblich kostengünstigere Produktion dieser Systeme ermöglicht. Nach Beauftragung durch den Kunden stellt SÜSS MicroTec speziell modifizierte Testgeräte zur Verfügung, die dann mit dem Entwicklungsergebnis in die Produktion beim Kunden integriert werden.

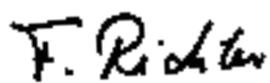
Insofern ist "Kundenintegration" für uns ein gelebtes Schlagwort. Das klassische Lieferanten - Kunden Verhältnis gibt es nicht mehr – stattdessen entstehen langfristige Partnerschaften, die sich nahezu unabhängig vom aktuellen Geschäft weiter entwickeln. Die Erhaltung und Vertiefung dieser Beziehungen erfordert nicht unerhebliche Ressourcen unsererseits. Auf den ersten Blick scheint es unverständlich, dass wir in 2003 verhältnismäßig hohe Entwicklungs- und Vertriebsaufwendungen ausweisen – jedoch würde eine auf kurzfristige Erfolge ausgerichtete Kostensparstrategie mittelfristig auch diese Partnerschaften und folglich auch das gesamte Geschäft negativ beeinflussen. Wir sind davon überzeugt, dass sich unser Ansatz, dem Kunden als kompetenter und verlässlicher Partner auch in schwierigen Zeiten zur Verfügung zu stehen, letztendlich – im wahren Sinne des Wortes – auszahlt. Aufgrund dieser Strategie sowie der derzeitigen Gesamtsituation – Marktverfassung, Technologien, Wettbewerb, Chancen und Risiken – erwarten wir für das Gesamtjahr 2004 ein Wachstum des Auftragseingangs um etwa 20%.

Auf den nächsten Seiten werden die neuen Technologien, unsere Produkte und unsere Märkte ausführlich dargestellt.

Zu guter Letzt möchten wir uns bei unseren Aktionären für das Vertrauen bedanken, dass Sie dem Management und dem Unternehmen SÜSS MicroTec in den letzten Jahren entgegen gebracht haben. Wir sind uns bewusst, dass der Kursverlauf der SÜSS MicroTec-

Aktien zwar Gewinnchancen bot, aber eben auch Potenzial für große Verluste hatte. Wir wissen, dass viele Aktionäre mit uns durch dieses Tal gegangen sind und wissen dies zu schätzen.

Garching, im März 2004



Dr. Franz Richter  
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak  
Vorstand Finanzen



## **BERICHT DES AUFSICHTSRATS**

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2003 regelmäßig durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in fünf gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und des SÜSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands auch dahingehend überwacht, dass Abweichungen des tatsächlichen Geschäftsverlaufs von der Planung unter Angabe ihrer Gründe ausführlich mit dem Vorstand erörtert wurden. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken unterrichtet.

Zum 01. April 2003 hat der Aufsichtsrat Herrn Stephan Schulak zum ordentlichen Mitglied des Vorstands bestellt.

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats, dem die Herren Dr. Süss als Vorsitzender sowie Schlytter-Henrichsen und Görtz als Mitglieder angehören, hat sich in einer Sitzung mit Personalangelegenheiten des Vorstands befasst, die Entscheidungen des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten vorbereitet und dem Gesamtaufsichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen berichtet.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2003, hat der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss eingesetzt und die Aufgaben des gleichzeitig aufgelösten bisherigen Finanzausschusses ebenfalls dem Prüfungsausschuss zugewiesen, mit dessen Vorsitz Herr Schlytter-Henrichsen beauftragt wurde. Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind die Herren Prof. Dr. Heuberger, Dr. Schücking und Dr. Süss. Dieser Ausschuss hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in zwei Sitzungen mit Fragen aus folgenden Bereichen:

- Auftrag an den Abschlussprüfer;
- Unabhängigkeit Abschlussprüfers;
- Verfügung des Abschlussprüfers;
- Maßnahmen zur Anpassung an das rückläufige Geschäftsvolumen;
- Finanzierung der SÜSS MicroTec-Gruppe;
- Begebung einer Wandelanleihe

befasst, die Entscheidungen des Gesamtaufsichtsrats zu diesen Fragen vorbereitet und den Gesamtaufsichtsrat über das Ergebnis seiner Beratungen unterrichtet.

In seiner Sitzung vom 24. November 2003 hat der Aufsichtsrat die Effizienz seiner Tätigkeit überprüft.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003, der nach den als US-GAAP bezeichneten Bilanzierungsregeln der Vereinigten Staaten von Amerika

aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2003, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2003 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, die PriceWaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

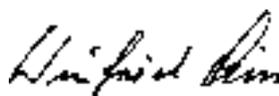
Auf der Grundlage einer entsprechenden Vorbereitung durch seinen Prüfungsausschuss hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2003 sowie den gemäß § 292 a des Handelsgesetzbuchs nach US-GAAP aufgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2003, den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2003 geprüft. An der Verhandlung des Aufsichtsrats über die genannten Vorlagen haben die beiden zuständigen Wirtschaftsprüfer des Abschlussprüfers teilgenommen. Sie haben dem Aufsichtsrat mündlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Abschlussprüfers mit den Vertretern des Abschlussprüfers und dem Vorstand erörtert und die Vorlagen gebilligt. Der Aufsichtsrat erklärt hiermit, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung gegen die von ihm geprüften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch die Prüfungsberichte des

Abschlussprüfers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2003 ist damit festgestellt. Mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2003 ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften für ihren Einsatz für die Gesellschaft und den SÜSS MicroTec-Konzern im schwierigen Geschäftsjahr 2003, das ihnen ein weiteres Mal erhebliche Flexibilität zur Anpassung an ein sehr schwieriges wirtschaftliches Umfeld abverlangt hat.

Garching, im März 2004

Der Aufsichtsrat



Dr. Winfried Süß  
Vorsitzender

## 1. HIGHLIGHTS 2003

### **Neue Technologien für beste Endprodukte**

Im Geschäftsjahr 2003 entwickelte SÜSS MicroTec zwei weltweit einzigartige Technologien: Die „SupraYield“- und „nanoPREP“-Technologie setzen neue technologische Standards bei den Herstellungsverfahren in der Halbleiterfertigung. Durch ihren Einsatz wird die Produktion unserer modernen Informationstechnologien einfacher, effektiver und deutlich günstiger. „SupraYield“ und „nanoPREP“ kommen bei unterschiedlichen Standardverfahren in der Chipherstellung zum Einsatz: „SupraYield“ bei der Photolithografie – der Belichtung von kleinsten Strukturen auf dem Wafer; „nanoPREP“ beim so genannten Bonden – dem Verbindungsprozess von zwei oder mehreren Wafern.

Beide Neuentwicklungen sind in bestehende SÜSS MicroTec-Produktlinien integrierbar und tragen zu einer verbesserten Positionierung gegenüber Wettbewerbssequipment bei. Kunden profitieren bei beiden Technologien von den reduzierten Produktionskosten (Cost of Ownership). SÜSS MicroTec hat durch die erfolgreiche Einführung von „SupraYield“ und „nanoPREP“ seine Position als Kostenführer in den bearbeiteten Marktnischen weiter gefestigt und den Wettbewerbsvorsprung weiter ausgebaut.

Detaillierte Informationen zu „SupraYield“ und „nanoPREP“ finden Sie in Kapitel 2 (Neue Technolo-

gien) auf Seite 12. Anschließend informiert Kapitel 3 (Equipment für höchste Ansprüche) über die SÜSS MicroTec-Produkte und zusätzliche neue Produktentwicklungen.

### **Große Partner für kleinste „Welten“**

Leistungsfähige Mikrosysteme werden heute Schritt für Schritt weiter erforscht und entwickelt. Noch gibt es in der vielfältigen „Miniwelt“ viele Einsatzbereiche, die erst erprobt werden müssen bevor sie uns innovativen Nutzen bringen. SÜSS MicroTec gründete deshalb 2003 MEMUNITY – das erste Test Forum für Mikrosystemtechnik. Mit MEMUNITY (steht für „The MEMS Test Community“) können Mikrosystem-Hersteller erstmals anwendungsspezifische Testverfahren für unterschiedliche Mikrosysteme entwickeln und erproben. MEMUNITY berät und unterstützt die Hersteller – und intensiviert gemeinsam mit Ihnen die Forschung in diesem Zukunftsmarkt. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Testverfahren vor und während der Produktion von Mikrosystemen. Das ist ein entscheidender Vorteil, weil fehlerhafte Mikrosysteme nun bereits in einer frühen Phase der Fertigung aussortiert werden können und somit die nachfolgenden Produktionsschritte und damit Produktionskosten für diese ohnehin fehlerhaften Systeme eingespart werden. Das laufende Testen in den verschiedenen Fertigungsphasen führt zu einer erheblichen Kostensenkung und damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil für SÜSS MicroTec-Kunden.

SÜSS MicroTec gründete MEMUNITY in Kooperation mit dem dänischen Test House DELTA. Der Hersteller von Laser Messsystemen Polytec, Deutschland, ist weiterer Partner. Nach der äußerst positiven Erfahrung mit dem SECAP-Konsortium für Advanced Packaging setzt SÜSS MicroTec mit MEMUNITY diese Erfolgsstrategie auch für seinen zweiten Hauptmarkt Mikrosystemtechnik fort.

Ausführliche Informationen zu MEMUNITY und SECAP erhalten Sie auf Seite 27 (Kapitel 4).

### **Zufriedene Kunden durch erstklassigen Service**

Ein optimaler Service hat für SÜSS MicroTec oberste Priorität. Gerade in hoch spezialisierten Technologie-Bereichen muss sich der Kunde rund um die Uhr auf das Unternehmens-Know-how verlassen können. Umfrageergebnisse belegen: Der SÜSS MicroTec Kundenservice und -support war 2003 erneut erstklassig. Bei der jährlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit – durchgeführt vom namhaften, auf die Halbleiterbranche spezialisierten, Marktforschungsinstitut VLSI-Research – erzielte SÜSS MicroTec in vier Kategorien Spitzenplätze unter den Top 10. Damit schließt SÜSS MicroTec an das hervorragende Ergebnis vom Vorjahr an und bleibt auch im zehnten Jahr infolge eines der Halbleiterunternehmen mit den zufriedensten Kunden.

Für die Umfrage des „10 Best Annual Customer

Satisfaction Survey on Chip Making Equipment Suppliers“ versendete VLSI Research weltweit rund 43.000 Fragebögen an Entscheidungsträger in Halbleiterunternehmen. Die Bewertung der einzelnen Zulieferer in etwa zehn Kategorien gilt als exemplarisch für die Kunden-Lieferanten-Beziehungen in der Halbleiterbranche. Weitere Informationen zu den Ergebnissen erhalten Sie unter: [www.vlsi-research.com](http://www.vlsi-research.com).

### **Aktie wieder im Blue Chip-Index**

Die SÜSS MicroTec AG ist seit September 2003 im TecDAX gelistet – und gehört damit zu den 30 größten Technologiewerten des Börsensegments Prime Standard. Der Sprung in den wichtigen Auswahlindex gelang SÜSS MicroTec durch eine kontinuierliche Kurssteigerung. Das in 2002 verlorene Anlegervertrauen konnte zurückgewonnen werden, was einen erfreulich positiven Kursverlauf bewirkte.

Ausführliche Informationen über Investor Relations erhalten Sie auf Seite 30 (Kapitel 5).

## 2. NEUE TECHNOLOGIEN

### Technologien für unsere Zukunft

Vor rund 20 Jahren bestand unser „High Tech“-Alltag meist aus Telefon, Fernseher und Kassettenrekorder. Alles war groß und recht klobig, bestand aus endlosen Drähten aber dafür wenigen Funktionen. Die einfachen Technologien von damals haben sich heute zu ausgefeilten, hochkomplexen Systemen entwickelt. Sie sind täglich präsent – aber wir nehmen ihre Existenz kaum noch wahr. Der Griff zum Computer, elektronischem Notizbuch oder Handy ist selbstverständlich und erfolgt fast automatisiert. Und die „technologische Reise“ geht ungebremst weiter: Alles wird kleiner, leistungsfähiger, vielseitiger – und immer unsichtbarer. Mikrosysteme und neue Verbindungstechnologien für Chips ermöglichen uns schon heute eine intelligente, vernetzte Umgebung und Umwelt. Ob in der Medizin, Umwelttechnik, im Automobil oder einfach zu Hause: Technische Innovationen unterstützen uns und machen unser Leben in vieler Hinsicht sicherer. Die Frage, wie das alles so schnell geschehen kann, führt zu der nächsten Frage, welches Potenzial die Zukunft bezüglich weiterer Entwicklungen in sich birgt und somit in einen weiteren technologischen Bereich: In die „Technologie hinter der Technologie“ – den vielschichtigen Bereich der Hochtechnologie von SÜSS MicroTec.

In den Märkten von SÜSS MicroTec liegt das Potenzial für unsere weitere Zukunft. Besonders die beiden Hauptmärkte von SÜSS MicroTec stehen hierbei im Blickpunkt: Advanced Packaging – die wegweisende

Verbindungstechnologie für alle Chipgenerationen – und Mikrosystemtechnik – die Verarbeitung von „Mikrowelten“ für kleinste technische Anwendungen. Nur wenn Produktionsprozesse in diesen Märkten optimiert werden, können wir von neuen „intelligenten“ Technologien profitieren.

Im Geschäftsjahr 2003 führte SÜSS MicroTec neue Technologien in den Markt ein, die die Produktionskosten in beiden wichtigen Märkten – Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik – entscheidend senken. Das Interesse von Kunden an den neuen Technologien ist groß. Einige führende Unternehmen der Halbleiterbranche nutzen bereits die Vorteile von „SupraYield“ oder „nanoPREP“.

Im Folgenden werden die SÜSS MicroTec-Innovationen und ihre Bedeutung für die Märkte detailliert erläutert. Darüber hinaus zeigt dann Kapitel 3 (Produktlinien) auf, in welchem SÜSS MicroTec-Equipment die Neuheiten eingesetzt werden.

### „SupraYield“ – Mehr Mikrochips bei sinkenden Kosten

Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine hat sich gewandelt. Was bis vor kurzem noch „harte Arbeit“ war, ist heute technologischer Spaß. Beispiel Computer: Einst waren wir froh, wenn simple Befehle umgesetzt werden konnten – heute übernehmen selbst einfache Geräte komplexe Steuerungsaufgaben des

täglichen Lebens. Hinter diesem Wandel steckt umfassende technologische Entwicklungsarbeit. Im Bereich Informationstechnologie sind fortschrittliche Produkte erst durch das Advanced Packaging-Verfahren möglich. Diese neuartige Verbindungstechnik für Halbleiterbausteine erhöht die Anschlussdichte der Chips deutlich und führt so zu immer kleineren elektronischen Geräten mit steigender Funktionalität und Leistung.

Bevor diese neue Verbindungstechnik in die Endprodukte gelangt, wird sie in einer Vielzahl technischer Fertigungsschritte hergestellt. Und genau hier setzt die neue „SupraYield“-Technologie von SÜSS MicroTec an. Der Name unterstreicht das Ziel: „Yield“ – die Ausbeute – ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden. Die „SupraYield“-Technologie setzt sich so die maximale Ausbeute an leistungsstarken Chips zum Ziel. Dazu unterstützt sie einen der wesentlichen Fertigungsschritte im Rahmen des Advanced Packaging-Verfahren – das sogenannte Wafer-Bumping.

Beim Wafer-Bumping werden kleine Lotkügelchen zum späteren elektrischen Anschluss der Mikrochips auf jeden einzelnen Anschlusskontakt platziert. Dabei handelt es sich um eine sehr große Zahl mikroskopisch kleiner Kügelchen; so werden etwa eine halbe Millionen

Kügelchen mit einem Durchmesser von etwa 50 Mikrometer oder 50 Tausendstel Millimeter auf einen 300mm-Wafer gesetzt. Für diese diffizile Aufgabe kommt ein Fertigungsverfahren der Mikrosystemtechnik zum Einsatz. Mit Hilfe von Photolithografie werden kleine Formen auf jedem Anschlusskontakt erzeugt und anschließend mit Lötzinn gefüllt. Nach dem Entfernen des Formenmaterials bleiben dann die Lötzinn-Kügelchen auf den Anschlusskontakten der Mikrochips stehen.

Der intensivere Einblick in das Wafer-Bumping veranschaulicht die Bedeutung der neuen „SupraYield“-Anwendung für diesen Fertigungsschritt: Das Wafer-Bumping ist einer der letzten Fertigungsschritte bei der Halbleiterproduktion und steht am Anfang des Backend-Prozesses. In diesem Stadium hat der Wafer bereits einen beträchtlichen Wert; jeder Fehler bei der Fertigung lässt die Produktionskosten jetzt förmlich „explodieren“, da alle vorangegangenen Fertigungsschritte zur Herstellung der Mikrochips mit vernichtet werden. Im ersten Schritt des Wafer-Bumpings erhält der Wafer die Formen für die Metallaufbringung (Bump Mold). Dazu wird der Wafer mit dem „Formenmaterial“, einer photoempfindlichen Lackschicht („Photolack“ oder „Photoresist“) überzogen, die dann mit Hilfe der Photolithographie strukturiert werden kann.

Bei der Lithographie belichtet man einen Photolack oder Photoresist mit ultravioletttem Licht durch eine teilweise transparente Photomaske hindurch. Dadurch wird das Maskenbild in den Photoresist übertragen

## I 2. NEUE TECHNOLOGIEN

und erzeugt an den transparenten Stellen eine photochemische Veränderung in der Photoresist-Schicht. In einem anschließenden Entwicklungsschritt können diese photochemisch veränderten Bereiche aus der Photoresistschicht herausgelöst und damit die kleinen Formen erzeugt werden.

### MASKEN FÜR BESSERE STRUKTUREN

Für die Photolithografie ist der Einsatz verschiedener Belichtungsgeräte möglich. SÜSS MicroTec-Mask Aligner haben sich in den vergangenen Jahren als die kostengünstigsten Geräte für diesen Prozessschritt bewährt, weil die Strukturgrößen des Wafer-Bumpings ideal zur Lithografie mit Mask Alignern passen. Um dem fortlaufenden Trend zu immer kleineren Strukturgrößen gerecht zu werden und damit SÜSS MicroTec-Mask Aligner auch zukünftig die kostengünstigsten Produktionsmaschinen für diese Anwendung bleiben, wurde „SupraYield“ entwickelt. Mit Hilfe von „SupraYield“ können Mask Aligner auch kleinere Strukturen als bisher mit gewohnt hohem Yield produzieren.

Die Größe der Strukturen, die Mask Aligner übertragen, hängt von dem Abstand der Maske zum Wafer während der Belichtung ab. Je kleiner der gewählte Abstand, umso kleinere Strukturen lassen sich übertragen. Als praktische Grenze für Produktionsanwendungen haben sich etwa fünf Mikrometer erwiesen. Diese Grenze entsteht, wenn der Abstand sich so verkleinert, dass es aufgrund von Unebenheiten zu Berührungen zwischen

Maske und Wafer kommt. Jetzt ergeben sich Fehler, indem Teile des Photoresists an der Maske anhaften und vom Wafer abgerissen werden, wenn man nach der Belichtung Maske und Wafer wieder trennt.

Bei der „SupraYield“-Technik wird nun die Maske mit einer sehr dünnen Schicht eines teflonartigen Materials überzogen. Diese Schicht verändert die Oberflächeneigenschaften in einer Weise, dass Photoresist nicht mehr an der Maskenoberfläche anhaften kann. Berührungen sind nun nicht mehr schädlich und Belichtungen können jetzt selbst in flächigem Kontakt zwischen Maske und Wafer erfolgen. Dieser Belichtungsmodus erlaubt Strukturgrößen im Submikrometerbereich bis hinunter zu 0,5 bis 0,6 Mikrometer.

„SupraYield“ bietet SÜSS MicroTec-Kunden maßgebliche Wettbewerbsvorteile, indem die Ergebnisse einer komplexeren und damit teureren Projektionslithografie mit den kostengünstigeren Mask Alignern erreicht werden:

- eine Strukturauflösung bis zu 0,5 Mikrometer statt etwa 5 Mikrometer bei anderen Mask Alignern,
- ein deutlich höherer Yield gegenüber anderen Mask Alignern,
- ein deutlich höherer Durchsatz gegenüber Projektionslithographiesystemen wie Steppern durch die Belichtung der Wafer-Oberfläche in einem Schritt (Wafer-Vollfeldbelichtung) und
- bis zu 60% geringere Kosten für die Photolithografie im Vergleich zu Steppern.

„SupraYield“ ist als neue Photolithografie-Technologie Treiber für die weitere Kostenreduktion in der Produktion höher integrierter Mikrochips. Zudem erfüllt das Garching Unternehmen mit „SupraYield“ die aktuellen sowie bereits die künftigen Anforderungen der Halbleiterbranche nach weiterer Miniaturisierung der Strukturen auf dem Wafer. Selbst die ambitioniertesten Roadmap-Ziele der Industrie für die Zukunft erfüllt die „SupraYield“-Technologie bereits heute.

SÜSS MicroTec erweitert mit „SupraYield“ den bisherigen Anwendungsbereich der Mask Aligner-Lithografie maßgeblich hin zu kleineren Strukturen und setzt sich so einen großen „Schritt“ vom Wettbewerb ab. Neben dem wichtigen Advanced Packaging-Markt kommt „SupraYield“ auch in der Mikrosystemtechnik und bei den Compound Semiconductors (Verbindungshalbleiter) – insbesondere für Produkte, die in größerer Stückzahl hergestellt werden – zum Einsatz. Die Hersteller von Mikrochips und damit auch die Hersteller elektronischer Geräte können dank „SupraYield“ ihre Produktionskosten senken. Für uns als Verbraucher bedeutet „SupraYield“: Unser Traum-Handy, unsere digitale Wunsch-Kamera oder der begehrte Palm Top werden jetzt bei gleicher oder sogar höherer Leistungsfähigkeit günstiger.

### **„nanoPREP“ – Einfache Verbindungen für komplexe Mikrosysteme**

In den eigenen „vier Wänden“ fängt es bereits an: Hier wirken ausgefeilte Mikrosysteme etwa im CD-Player,

Drucker oder in Haushaltsgeräten. Sie garantieren auf kleinstem Raum vielfältigste Funktionen, extreme Leistungsfähigkeit und höchste Zuverlässigkeit unserer technischen Produkte. Deshalb finden sich innovative Mikrosysteme (MEMS) bereits in den verschiedensten Bereichen und Branchen. In Fahrzeugen etwa ermöglichen sie Aufprallsensoren oder Antiblockiersystem; in der Medizin Puls- und Sauerstoffsensoren und in Kippspiegel-Displays für Projektoren und TV-Anwendungen mit größeren Bildschirmen revolutionieren sie gerade das Gebiet „Home Entertainment“. Technische Entwicklungen die maximale Funktionalität und Raffinesse auf kleinstem Raum fordern, sind ohne Mikrosysteme heute undenkbar. Dadurch steigt der Bedarf nach den leistungsfähigen „Mikrowelten“ von Jahr zu Jahr – im Konsumenten- und im industriellen Bereich. Gefragt sind dabei Mikrosysteme, die immer komplexere Aufgaben meistern und immer weniger Platz dafür beanspruchen.

Eine der Schlüsseltechnologien bei der Herstellung von Mikrosystemen ist die Verbindung mikrosystemtechnischer Bauteile oder das Wafer-Bonden – wie ein Einblick in die technische Praxis verdeutlicht: Für die komplexen mikrotechnischen Applikationen werden mechanische Bauteile so konstruiert, dass sie in der Regel aus verschiedenen Ebenen aufgebaut sind. Die Fertigung dieser Bauteilebenen findet jeweils auf einem Silizium-Wafer statt. Anschließend werden die einzelnen Ebenen zu einem funktionierenden Mikrosystem zusammengesetzt (gebondet). Je nach Bauteil kann das Mikrosystem aus zwei, drei oder sogar mehr

## I 2. NEUE TECHNOLOGIEN

Ebenen bestehen. Um die Fertigungskosten möglichst gering zu halten, fertigt man auf einem Wafer je nach Bauteilgröße bis zu einige Hundert Mikrosysteme gleichzeitig. Auch das Verbinden oder Bonden der einzelnen Bauteile geschieht, solange die Bauteile noch auf dem Silizium-Wafer im Verbund sind. Erst danach wird das gebondete Waferpaket in einzelne Bauteile zersägt.

Ähnlich wie beim Packaging findet das Verbinden der einzelnen Bauteilebenen, also das Wafer-Bonden, am Ende der Fertigungskette statt. Alle Fertigungsschritte zum Herstellen der einzelnen Ebenen sind bereits durchlaufen und die Wafer haben mittlerweile einen beträchtlichen Produktionswert. Die letzten Schritte, wie die Verbindung der einzelnen Ebenen, sollten deshalb mit äußerster Präzision, sicher und schnell ablaufen: So werden die Funktionen der Mikrosysteme nicht beeinträchtigt, die bisherigen Arbeitsschritte bleiben erhalten und die Produktionskosten so niedrig wie möglich.

### TEMPERATUREN OHNE RISIKO

Als Verbindungsmethoden wurden in den letzten Jahren verschiedene Verfahren entwickelt. Als ideales Verfahren gilt das „Direkte Silizium Bonden“ – auch „Direct Wafer-Bonden“ genannt. Hierbei werden die kristallinen Wafer-Oberflächen direkt miteinander verbunden, indem die einzelnen Siliziumatome aus den Kristallgittern der beiden Wafer sich miteinander zu Molekülen verbinden. Vom Prinzip her eine Art Kleben ohne Klebstoff. Bisheriges Risiko beim „Direct Wafer-

Bonden“: Für das Verbindungsverfahren sind hohe Temperaturen bis zu 1500°C notwendig. Bereits eine Hitzeeinwirkung von rund 400°C beeinträchtigt die Stabilität der Mikrochips aber erheblich, kann den Wafer beschädigen und ihn unbrauchbar machen. So erwies sich das „Direct Bonden“ von Silizium-Wafern lange Zeit als problematischer Fertigungsschritt für die Mikrosystemtechnik. Ziel der MEMS-Hersteller ist es deshalb, das „Direkt Wafer-Bonden“ bei deutlich niedrigeren Temperaturen in den Griff zu bekommen. Technisch geeignete Verfahren wurden entwickelt, doch sind die notwendigen speziellen Präparations-schritte zur Vorbehandlung der Silizium-Wafer sehr komplex, kostspielig und nicht universell einsetzbar.

Mit "nanoPREP" werden während der Präparation die Oberflächen der Wafer einer speziellen Plasmabehandlung unterzogen. Hierbei lagern sich Molekülgruppen – die als Verbindungselemente fungieren – an die Wafer-Oberfläche an und störende organische Moleküle werden von der Oberfläche entfernt. Die molekularen Eigenschaften der Oberfläche verändern sich so, dass sie die atomare Verbindung von Silizium-Wafern fördern. Die Wafer werden präzise zueinander ausgerichtet und „schnappen“ durch die Anziehungskräfte der Oberflächenatome förmlich zusammen (Van-der-Waals-Kräfte). Anschließend werden die Wafer bei einer Temperatur von 200 bis 300°C „gebacken“, die atomare Verbindung zwischen den Wafergrenzflächen baut sich auf. Diese sind mechanisch sehr stabil und können als vakuum-

dichte, unlösliche Verbindungen zwischen den einzelnen Bestandteilen der Mikrosysteme genutzt werden.

SÜSS MicroTec entwickelte mit „nanoPREP“ ein eigenes Verfahren für die Plasmaaktivierung von Wafer-Oberflächen. „nanoPREP“ steht dabei für eine spezielle Präparierung von Oberflächen im Nanometerbereich als Vorbereitung für das Wafer-Bonden. Dieses Verfahren unterscheidet sich von anderen Verfahren zur Plasmaaktivierung, indem es in atmosphärischem Umgebungsdruck funktioniert. Damit wird die Verwendung einer kostenintensiven Vakuumanlage in der Produktion vermieden, was sich zusätzlich sehr positiv auf die Durchlaufzeiten in der Produktion auswirkt.

„nanoPREP“ optimiert so das „Direct Wafer-Bonden“ auf bedeutende Art und Weise:

- die Bauteile für MEMS-Applikationen werden nicht verändert oder beeinträchtigt,
- die Wafer-Verbindungen sind äußerst stabil und beständig; sie halten extremen Umgebungsbedingungen – etwa hohen thermischen Belastungen, Erschütterungen oder Korrosionen – problemlos stand,
- die Investitions- und Produktionskosten für MEMS-Hersteller sinken deutlich,
- der Durchsatz beim „Direct Wafer-Bonden“ in der Produktion erhöht sich durch die Vermeidung aufwendiger Vakuumprozesse.

„nanoPREP“ wird der zunehmenden Bedeutung von MEMS-Applikationen gerecht – und legt den Grundstein für die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung immer komplexerer Mikrosystemtechniken.

SÜSS MicroTec entwickelte das neue Verfahren in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut und dem Fraunhofer Institut IST. Die neue Technologie ist bereits zum Patent angemeldet. So sichert sich SÜSS MicroTec mit „nanoPREP“ einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im MEMS-Markt und erschließt gleichzeitig weitere Zukunftsmärkte. Zum Beispiel kann „nanoPREP“ bei dem Aufbau neuer Materialkombinationen wie der Verbindung von Silizium mit Silizium-Germanium eingesetzt werden. Durch die Verbindung dieser Materialien mit geringfügig unterschiedlichen Gitterkonstanten wird das Atomgitter des Siliziums gedehnt und die Materialeigenschaften verändern sich. Das so entstehende „Strained Silizium“ ist ein schnelles Halbleitermaterial mit extrem hoher Elektronenbeweglichkeit und findet insbesondere beim Bau extrem schneller Mikrochips Verwendung. Zukünftige Computergenerationen können damit nochmal wesentlich leistungsfähiger werden.

## 3. PRODUKTLINIEN

### Equipment für höchste Ansprüche

Bis zu unserem technischen Wunschprodukt ist es ein langer Weg. Mehrere Wochen schufteten Maschinen und verarbeiten Materialien in den aufwendigsten Verfahren – um so letztlich unser Handy, den DVD-Player oder das sichere und komfortable Auto zu liefern. Erst die Präzision jedes einzelnen Arbeitsschritts führt zur Leistungsfähigkeit unserer Endprodukte – und erst Innovationen in der „Welt der Maschinen“ bewirken auch technologische Neuheiten für uns. Nach dem Einblick in die Technologie liegt der Fokus nachfolgend deshalb auf den Produkten von SÜSS MicroTec.

Die SÜSS MicroTec-Maschinen decken verschiedene Prozesse in technischen Herstellungsverfahren ab. Die jeweiligen Geräte für einen bestimmten Prozess sind in folgenden Produktlinien zusammengefasst:

- **Spin Coater** („Beschichter“) beschichten den Wafer mit einer lichtempfindlichen Lackschicht,
- **Mask Aligner** („Masken Ausrichter“) justieren die Maske relativ zum Wafer und belichten den Wafer durch die Maske hindurch (Strukturübertragung durch Photolithografie),
- **Developer** („Entwickler“) entwickeln den belichteten Lack,
- **Bonder** („Verbinder“) montieren mit hoher Genauigkeit entweder einzelne Bauteile im Waferformat miteinander (Substrat Bonder) oder montieren die einzelnen Bauteile nach dem Zertrennen der Wafer

auf entsprechende Träger (Device Bonder) und

- **Prober** („Prüfer“) führen analytische Tests von Bauteilen auf einem Wafer durch.

SÜSS MicroTec-Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität und überragende Wirtschaftlichkeit aus – in der Halbleiterindustrie als so genannte „Cost of Ownership“ (CoO) bezeichnet. Sie bewertet nicht nur Anschaffungs- und Betriebskosten sondern auch Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders in Rahmen von Massenproduktionen von größter Bedeutung.

Mit ihrer ganz besonderen Präzision, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sind die Produkte von SÜSS MicroTec weltweit führend – und bei allen namhaften Herstellern und Dienstleistern der Halbleiterbranche installiert. Insgesamt sind heute rund um den Globus einige tausend Maschinen von SÜSS MicroTec im Einsatz. In Asien (speziell in Japan, Taiwan und Südkorea), Nordamerika und Europa ist das Know-how von SÜSS MicroTec traditionell besonders gefragt.

Im Folgenden werden die Produktlinien von SÜSS MicroTec beschrieben. Im Mittelpunkt stehen dabei Funktion und Entwicklung der Maschinen sowie

ihre Einsatzbereiche in den verschiedenen SÜSS MicroTec-Märkten.

## **Mask Aligner – Pioniere der Photolithografie**

Vor 40 Jahren startete SÜSS MicroTec seine Produktentwicklung mit dem Mask Aligner – und schreibt mit ihm bis heute Produktgeschichte. Weltweit sind rund 4.000 Mask Aligner-Systeme von SÜSS MicroTec bei allen namhaften Herstellern von Halbleiterbausteinen wie Mikrochips oder Mikrosystemtechnik-Bauteilen installiert. Folglich ist der Marktanteil überaus dominant; mehr als 80% aller Mask Aligner weltweit kommen von SÜSS MicroTec. Die große Akzeptanz zeigt die erfolgreiche Entwicklungsarbeit: Der Mask Aligner vereint höchste technische Qualität, vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten und hohe Produktivität – wichtigste Kriterien für seine tägliche Arbeit.

Mask Aligner führen die Photolithografie in bestimmten Marktnischen der Halbleiterfertigung durch. Sie kommen zum Einsatz, nachdem die Wafer-Oberfläche gleichmäßig mit einer photoempfindlichen Lackschicht überzogen wurde. Beim anschließenden Belichtungsprozess wird der Photolack mit ultraviolettem Licht durch eine teilweise transparente Photomaske hindurch belichtet. So überträgt der Mask Aligner die auf der Photomaske vorgegebenen kleinsten Strukturen im Abbildungsverhältnis 1:1 auf den Wafer. Die übertragenden Strukturen sind dabei 0,5 bis über 50 Mikrometer

groß (zur Veranschaulichung: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von etwa 30 bis 50 Mikrometer). Mask Aligner von SÜSS MicroTec belichten die gesamte Wafer-Oberfläche in einem Schritt. Das ermöglicht einen bis zu 3-fach höheren Durchsatz als bei Konkurrenzverfahren, die den Wafer abschnittsweise belichten.

Mask Aligner werden in den wichtigsten SÜSS MicroTec-Märkten Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter eingesetzt. Besonders beim Advanced Packaging zählen sie weltweit zu den bevorzugten Maschinen bei der Equipmentwahl. Denn je nach technischer Ausstattung reduzieren sie hier die Kosten im Vergleich zum Wettbewerb bis zu 60%.

Die Produktlinie Mask Aligner umfasst heute insgesamt sechs Geräte – die manuell, halb- oder vollautomatisch arbeiten. Im Forschungsbereich und Märkten mit noch niedrigeren Produktionsvolumen – wie der Mikrosystemtechnik – ist überwiegend manuelles oder halbautomatisches Equipment gefragt.

Die Mikrosystemtechnik ist heute ein sehr stark diversifiziertes Anwendungsgebiet mit teilweise sehr unterschiedlichen Anforderungen an das Produktionsequipment. Deshalb werden in einigen Fällen sehr spezielle Maschinen eingesetzt, die ganz grundsätzlich auf der Maschinenbasis der Mask Aligner aufgebaut sind. Die Übertragung von Nanostrukturen etwa erfolgt nicht per Photomaske sondern mit einem fortschrittlichen Prägeverfahren (Nanoimprinting).

## I 3. PRODUKTLINIEN

Der Advanced Packaging-Markt mit hohen Durchsatzraten nutzt dagegen die vollautomatischen Mask Aligner. Neben der Belichtung integriert SÜSS MicroTec auch weitere Prozessschritte in einen Mask Aligner. Diese komplexen Systemlösungen – etwa der „LithoPack 300“ – vereinen dann zusätzlich die beiden vor- und nachgelagerten Prozesse der Beschichtung und der Entwicklung der photoempfindlichen Schicht. Der Vorteil für den Kunden: ein Fertigungsverfahren das noch schneller, effektiver und kostensparender ist.

### MEILENSTEINE MIT NEUER BELICHTUNGS-GENERATION

Im Jahr 2003 leistete SÜSS MicroTec erneut Pionierarbeit für seine wichtigste Produktgruppe. Mit „SupraYield“ entwickelte SÜSS MicroTec eine neue Technologie für Mask Aligner, die den Kunden maßgebliche Wettbewerbsvorteile bietet und seine Chipproduktion optimiert: Eine Strukturauflösung bei der Wafer-Vollfeldbelichtung von bis zu 0,5 Mikrometer (bisheriger Standard etwa 5 Mikrometer) bei bester Übertragungsqualität, weitere Kostenreduktion für den Belichtungsprozess und eine deutlich höhere Ausbeute am Ende der Chipfertigung (eine detaillierte Beschreibung der neuen „SupraYield“-Technologie finden Sie in Kapitel 2, Seite 12).

Ein individuelles technologisches „Lifting“ gab es im vergangenen Jahr für einen der traditionsreichsten SÜSS MicroTec-Mask Aligner – das „Masken Justier- und

Belichtungsgerät“ MJB3. Die 1969 entwickelte, kleine, manuelle Lithografiemaschine gehört mit über 2.000 installierten Systemen noch heute zu den ganz Großen seiner Produktlinie. Der einst meistverkaufte SÜSS MicroTec-Mask Aligner ist in Universitäten und Forschungsinstituten seit über drei Jahrzehnten das Standardgerät zur Lithografieforschung und -entwicklung bei bis zu 3-Zoll-Wafern. Der technische Fortschritt wird heute aber zunehmend auf 4-Zoll-Wafern erkundet. SÜSS MicroTec entwickelte deshalb auf der Basis des legendären MJB3 ein neues Gerät, den MJB4, der mit modernster Technik hinsichtlich Steuerung und Bedienung ausgestattet ist und natürlich Waferformate bis zur Größe von 4-Zoll bearbeiten kann. Gemeinsam mit seinen „großen“ Nachfolgern wird dieses Maschinenkonzept auch künftig Meilensteine in der Lithografieentwicklung setzen und SÜSS MicroTec-Kunden größte Zuverlässigkeit, höchste Präzision und beste Qualität bieten.

### **Spin Coater – Beschichtung mit Schwung**

Spin Coater sind im Rahmen der Halbleiterfertigung die „Beschichter“ der Wafer. Sie tragen die photoempfindliche Lackschicht auf den Wafer auf und bereiten so den direkt anschließenden Schritt der Photolithografie vor. Der Name „Spin“ beschreibt die Standardmethode der Beschichtung: Im Zentrum des Wafers wird der flüssige Photolack aufgebracht und durch schnelle Rotation gleichmäßig auf den gesamten Wafer verteilt – sozusagen auf den Wafer „geschleudert“. Der Lack

muss dabei äußerst gleichmäßig aufgetragen werden. Erst dann können die weiteren Fertigungsschritte erfolgreich ablaufen. SÜSS MicroTec-Spin Coater garantieren eine extrem gleichmäßige Verteilung des Lacks bei Schichtdicken bis zu 300 Mikrometer. Das patentierte und einzigartige GYRSET-Verfahren der SÜSS MicroTec-Coater steigert diese Präzision noch und reduziert in den meisten Fällen den Photolackverbrauch ganz erheblich.

GYRSET (abgeleitet vom Begriff „Rotation“) ist ein spezieller, „geschlossener“ Coating-Vorgang: Nach dem Aufbringen des Lacks auf den Wafer wird dieser mit einem Deckel abgedeckt, der einen kleinen Raum über den Wafer bildet und mit diesem rotiert. In dieser geschlossenen, rotierenden Prozesskammer erfolgt dann die gleichmäßige Verteilung des Photolacks auf dem Wafer. In der geschlossenen GYRSET-Kammer werden Luftturbulenzen wirkungsvoll reduziert; die Atmosphäre sättigt sich rasch mit Lösungsmitteldampf. Dadurch trocknet der Lack langsamer und der Photolack bleibt so über längere Zeit fließfähig. Dieser Umstand wiederum ermöglicht, die Rotationsgeschwindigkeit zu reduzieren, dem Fließvorgang mehr Zeit zu gewähren und dadurch weniger Photolack vom Wafer abzuschleudern. GYRSET garantiert somit höchste Effektivität bei bis zu 60% geringerem Lackverbrauch – ein wichtiger Punkt, da diese Lacke extrem teuer sind.

Rund zehn Jahre ist SÜSS MicroTec inzwischen mit Spin Coatern erfolgreich – der weltweite Marktanteil

erreicht in den von SÜSS MicroTec bedienten Marktsegmenten in Produktionsanwendungen etwa 40%. Die umfangreiche Produktlinie reicht vom kleinsten manuellen Tischgerät bis zum kompakten vollautomatischen Spin Coater-System. Mit ihrer hohen Präzision gerade auch bei dicken Schichten werden SÜSS MicroTec-Spin Coater bevorzugt in den Märkten Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik eingesetzt.

Im Geschäftsjahr 2003 erforschte SÜSS MicroTec ein neues Beschichtungs-Verfahren: Die so genannte „Spray“-Methode. Im Gegensatz zur Standardmethode sprüht der Coater hierbei den Lack mit einer Düse auf den Wafer. Selbst dreidimensionale Strukturen und scharfe Strukturkanten werden so noch mit einer Lackschicht überzogen. Die Technologie des Spray Coatens verfeinert SÜSS MicroTec auch zukünftig – und treibt so die Entwicklung neuer Coater-Generationen weiter voran. Erste Patente wurden bereits angemeldet; erste Produkte bereits verkauft.

### **Developer – Spezielle Bilder von Strukturen**

Fast schon fester Bestandteil des Spin Coaters ist der Developer (Entwickler) von SÜSS MicroTec. Dieses Standard-Equipment für die Halbleiterfertigung wird auf Kundenwunsch meist als Modul in den Spin Coater oder auch in den „LithoPack300“ (besteht aus Spin Coater, Mask Aligner und Developer) integriert. Denn nach Beschichtung und anschließender Photolithografie

## I 3. PRODUKTLINIEN

durch den Mask Aligner folgt unmittelbar der Entwicklungsprozess. SÜSS MicroTec-Developer unterstützen hier die verschiedensten Prozesse. Jeder Lacktyp benötigt dabei sein spezielles Entwicklungsverfahren. Im Rahmen der Entwicklung „ätzt“ der Developer entweder die nicht belichteten Bereiche des Lacks vom Wafer oder – umgekehrt – löst die belichteten Stellen heraus. SÜSS MicroTec-Developer sind auf die „nahtlose“ Integration in Spin Coater- und Mask Aligner-Verfahren ausgerichtet – ihr Entwicklungsprozess eine feste „Größe“ in der Halbleiterfertigung.

### **Bonder – Verbindungen der besonderen Art**

Ein Wafer, der während der Herstellung von Halbleitern oder Mikrosystemen zu den SÜSS MicroTec-Bondern kommt, hat bereits eine Vielzahl von Fertigungsschritten durchlaufen. Denn die Aufgaben der Bonder liegen im so genannten Backend der Produktion:

- die Verbindung zwei oder mehrer Wafer in physikalisch-chemischen Verfahren und
- die Verbindung der fertigen Halbleiterbauteile mit einem entsprechendem Träger.

Diese verschiedenen Prozesse „teilen“ sich der Device Bonder und der Substrat Bonder. Beide zusammen sind sehr erfolgreich. Weltweit gibt es rund 300 installierte SÜSS MicroTec-Bonder. Damit ist das Garching Unternehmen international die Nummer 1. Besonders im vergangenen Geschäftsjahr steigerte SÜSS MicroTec

seinen Bonder-Absatz deutlich – speziell Substrat Bonder waren gefragt.

Der Auftrag an *Substrat Bonder* lautet immer: Die Herstellung einer dauerhaften Verbindung zweier oder mehrerer Wafer. Aber um tausende elektronisch kleinste Bauteile auf den Wafern lebenslang zu „verkoppeln“ bedarf es höchster Präzision – im Vorfeld, während und nach der Verbindung. SÜSS MicroTec-Substrat Bonder zeichnen sich bei allen Verbindungsschritten durch hohe Leistungsfähigkeit und äußerste Zuverlässigkeit aus. Das Endresultat für den Kunden sind Waferverbindungen mit kleinster Defektrate und damit eine sehr effiziente Produktion.

SÜSS MicroTec entwickelt und produziert seine jüngste Produktlinie Substrat Bonder seit rund sechs Jahren. Die Entscheidung, Substrat Bonder herzustellen, fiel aufgrund der wachsenden Bedeutung von Mikrosystemtechniken (MEMS) und der zentralen Rolle von Substrat Bondern im MEMS-Herstellungsverfahren. So konnte SÜSS MicroTec den Wachstumsmarkt Mikrosystemtechnik von der Equipment-Seite konsequent begleiten und seine technische Entwicklung vorantreiben. Neben der Mikrosystemtechnik als wichtigsten Markt, sind Substrat Bonder auch in den SÜSS MicroTec-Märkten Advanced Packaging und Verbindungshalbleiter im Einsatz. In allen Märkten werden manuelle oder vollautomatische Geräte genutzt. Die Basis ist jeweils eine Bonder-Station die je nach Aufgabenbereich mit zusätzlichen

Modulen ausgestattet ist. Die sehr flexiblen Substrat Bonder-Lösungen sind so individuell in verschiedenste Prozesslinien integrierbar und den sich wandelnden Produktionsumgebungen jederzeit anpassbar. Sie unterstützen dabei alle gängigen Verbindungsverfahren.

#### SPÜRBARE VORTEILE DURCH NEUE FLEXIBILITÄT

Im Geschäftsjahr 2003 optimierte und erweiterte SÜSS MicroTec seine Substrat Bonder-Produktlinie. Neu sind die Automatischen Bonder Cluster – kurz „ABC200“ – und der Substrat Bonder „SB6e“.

Die neue Bonder-Station „ABC200“ lässt sich für die verschiedensten Anwendungen in den diversen Bonder-Märkten beliebig konfigurieren – etwa mit einem „nanoPREP“- , Laserbond- oder Justier-Modul. Dabei kann der vollautomatische „ABC200“ eine Vielzahl von Bondverfahren gleichzeitig durchführen – mit der gleichen Qualität wie bei nur einer Verbindung.

Den neuen, deutlich kleineren und manuellen „Nachwuchs“ der Substrat Bonder-Produktfamilie „SB6e“ entwickelte SÜSS MicroTec für den Einsatz in Universitäten, Forschungsinstituten und für Unternehmen mit Pilotproduktionen. Auch der „SB6e“ zeigt größte Flexibilität. Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten später ausbauen, können die auf dem „SB6e“ entwickelten Prozesse in automatische Substrat Bonder übertragen.

#### Verbindungen ohne Grenzen

SÜSS MicroTec-Substrat Bonder verbinden Wafer auf ganz besondere Art. Mit dem neuen automatischen Bonder „ABC200“ funktioniert das folgendermaßen: Bereits vor der eigentlichen Verbindung richtet das Justier-Modul im „ABC200“ die sauberen und glatten Wafer-Oberflächen äußerst genau zueinander aus. Das verlangt schon im Vorfeld höchste Präzision. Beim anschließenden Bondprozess verbindet der „ABC200“ etwa durch Anlegen von Temperatur, Strom oder auch Druck zwei oder mehrere Wafer miteinander. Das äußerst stabile und mit entsprechenden Vorrichtungen ausgestattete Bondwerkzeug verhindert, dass die Wafer beispielsweise unter Einfluss von Druck oder Hitze „verrutschen“. Denn die Auswirkungen wären fatal: Der Wafer verliert seinen bereits hohen Produktionswert; der Großteil vom Aufwand bei der Chipherstellung ist vertan.

Präzision und Leistungsfähigkeit des „ABC200“ ermöglichen sogar, dass mehrere Verbindungsprozesse in verschiedenen Kammern gleichzeitig stattfinden – um auch hier jeden möglichen „Fehlschritt“ zu unterbinden. Mehrere parallele Prozessschritte in einer Maschine bedeuten für den Kunden einen höheren Durchsatz gegenüber einzelnen Maschinen, weniger Handhabungsschritte, dadurch größere Prozesssicherheit und folglich niedrigere Kosten in der Produktion. Neben der hohen Justierfähigkeit und Flexibilität ist deshalb die einzigartige „Cost of Ownership“ der neuen Bonder-Generation ein weiterer, spürbarer Vorteil gegenüber manuellen Einzelgeräten.

## I 3. PRODUKTLINIEN

Zu den neuen Produkten kam 2003 die weltweit einzigartige technologische Entwicklung „nanoPREP“ – die entscheidende Verbesserung des Verbindungsprozesses durch niedrigere Temperaturen – die wir bereits in Kapitel 2, Seite 15 ausführlich vorgestellt haben.

*Device Bonder* kommen nach Abschluss der Halbleiterfertigung zum Einsatz. Sie verbinden mit hoher Präzision und Justiergenauigkeit die bereits fertig hergestellten und aus dem Waferverbund herausgesägten Bauteile mit dem Endprodukt. Der neue, 2003 entwickelte, SÜSS MicroTec-Device Bonder „Triad“ gilt als der weltweit präziseste Device Bonder für die Produktion. Er ist speziell für den Einsatz höherer Produktionsvolumina in der Optoelektronik – etwa zur Herstellung von Leuchtdioden und Mikrochips für die Telekommunikation – gebaut.

### **Prober – Maschinen für intelligente Analysen**

Erst Prober ermöglichen „Endprodukte mit Garantie“. Prober sind das Test-Equipment von SÜSS MicroTec. Sie kontrollieren das Verhalten der Bauteile auf einem Chip, in Forschung, Entwicklung und Produktion. Dabei gehen Prober der Frage nach „wieso oder weshalb“ etwa ein Chip nicht funktioniert – und analysieren dafür die Mikrochips bis ins kleinste Detail.

SÜSS MicroTec fasst die Prober in seinem Markt Test & Measurement (steht für Test und Messung) zusammen.

Sie sind als einziges Equipment der Garching-Gruppe keine Produktionsgeräte, sondern Analysegeräte und so universell in diversen technologischen Bereichen einsetzbar. Seit über 30 Jahren entwickelt SÜSS MicroTec die Maschinen für hochspezielle Analysen mit dem Anspruch: Höchste Qualität für 100%ig genaue Messergebnisse und ein modularer Aufbau für äußerste Flexibilität. Für die Produktlinie von manuellen, halb- oder vollautomatischen Probern gibt es deshalb heute über 1000 Zubehörteile – darunter einzigartige Prüfköpfe, Messkabel, Mikroskope oder so genannte elektromagnetisch geschützte Umgebungen. Jedes Gerät wird dabei für seinen Einsatz kundenspezifisch ausgestattet und bei Bedarf jederzeit umgerüstet. SÜSS MicroTec-Prober werden für Chip-Charakterisierung, Fehleranalyse oder Zuverlässigkeits- und Funktionstests eingesetzt. Wichtigste Analysebereiche sind dabei die Hochfrequenztechnik – mit Chips und Sensoren für die Telekommunikation, Radaren und Satelliten –, Mikrosystemtechnik, Optoelektronik (LEDs) und der allgemeine Halbleitermarkt.

Bis Ende 2003 wurden über 2.000 der intelligenten Analysegeräte von SÜSS MicroTec weltweit verkauft. Stärkster Markt der Garching-Gruppe ist traditionell Europa. Hier ist SÜSS MicroTec mit einem Anteil von über 50% Marktführer. Weltweit liegt der Marktanteil bei 20% – mit steigender Tendenz. Denn 2003 entwickelte SÜSS MicroTec eine Vielzahl einzigartiger Test-Neuheiten, die bereits stark nachgefragt sind.

## INDIVIDUELLE TESTS MIT NEUER SENSIBILITÄT

Seit Frühjahr 2003 ist der weltweit erste Prober für Vakuumtests auf dem Markt. Mit dem manuellen oder automatischen Analysegerät (PMV oder PAV für Prober Manuell oder Automatic Vakuum) können zum ersten Mal elektrische und nicht elektrische Tests auf Wafer-Ebene im Vakuum durchgeführt und ausgewertet werden. Zum Einsatz kommt der neue Prober im Hochfrequenzbereich und insbesondere in der Mikrosystemtechnik. Hier testet er beispielsweise Infrarotsensoren oder so genannte Mikro-Bolometer. Diese sind äußerst sensibel; die Überprüfung ihrer Zuverlässigkeit deshalb nur in einer absolut neutralen, ungestörten und in der Regel „eiskalten“ Umgebung – also im Vakuum nahe dem absoluten Temperatur Nullpunkt – möglich. Denn schon die winzigste Temperaturschwankung beeinflusst Infrarotsensoren – wie ein Blick in ihre tägliche Arbeit zeigt: Wenn es heute beim Sicherheitscheck am Flughafen „piept“, haben möglicherweise auch Infrarotsensoren, die auf SÜSS MicroTec-Maschinen hergestellt wurden, ihre „Finger mit im Spiel“. Sie meistern dabei eine ganz spezielle und relativ neue Sicherheitsaufgabe: die Suche nach Vireninfektionen bei Menschen und damit nach Krankheiten wie SARS. Wir werden dafür mit Infrarotsensoren abgescannt, die bei Temperaturabweichungen von der normalen Körpertemperatur Alarm schlagen. Nur so wird rasch überprüfbar ob möglicherweise eine fieberhafte Virusinfektion vorliegt.

## Stars zum Anfassen

Möglicherweise ersetzt der Videoprojektor (Beamer) schon bald unseren Fernseher. Statt den Bildschirm einzuschalten, projizieren wir die Lieblingsstars dann einfach auf eine Wand oder durch Rückseitenprojektion auf einen Schirm, der eine Größe im Quadratmeterbereich einnehmen kann. Voraussetzung für das Privatkino zu Hause: Die Qualität der Beamerwiedergabe ist vom Kinobild nicht unterscheidbar. Das verlangt technische Höchstleistung und äußerste Zuverlässigkeit des Beamers. Unzählige, winzige und bewegliche Spiegel in einem Projektionsdisplay im Beamer müssen dann per Projektorlicht hunderte Pixel punktgenau auf der Wand abbilden; nicht ein Pixel darf aus der Reihe tanzen. Die Funktion der Microspiegel kann ausschließlich durch Tests im Vakuum gewährleistet werden – und so nur durch den im Markt einzigartigen Prober von SÜSS MicroTec. Denn Beamer Spiegel reagieren höchst sensibel auf äußere Einflüsse. Schon der kleinste Lufthauch lässt sie in ihrer Bewegung stoppen und die Kontrolle über die Pixel verlieren.

Für den notwendigen Test wird der SÜSS MicroTec-Prober zusätzlich mit einem Gerät für Bewegungsanalyse ausgestattet. Die Mini-Spiegel nimmt er dann folgendermaßen unter die Lupe: Mit einem elektrischen Signal bringt er die Spiegel im Vakuum zur Bewegung und zeichnet ihre Bewegungen im 3D-Format – also von allen Seiten sichtbar – auf. Anschließend erfolgt die Testauswertung durch den Prober. Nur dieser spezielle Test schließt spätere Fehlerquellen im Beamer aus und sichert uns die „Stars zum Anfassen“.

## I 3. PRODUKTLINIEN

Eine weitere Neuheit für Mikrosystemtechnik ist der erste Prober für Drucktests (PAP200). Der halbautomatische Prober „PAP200“ analysiert zum Beispiel Sensoren bei einem Druck bis zu 50 Bar – das entspricht dem Wasserdruck in 500 Meter Tiefe. So können jetzt erstmals Drucksensoren für den Einsatz in Auto-, Lastwagen- oder Flugzeugreifen getestet werden. Zusätzlich ist der neue Prober für Tests von Gasensoren ausgestattet und kann die Luftfeuchtigkeit im Prober selbst beeinflussen.

Speziell für den Hochfrequenzbereich optimierte SÜSS MicroTec die Kalibrierungssoftware (SussCal 5.1). Mit einem neuen Verfahren können Messungen im Hochfrequenzbereich jetzt so effektiv und qualitativ hochwertig wie nie zuvor durchgeführt werden – so bestätigen es aktuelle Untersuchungen unabhängiger Forschungsinstitute. Per Kalibrierung werden vorab Störfaktoren wie Kabelbiegungen oder schlechte Verbindungen in der Messumgebung isoliert, um den anschließenden hochgenauen analytischen Test von Chips in der Hochfrequenztechnik zu ermöglichen. Ohne Kalibrierung würden Störfaktoren in die Messung einkalkuliert; die Messung ist dann nicht zuverlässig.

Eine wichtige Neuentwicklung für den allgemeinen Halbleitermarkt rundet die Prober-Innovationen 2003 ab. Das „MicroAlign“-Testverfahren (Mikro Justierung) setzt einen neuen Standard für die Chip-Charakterisierung: Erstmals lässt sich die Zuverlässigkeit der neuen und künftigen kleinsten Chipgenerationen auf

Wafer-Ebene prüfen – und damit von Chips, die kleiner als 40x40 Mikrometer sind.

Das Angebot an neuen, einzigartigen Probern zeigt die effektive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie das Innovationspotenzial von SÜSS MicroTec auch in diesem Segment. Jedes entwickelte Verfahren ist dabei auf die spezifischen Anforderungen der einzelnen Testmärkte ausgerichtet. Mit diesen Entwicklungen hat SÜSS MicroTec seine Prober-Produktlinie nachhaltig gestärkt – und gleichzeitig als erstes Unternehmen neue wachstumsstarke Test-Nischen besetzt. Auch im laufenden Jahr wird SÜSS MicroTec die flexiblen Einsatzmöglichkeiten seiner Test-Systeme steigern und in weitere Nischenmärkte vordringen.

## 4. STARKE PARTNERSCHAFTEN

### **SECAP – Fortschritt für Advanced Packaging**

In seinen Hauptmärkten treibt SÜSS MicroTec die Forschung und Entwicklung intensiv voran – individuell und mit einem Netzwerk starker Partner. Der Vorteil starker Partnerschaften für SÜSS MicroTec: Weltweit technologisches Know-how wird gebündelt, ausgetauscht, erweitert, optimiert und wenn möglich standardisiert. Wie erfolgreich das in der Praxis funktioniert, beweist SÜSS MicroTec seit knapp vier Jahren mit dem Semiconductor Equipment Consortium for Advanced Packaging – kurz SECAP genannt. Zu den SECAP-Mitgliedern gehören neben SÜSS MicroTec weitere weltweit führende Anbieter für die Advanced Packaging-Technologie: BTU, Image Technology, Matrix Integrated Systems, NEXX Systems, Semitool und das Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM).

SECAP berät und unterstützt die Chiphersteller bei Einführung der innovativen Advanced Packaging-Technologie – etwa bei Prozessausstattungen für die 300mm-Wafer, mit denen das Advanced Packaging-Verfahren durchgeführt wird. Einen ersten Meilenstein in diesem Bereich setzte das Konsortium 2002: Erstmals richtete SECAP eine komplette 300mm-Advanced Packaging-Produktionslinie ein. Dieser Durchbruch wurde möglich durch ein gemeinsames Projekt mit Unitive Inc., USA, einem der weltweit führenden Entwickler und Anbieter von Advanced Packaging-Lösungen. Unitive gilt international als

Vorreiter und Vorbild bei Einführung und Nutzung neuer Technologien.

Seit April 2003 ist die Produktionslinie bei der Unitive-Tochter UST (Unitive Semiconductor Taiwan Corp.) in Taiwan installiert; im Juli nahm sie ihren Betrieb auf. UST nutzte die SECAP-Linie zur Einführung der 300mm-Technologie. Mit Erfolg: In kürzester Zeit stellte UST seine Technologie reibungslos auf den 300mm-Bereich um und nahm die Advanced Packaging-Produktion auf. Neben Unitive steht die Produktionslinie an bestimmten Zeiten auch weiteren potenziellen SECAP-Kunden für Tests und zur Evaluierung zur Verfügung.

Die vielversprechende Inbetriebnahme der neuen SECAP-Linie ist ein weiterer Meilenstein. Sie zeigt, dass die intensive und effektive Kooperation des SECAP-Konsortiums die Einführung innovativer Technologien beschleunigt. Gleichzeitig unterstreicht sie die Vorreiterrolle die SECAP im Bereich Advanced Packaging hat – und auch in Zukunft einnehmen wird.

Über aktuelle SECAP-Entwicklungen informiert Sie [www.secap.org](http://www.secap.org) und die SÜSS MicroTec-Webseite.

### **MEMUNITY – Tests für die Zukunft**

Im Frühjahr 2003 setzte SÜSS MicroTec eine neue richtungsweisende Initiative um: Die Gründung von MEMUNITY – dem weltweit ersten Test Forum für

## I 4. STARKE PARTNERSCHAFTEN

Mikrosystemtechnik (MEMS). Das Forum MEMUNITY – der Name steht für „The MEMS Test Community“ – berät und unterstützt Mikrosystem-Produzenten bei Einführung und Installation von Testprozessen – und erforscht gemeinsam mit Ihnen neue Testverfahren für Mikrosysteme. Primäres Ziel ist dabei die Entwicklung individueller Testverfahren vor und während der Mikrosystem-Produktion. Ein weltweit absolutes Novum: Denn bisher konnte die Funktions- und Leistungsfähigkeit von Mikrosystemen erst nach abgeschlossenem Herstellungsprozess erprobt werden. So bringt MEMUNITY der Mikrosystembranche entscheidende Vorteile. Denn frühzeitige Tests

- zeigen, ob die spezielle MEMS-Entwicklung überhaupt schon produktionsreif ist,
- ermöglichen es, nicht funktionierende Mikrosysteme bereits vor der anschließenden teuren Produktion auszusortieren und die Fehlerquelle aufzuspüren,
- können Mikrosysteme für die Produktion optimieren und die Ausbeute (Yield) für den Hersteller deutlich erhöhen.

Diese Vorteile zahlen sich aus: Mikrosystem-Hersteller können Ihre Produktionskosten durch die Einführung geeigneter Testverfahren um bis zu 80% Prozent senken. MEMUNITY hilft ihnen dabei, diese Testverfahren zu entwickeln. Jedes einzelne MEMUNITY-Testverfahren wird dabei auf die individuellen Bedürfnisse des Herstellers zugeschnitten wie folgendes Beispiel verdeut-

licht: Ein skandinavisches Unternehmen entwickelt spezielle Mikrophone, die unter anderem in Hörgeräte eingesetzt werden. Dadurch verkleinert sich das Hörgerät so stark, dass es fast unsichtbar wirkt. Für diese besonderen Mikrophone war ein Testverfahren und entsprechendes Standardtestgerät bisher aber weltweit nicht verfügbar. MEMUNITY entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen eine spezifische Lösung. Das Ergebnis: Ein doppelseitiges Testgerät. So kann das Mikrophon unterhalb des Test-Equipments beschallt werden; die elektrischen Signale werden anschließend an die Oberfläche des Probers weitergeleitet, dort registriert und ausgewertet. Mit Hilfe dieser individuellen Test-Lösung lässt sich das „neue“ Hörgerät jetzt problemlos simulieren.

Dieses Testgerät ist nicht die einzige Neuheit, die MEMUNITY bereits im Markt umsetzte: Ein Testsystem in einer Druckkammer ermöglicht jetzt Tests in Luftdruck-Umgebungen bis zu 50 Bar. Diese Bedingungen sind notwendig für die Überprüfung von Drucksensoren, die in Flugzeug- und LKW-Reifen eingesetzt werden. Ein weiteres neues System analysiert Bewegungen von Mikro-Spiegeln, die in Beamern integriert sind (siehe hierzu auch die Beschreibung auf Seite 25).

SÜSS MicroTec gründete MEMUNITY in Kooperation mit dem dänischen Test Haus DELTA. Weiterer Partner ist Polytec, ein deutscher Hersteller von Laser Messsystemen (seit Oktober 2003). Bei allen entwickelten Testlösungen entscheidet der Kunde selbst von Fall zu



Fall, ob er „sein“ spezifisches Test-Equipment kaufen möchte oder seine Chips bei DELTA testen lässt. Die Resonanz auf MEMUNITY ist schon wenige Monate nach seiner Gründung außerordentlich groß: Über 50 Interessenten arbeiten bereits mit dem weltweit ersten MEMS Test Forum zusammen – ein internationaler Mix aus MEMS- und Equipment-Herstellern, Universitäten und Forschungsinstituten. Die Nachfrage zeigt: In der Mikrosystembranche besteht großer Bedarf, den Entwicklungs- und Herstellungsprozess der zukunftsweisenden „Minisysteme“ zu optimieren.

MEMUNITY bewirkt im Testbereich neue Standards für diese „junge“ Technologie, die letztlich die Entwicklung und Produktion von Mikrosystemtechniken entscheidend vergünstigen und voranzutreiben.

Aktuelle MEMUNITY-Entwicklungen finden Sie auch unter [www.memunity.com](http://www.memunity.com) oder auf der SÜSS MicroTec-Webseite.



## 5. INVESTOR RELATIONS

### Aktie im Aufwind

Neustart in das Börsenjahr 2003: Nach abgeschlossener Umstrukturierung des Aktienmarktes durch die Deutsche Börse werden die SÜSS MicroTec-Aktien seit 01. Januar 2003 im Börsensegment „Prime Standard“ gehandelt. Hier unterliegt SÜSS MicroTec den gleichen strikten Verpflichtungen an die sich Anleger noch vom „alten“ Neuen Markt erinnern. Dazu gehören internationale Transparenzstandards wie etwa Quartalsberichte, Analystenkonferenz oder Ad hoc-Meldungen in deutscher und englischer Sprache.

Die Börsenstruktur wird seit März 2003 durch ein neues Index-Konzept ergänzt. Wichtiger Auswahlindex für SÜSS MicroTec ist seitdem der TecDAX. Er umfasst die 30 größten Technologieunternehmen des Qualitätssegments „Prime Standard“ und wird zweimal jährlich von der Deutschen Börse neu überprüft. Kriterien für die Aufnahme in den TecDAX sind jeweils die Börsenumsätze der vergangenen zwölf Monate sowie die Freefloat-Marktkapitalisierung zum Untersuchungszeitpunkt.

Als wichtiges Börsenziel 2003 strebte SÜSS MicroTec die Aufnahme in den TecDAX an – und setzte dieses Ziel erfolgreich um. Seit 22. September ist SÜSS MicroTec im „Blue Chip“-Index gelistet. Voraussetzung dafür war eine deutlich bessere Kursentwicklung. Nach dem schweren Kursjahr 2002 und einem schwachen Beginn im vergangenen Jahr erholte sich die

SÜSS MicroTec-Aktie von ihrem Tiefpunkt bei 1,25 Euro im Frühjahr 2003 Schritt für Schritt. Im November erreichte die Aktie wieder ein zweistelliges Kursniveau. Fast parallel setzte sich SÜSS MicroTec deutlich positiv von der allgemeinen TecDAX-Entwicklung ab.

Gerade in den schweren und unerfreulichen Zeiten pflegte SÜSS MicroTec weiterhin eine intensive Investor Relations Arbeit. Auf internationalen Roadshows, Investoren- und Telefonkonferenzen sowie in Einzelgesprächen mit (potenziellen) Investoren und Pressevertretern zeigte das Management der SÜSS MicroTec AG eine größtmögliche Unternehmenstransparenz gegenüber dem Kapitalmarkt und informierte über die jeweils aktuelle Unternehmenssituation. Diese kontinuierliche Informationspolitik wurde von den Aktionären wie auch den betreuenden Bank- und Investmenthäusern honoriert. Die SÜSS MicroTec AG wird gegenwärtig von über zehn nationalen und internationalen Banken und Investmenthäusern betreut.

Ein wesentlicher Faktor für den anhaltenden Kursaufschwung ist sicherlich in der Stabilisierung des Halbleitermarkts zu sehen. Insgesamt hielt sich im gesamten Jahr 2003 eine positivere Grundstimmung in der Halbleiterbranche – und erste Neuinvestitionen in SÜSS MicroTec-Equipment fanden statt. Auch die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung weltweit einzigartiger und zukunftsweisender Technologien stieß bei den Investoren auf großes Interesse.

## WANDEL- UND OPTIONSANLEIHE ERWEITERT KAPITALBASIS

Im November begab die SÜSS MicroTec AG unter Ausschluss des Bezugsrechts eine Wandel- und Optionsanleihe aus genehmigtem Kapital im Gesamtvolumen von 11,64 Millionen Euro an einen englisch-amerikanischen Investorenkreis. Das Management entschied sich zu dieser Kapitalmaßnahme, um die Eigenkapitalbasis des Unternehmens zu stärken und um so einen flexibleren Finanzierungsspielraum, beispielsweise zur Finanzierung des erwarteten Wachstums im laufenden Geschäftsjahr, zu schaffen.

Mit 11,269 Millionen Euro entfällt der größte Teil des Volumens auf die Wandelanleihe. Wandelanleihen sind als eine Art Darlehen einer Aktiengesellschaft mit fester Verzinsung zu verstehen (im vorliegenden Falle 6% per annum). Während der 2- beziehungsweise 5-jährigen Laufzeit kann der Investor die Anleihe in Aktien wandeln. Der Preis für die SÜSS MicroTec-Aktie wurde hier im Vorfeld auf 10,063075 Euro festgelegt. Anteilseigner die ihr Wandelrecht ausüben, „tauschen“ die Anleihe damit in Aktien und werden zum Aktionär – die Rückzahlung des Darlehens entfällt dann entsprechend. Behält der Anteilseigner dagegen seine Anleihe, bekommt er am Ende der Laufzeit (31. Oktober 2005 und 30. April 2006) sein eingesetztes Kapital verzinst zurück.

Auf die Optionsanleihe entfallen 373.270 Euro die ebenfalls mit 6% jährlich verzinst sind. Vorbehaltlich

von Bezugsrechten auf Aktien ist sie nach fünf Jahren rückzahlbar (31. Oktober 2008). Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine SÜSS MicroTec-Aktie verbunden. Der Bezugspreis mit 10,566229 Euro je Aktie liegt etwa 5% über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich einer Barzahlung von 9,5662 Euro pro Aktie.



# | SÜSS MicroTec AG

## ANHANG

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Corporate Governance               | 33 |
| Konzernlagebericht und Lagebericht | 34 |
| Konzernabschluss                   | 52 |
| Konzernanhang                      | 60 |
| Bestätigungsvermerk                | 91 |



## CORPORATE GOVERNANCE 2003

Transparenz ist der Leitgedanke von Corporate Governance. Für den Vorstand und den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist eine verantwortungsvolle und für die Aktionäre nachvollziehbare Unternehmensführung von größter Bedeutung. Insofern ist uns die Einhaltung der durch den Corporate Governance Kodex gesetzten Standards ein großes Anliegen. Wir haben bereits 2002 eine Corporate Governance Beauftragte berufen, die direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

Die aktuelle Entsprechenserklärung, welcher der Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 zugrunde liegt, wurde in der Vorstands- und Aufsichtsratsitzung im September 2003 verabschiedet und dann umgehend auf unserer Homepage zugänglich gemacht.

Der Corporate Governance Kodex beinhaltet derzeit über 70 Empfehlungen, zu welchen ein Unternehmen gem. § 161 Aktiengesetz jährlich eine Erklärung über etwaige Abweichungen abgeben muss. Die SÜSS MicroTec AG entspricht diesen Empfehlungen des aktuellen Corporate Governance Kodex und wird diesen voraussichtlich auch künftig entsprechen – mit den folgenden zwei Ausnahmen:

Der Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors and Officers Liability Insurance (Haftpflichtversicherung), einen angemessenen Selbstbehalt für die Organe der AG zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt. Das verantwortungsvolle Handeln aller geschäftsführenden Organe wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert. Es wird deshalb auch keine Vereinbarung eines organspezifischen Selbstbehalts geplant.

In Ziffer 5.4.5 empfiehlt der Corporate Governance Kodex eine feste Vergütung, die unter anderem den Vorsitz in Ausschüssen sowie eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern berücksichtigt. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell eine feste Vergütung des Aufsichtsrats vor. Der Vorsitz in Ausschüssen wird dabei nicht zusätzlich berücksichtigt.

Zu den Ziffern 6.5 sowie 7.2.1 wird nunmehr, anders als im Vorjahr, keine Abweichung erklärt, da die SÜSS MicroTec AG die Veröffentlichung kapitalmarktrelevanter Informationen im Ausland selbstverständlich vornehmen wird, sobald diese Regelung für uns zutrifft (Ziffer 6.5) und in 2003 die Unabhängigkeitserklärung des Wirtschaftsprüfers rechtzeitig vorlag (Ziffer 7.2.1).

Zusätzlich zu den Empfehlungen beinhaltet der Corporate Governance Kodex auch viele Anregungen, von denen die Unternehmen auch ohne Erklärungspflicht abweichen können. Wir sind der Meinung, dass wir unseren Aktionären eine größtmögliche Transparenz gewähren sollten und legen daher unsere Umsetzung bzw. die vier Abweichungen von den

Anregungen im Folgenden offen (die Befolgungen sind mit einem Plus gekennzeichnet, die Abweichungen mit einem Minus):

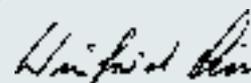
- + Der Stimmrechtsvertreter ist während der Hauptversammlung erreichbar.
- Die Hauptversammlung kann bisher noch nicht via Internet verfolgt werden. Im Hinblick auf zusätzliche Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung derartiger Maßnahmen abgesehen.
- Es findet keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratsitzungen statt, da es keinen mitbestimmten Aufsichtsrat gibt.
- + Der Aufsichtsrat tagt bei Bedarf ohne den Vorstand.
- + Im Falle eines Übernahmeangebots wird eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
- + Zu den Kodexanregungen wird Stellung genommen.
- + Der Vorstand erhält einmalige sowie jährlich wiederkehrende variable Vergütungskomponenten.
- + Die Vorstandsvergütung enthält an den geschäftlichen Erfolg gebundene variable Vergütungskomponenten;
- + ebenso variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung
- + und variable Vergütungskomponenten mit Risikocharakter.
- + Ein Aufsichtsratsausschuss für Vorstandspersonalien ist etabliert.
- + Eine kürzere Bestelldauer bei Erstbestellungen von Vorstandsmitgliedern ist vorgesehen.
- + Der Aufsichtsratsvorsitzende hat nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss (Audit Committee).
- + Kein ehemaliges Vorstandsmitglied ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses.
- + Der Aufsichtsrat übergibt weitere Sachthemen zur Behandlung an einen oder mehrere Ausschüsse.
- + Der Aufsichtsrat hat Sitzungsvorbereitungen und Entscheidungen zum Teil an Ausschüsse übertragen.
- Bislang sind die Bestellperioden der Aufsichtsräte noch nicht flexibilisiert.
- Der Aufsichtsrat erhält keine auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Vergütungskomponente sondern eine feste Vergütung. Um die Überwachungsaufgaben zweckgemäß und unabhängig durchführen zu können, hält der Aufsichtsrat eine vom Unternehmenserfolg abhängige Vergütung für nicht zielführend.
- + Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen in englischer Sprache.

Auch im nächsten Jahr werden Aufsichtsrat und Vorstand der SÜSS MicroTec AG wieder eine Entsprechenserklärung gemäß dem dann aktuell geltenden Kodex abgeben.

Garching, im Dezember 2003



Für den Vorstand  
Dr. Franz Richter



Für den Aufsichtsrat  
Dr. Winfried Süß

# Konzernlagebericht und Lagebericht

## Die Unternehmensgruppe

Der SÜSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Märkten bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern, z.B. im Rahmen des SECAP-Konsortiums, Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

### Wesentliche Standorte der Gruppe

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Deutschland | Asslar, Dresden, München, Vaihingen |
| USA         | Waterbury VT, Palo Alto CA          |
| China       | Shanghai                            |
| Frankreich  | St. Jeoire                          |
| GB          | Wokingham                           |
| Japan       | Yokohama                            |
| Taiwan      | Hsin Chu                            |

## Vorausschauende Aussagen

Sämtliche im Lagebericht enthaltenen Aussagen, die keine vergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen wie in dem US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 festgelegt. Worte wie „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „rechnen mit“, „schätzen“, „sollen“, „sollten“, „können“, „werden“ und „planen“ sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf das Unternehmen sollen solche vorausschauenden Aussagen anzeigen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauende Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse zahlenmäßig von den Erwartungen abweichen können. Die

vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden.

## Unternehmensentwicklung und Marktlage im Jahr 2003

Nachdem bereits der Umsatzrückgang in 2002 erheblich war (-41%), musste in 2003 nochmals ein deutlicher Rückgang von 127,5 Mio. Euro auf 92,6 Mio. Euro (-27%) registriert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die weiterhin anhaltende Investitionszurückhaltung unserer Kunden zurückzuführen. Teilweise mitverantwortlich ist aber auch die Entwicklung auf den Devisenmärkten, wo der Euro im Vergleich zum Vorjahr gegenüber dem US-Dollar erheblich aufgewertet wurde. Bei dem für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendeten Durchschnittskurs ergab sich eine Aufwertung des Euro um 21% gegenüber dem US-Dollar. Daher wird im Lagebericht auch auf währungsbereinigte Zahlen verwiesen, um Währungseffekte und deren Einfluss auf unser operatives Geschäft darzustellen.

Der Umsatzrückgang vollzog sich 2003 in allen Regionen, was vor allem auf die allgemeine schlechte weltweite konjunkturelle Lage zurückzuführen ist. Beim Auftragseingang stellte sich währungsbereinigt eine Stabilisierung ein; dieser liegt nun schon seit zehn Quartalen zwischen 21 und 30 Mio. Euro.

Unverändert war auch in 2003 die geringe Nachfrage nach Produktionsmaschinen, die unsere wesentlichen Umsatzträger darstellen. Sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz sind überwiegend auf manuelle Geräte zurückzuführen, die deutlich niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise aufweisen. Da die typischen Anwendungen für diese Geräte nicht im Produktionsumfeld liegen, folgt dieses Volumen nicht zwingend dem jeweiligen Zyklus. Erfreulich ist die positive Entwicklung unserer neuen Produkte, vor allem im Bereich der so genannten „SupraYield“-Technologie für Mask Aligner und der neuen Substrat Bonder, hier vor allem der so genannte Bond Cluster mit Plasma-Aktivierung für Produktionsanwendungen.

Im ersten Halbjahr 2003 gab es keine wesentliche Veränderung im Marktumfeld. Die bereits im Geschäftsbericht 2002 beschriebene Situation,

- keine Erholungstendenzen bei unseren wichtigen Kunden und
- keine positiven Impulse hinsichtlich der allgemeinen Konjunkturlage,



war unverändert vorhanden. Daher mussten wir im ersten Quartal des Jahres 2003 unsere Restrukturierungsmaßnahmen nochmals ausweiten. So wurde einerseits der Standort Singen nach Vaihingen verlagert, andererseits wurde am Standort Dresden ein Mitarbeiterabbau durchgeführt. Die einzelnen Standorte weisen nun eine gestraffte Struktur auf, die gemessen an den Mitarbeiterzahlen nun jeweils mit der Struktur von 1999 vergleichbar ist.

Im zweiten Halbjahr 2003 gab es jedoch auf Kundenseite und bezüglich der Konjunktorentwicklung die ersten positiven Signale, die für das Jahr 2004 eine Erholung erwarten lassen:

- Seit etwa zwei Quartalen können die Mikrochiphersteller bereits wieder bessere Ergebnisse berichten. Dies ist immer die Voraussetzung dafür, dass auch die Ausrüstungsindustrie wieder bessere Geschäfte erwarten kann. In verschiedenen Teilbereichen ist inzwischen diese Markterholung zu beobachten.
- Das Volumen der produzierten Chips erreichte in 2003 einen neuen Höchststand. Dieser kann nicht an den Umsatzzahlen der Chiphersteller abgelesen werden, weil die erzielbaren Durchschnittspreise deutlich unter denen von 2000 und 2001 liegen.
- Die Kapazitätsauslastung bei den Herstellern und den Foundries liegt teilweise bereits über 90%; Research Institute warnen heute bereits vor massiven Kapazitätsengpässen. Wir gehen davon aus, dass bei erholten Durchschnittspreisen Kapazitätserweiterungen – dann auch durch Einbindung von neuen Technologien – durchgeführt werden.

Bei der allgemeinen Konjunkturlage zeigte sich die Entwicklung in den USA als positiver Indikator für eine Erholung der Weltwirtschaft. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass insbesondere die währungspolitische Situation für 2004 hier besondere Risiken aufweist. So stellt das doppelte Defizit der USA, bestehend aus Staatsdefizit und Handelsbilanzdefizit, ein erhebliches Risiko für eine Erholung der Weltwirtschaft dar. Sollte sich der Kapitalzufluss in die USA nicht erholen, könnte ein anhaltender signifikanter Abwertungsdruck auf den US-Dollar die Erholung vor allem in Europa spürbar bremsen und sogar völlig zum Erliegen bringen.

## Strategische Positionierung

Im Jahr 2003 konnten wir unsere Marktposition sowohl hinsichtlich der Technologie- und Kostenführerschaft als

auch hinsichtlich der Marktanteile weiter verbessern. Aufbauend auf den im Jahr 2002 initiierten Maßnahmen wurden die Aktivitäten im Jahr 2003 ausgeweitet. Während 2002 mit der Einführung der 300mm-Gerätegeneration das Advanced Packaging noch im Mittelpunkt stand, wurden in 2003 auch in unseren anderen Zielmärkten Fortschritte in der Akzeptanz unserer Technologie erzielt. Die wesentlichen Maßnahmen und Ergebnisse im Überblick:

- Mit der „SupraYield“-Technologie für SÜSS MicroTec-Mask Aligner stößt die Vollfeldbelichtung in neue Auflösungsgrenzen unterhalb 1 Mikrometer vor. Damit werden viele Anwendungen in der Mikrosystemtechnik und bei den Verbindungshalbleitern für Mask Aligner wieder erreichbar.
- Unser größter Foundry-Kunde weitete auch 2003 seine 300mm-Kapazitäten nochmals aus. Bezogen auf die Wettbewerbssituation ist besonders bemerkenswert, dass ausschließlich in SÜSS MicroTec-Equipment investiert wurde.
- Die SECAP-Linie für 300mm-Advanced Packaging-Anwendungen ist nun operativ im Einsatz. Sowohl die Performance der Produktionsprozesse vom Produktionsanwender, Unitive Taiwan, als auch die SÜSS MicroTec-Ergebnisse von Demonstrationsprozessen für Kunden erfüllen unsere Erwartungen in vollem Umfang.
- Um in dem sich sehr gut entwickelnden Markt für Mikrosystemtechnik die Kunden noch besser integrieren zu können, wurde auch für diesen Markt ein Konsortium unter Beteiligung von SÜSS MicroTec gegründet (MEM-UNITY als Abkürzung für MEMS-Community). Erfreulich ist auch, dass einer unserer Mitarbeiter in den USA zum Chairman der neu geschaffenen International MEMS Steering Group (IMSG), einer Interessengruppe innerhalb des SEMI-Verbandes, gewählt wurde.
- Die für die Mikrosystemtechnik entwickelten neuen Substrat Bonder wurden vom Markt sehr gut angenommen. Insbesondere sind die neuen Bond Cluster-Systeme mit der SÜSS MicroTec „nanoPREP“-Technologie auf große Resonanz gestoßen; erste Aufträge wurden bereits platziert. „nanoPREP“ ist eine neue Technologie, die das Bonden von Siliziumscheiben bei so niedrigen Temperaturen ermöglicht, dass Halbleiterschaltkreise diese Temperaturen schadlos überstehen. Dass dieser Prozess zusätzlich noch unter Vermeidung von Vakuumprozessen möglich ist, wurde vom Markt fast als revolutionär empfunden.
- Große Bedeutung hatte die verstärkte Investition in die Applikationsunterstützung für die sich schnell weiterentwickelnden Märkte. Insbesondere im Rahmen der Vorstellung der neuen „SupraYield“- und „nanoPREP“-Technologie bei unseren Schlüsselkunden zeigte sich,

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

dass das Verständnis für die Probleme des Kunden und in vielen Fällen die gemeinsam mit den Kunden durchgeführte Entwicklung von Lösungsansätzen, wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Marktbearbeitung darstellen.

Um zukünftig weniger starke Einflüsse der Währungsschwankungen auf unser Ergebnis zu haben, werden wir schrittweise die Wertschöpfung im US-Dollar-Raum erhöhen – derzeit wird die Wertschöpfung zu ca. 75% bis 80% im Euro-Raum und nur zu ca. 20% bis 25% im US-Dollar-Raum erwirtschaftet. Ziel ist es, den auf Dollar basierten Anteil an den Herstellkosten auf ca. 35% bis 40% zu erhöhen.

Mit höchster Priorität werden unsere F&E-Aktivitäten betrieben, da diese den größten Beitrag für eine weiterhin zukunftssträchtige und nachhaltige strategische Positionierung liefern.

Dass die Halbleiterindustrie zwar sehr zyklisch verläuft, aber weiterhin hohes Wachstumspotential aufweist, zeigt nachfolgende Grafik, die den Ausblick des SEMI-Verbandes für die kommenden Jahre 2004 bis 2006 auf Basis der aktuellsten Umfrage vom November und Dezember 2003 enthält. In den Schätzungen des Verbandes wird deutlich, dass vor allem Asien langfristig das größte Wachstumspotenzial aufweist. Der Trend einer Verlagerung der Produktion von Halbleitern aus den USA und Europa nach Asien wird fortgesetzt. Für 2006 erwartet die Industrie gemäß dieser

Umfrage den nächsten allgemeinen Abschwung. Die Forecasts unterliegen zwar stets einer sehr großen Unsicherheit, jedoch ist das Maß an Zuversicht nun deutlich höher als etwa in 2002 oder Anfang 2003.

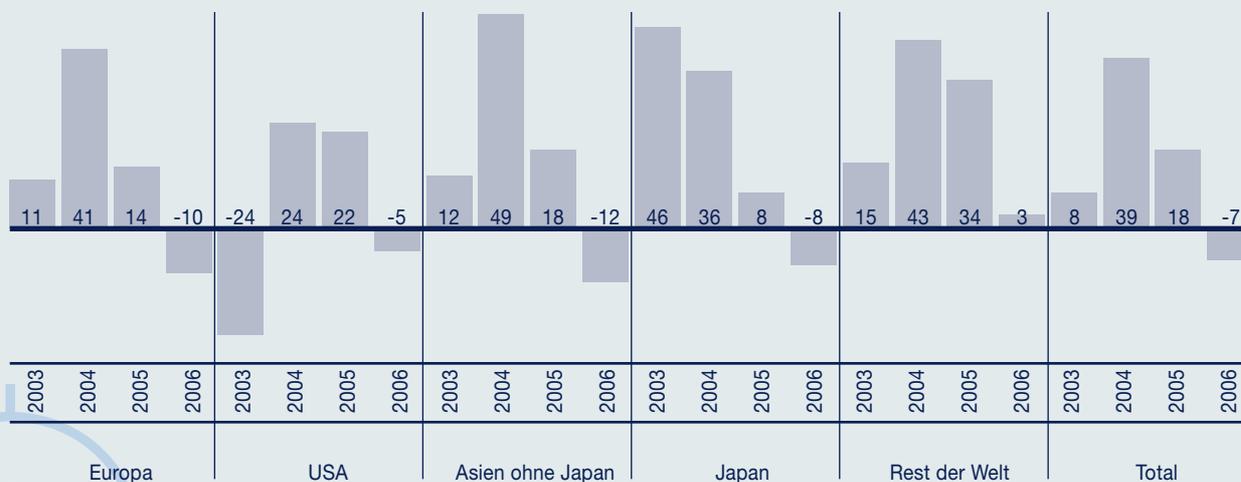
Wir weisen darauf hin, dass der prognostizierte Rückgang in 2006 einen typischen zyklischen Verlauf der Gesamtindustrie darstellt. Wir folgen aufgrund unserer Nischenposition nicht zwingend diesem Zyklus, sind aber grundsätzlich von der Gesamtstimmung in der Industrie abhängig.

### Umsätze und Auftragslage bei den Produktlinien und Regionen

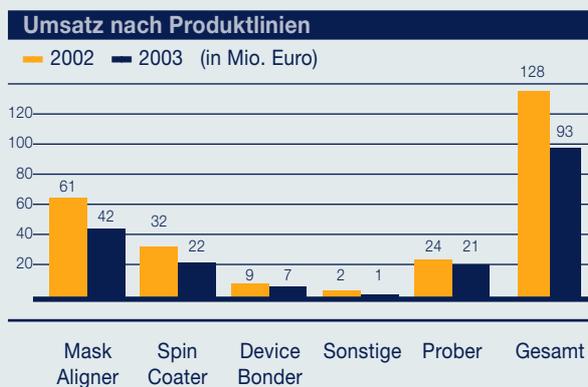
Bei der Umsatzverteilung nach Produktlinien entfallen knapp zwei Drittel auf die Produktlinien *Mask Aligner* und *Spin Coater*. Im Vergleich zum Vorjahr nahm dieser Anteil deutlich ab, was auf die in der Relation stärker gewordenen Umsatzanteile der Produktlinie Prober zurückzuführen ist (siehe hierzu auch „Unternehmensentwicklung und Marktlage in 2003“).

Bei den Mask Alignern mit 41,9 Mio. Euro (Vorjahr: 61,3 Mio. Euro (-32%) Umsatz waren im abgelaufenen Jahr 2003 die manuellen Geräte, die aufgrund des überwiegenden Einsatzgebietes im Entwicklungslabor naturgemäß weniger stark den Produktionszyklen der Halbleiterindustrie unterliegen, abermals wesentlicher Umsatzträger. So ist durch das Fehlen von Produktionsgeräten, deren Verkaufspreise häufig ein Vielfaches der manuellen Geräte darstellen, auch der

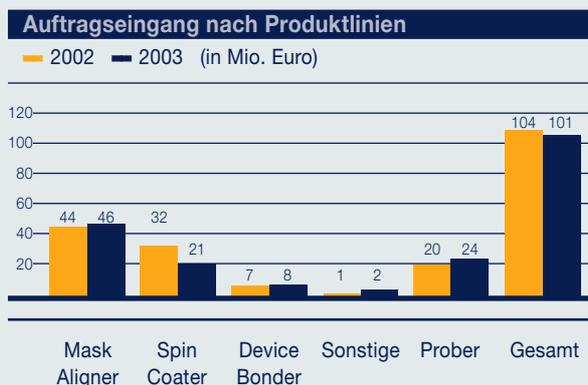
Umsatzerwartungen Halbleiterindustrie (Quelle: SEMI, in Prozent)



relative Rückgang dieser Produktlinie am Gesamtumsatz zu erklären. Sobald die Produktionsgeräte wieder entsprechend Umsätze generieren, wird sich der Umsatzanteil der Produktlinie wieder deutlich erhöhen. Auch das Jahr 2003 bestätigte erneut die Zuverlässigkeit und die Akzeptanz unserer manuellen Mask Aligner.



Bei den *Spin Coatern* mit 21,9 Mio. Euro (Vorjahr: 31,8 Mio. Euro; -31%) Umsatz stellten die 300mm-Geräte einen wesentlichen Umsatzanteil dar. Grundsätzlich gilt für die Spin Coater noch stärker als bei den Mask Alignern, dass bei schwacher Auftragslage bei Produktionsgeräten erhebliche Umsatzrückgänge die Folge sind.



Der Auftragseingang bei den Mask Alignern (45,6 Mio. Euro 2003 gegenüber 43,8 Mio. Euro 2002; +4%) und Spin Coatern (21 Mio. Euro 2003 gegenüber 32 Mio. Euro 2002; -35%) spiegelte, wie bereits erwähnt, vor allem die geringe

Nachfrage nach den höherpreisigen Produktionsgeräten wider. Mit steigender Nachfrage nach diesen Geräten wird sich auch der Auftragseingang dieser Produktlinien erheblich erhöhen. Der deutliche Abfall bei den Spin Coatern ist dadurch begründet, dass wir im Gegensatz zum Mask Aligner hier kein wesentliches Geschäft mit manuellen Geräten betreiben. Daher schwankt die Auftragsentwicklung bei den Spin Coatern noch stärker als bei den Mask Alignern.

Langfristig werden die beiden genannten Produktlinien Mask Aligner und Spin Coater weiterhin rund 70% zum Konzernumsatz beitragen.

Bei den in der Produktlinie Mask Aligner enthaltenen *Substrat Bondern* und *Bond Alignern* konnten im Jahr 2003 erhebliche Fortschritte in der Produktpositionierung erzielt werden. Das Portfolio wurde nahezu komplett ausgetauscht, wobei auf Basis der neuen Technologien hier signifikante Zuwächse bereits für 2004 erwartet werden. In 2003 waren die Umsätze in diesem Bereich noch relativ gering.

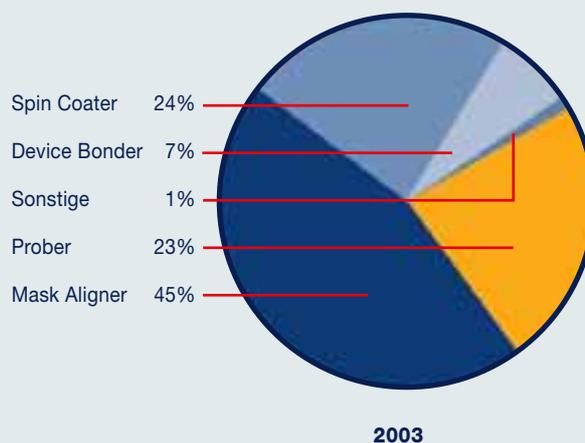
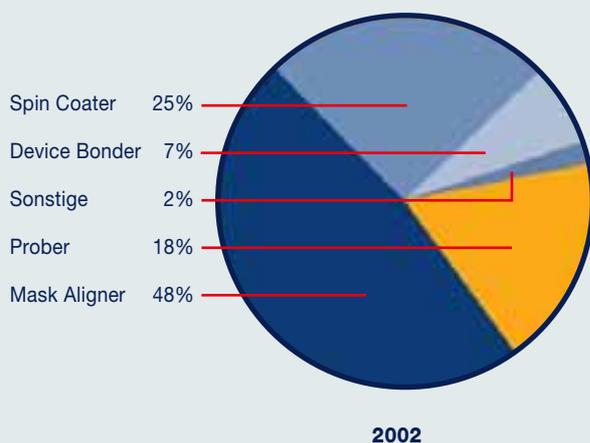
Die Umsatzentwicklung bei den *Device Bondern* mit 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro ; -23%) Umsatz war nochmals rückläufig. Zwar leidet diese Produktlinie weiterhin unter der Schwäche des relevanten Marktumfeldes, der optischen Datenübertragung, jedoch zeichnet sich das Produkt durch eine beeindruckende technische Performance hinsichtlich der Genauigkeit aus. Nordamerika und Japan als die beiden Technologietreiber bleiben für dieses Produkt die wichtigsten Märkte. 2004 könnte, unterstützt durch eine allgemeine Konjunkturbelebung, wieder Wachstumspotenziale für Device Bonder bieten. Wir erwarten mittelfristig Umsatzanteile von ca. 10% aus dieser Produktlinie.

Beim Auftragseingang dieser Produktlinie (7,9 Mio. Euro 2003 gegenüber 7,3 Mio. Euro 2002; +9%) zeigte sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, wobei dies aufgrund der geringen Basis 2002 auch erwartet wurde.

Die *Prober* mit 21,4 Mio. Euro (Vorjahr: 23,5 Mio. Euro; -9%) Umsatz konnten im Jahr 2003 innerhalb des SÜSS MicroTec-Portfolios die stabilste Umsatzentwicklung aufweisen. Der wesentliche Grund dafür ist die Einführung neuer, höherwertiger Prober mit Stückpreisen über 300.000 Euro. Langfristig erwarten wir hier einen Umsatzanteil von ca. 15% bis 20% am Gesamtumsatz, je nachdem in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit weitere

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

### Umsatzanteile der Produktlinien (in Prozent)



Neuentwicklungen vom Markt akzeptiert werden. Beim Auftragseingang konnte mit 24,4 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3 Mio. Euro; +20%) weiterhin eine erhöhte Nachfrage festgestellt werden.

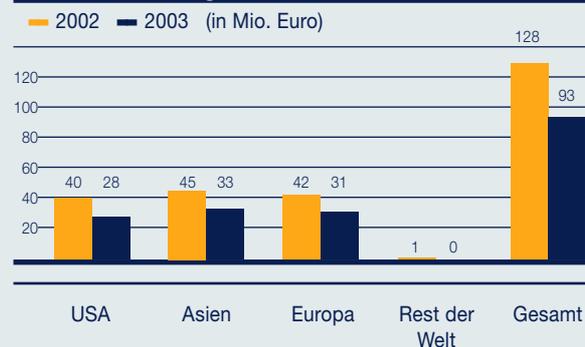
Zusammenfassend für 2003 ergibt sich im Vergleich mit 2002 eine Verschiebung der Umsatzanteile zugunsten der Produktlinie Prober, wobei diese Verschiebung eine Momentaufnahme darstellt. Eine Verteilung wie in 2002 ist langfristig repräsentativer.

### Umsätze und Auftragslage in den Regionen

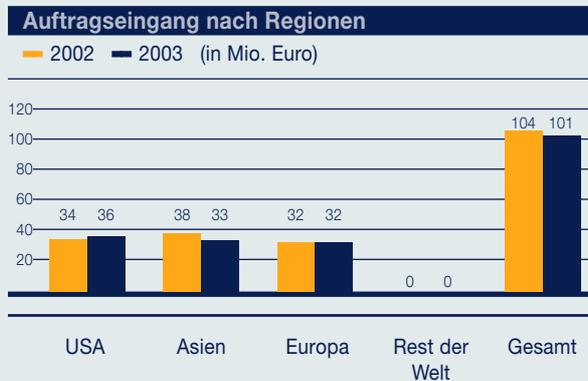
Für 2003 ergab sich eine relativ ausgeglichene Aufteilung der Umsätze auf die Regionen Nordamerika, Europa und Asien. Aufgrund der gegenwärtigen Wechselkursentwicklung und der fortschreitenden Verschiebung der Elektronikproduktionen nach Asien, erwarten wir zukünftig Asien als stärkste Region, während wir für Nordamerika und Europa mittelfristig ähnliche Umsatzanteile auf Euro-Basis für wahrscheinlich halten. Der Umsatzrückgang in 2003 gegenüber 2002 wurde im Wesentlichen durch den geringeren Auftragsbestand zum Anfang 2003 (32,4 Mio. Euro) im Vergleich zum Anfang 2002 (57,6 Mio. Euro) und den sich nicht erholenden Auftragseingang innerhalb des Geschäftsjahres verursacht.

Beim Auftragseingang entwickelte sich währungsbereinigt Nordamerika positiv, während Asien im Vergleich zu 2002 rückläufige Zahlen aufweist.

### Umsatz nach Regionen



In Nordamerika gingen die Umsätze von 39,6 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro (-28%) zurück. Hier wirkte zusätzlich eine Reduzierung aufgrund der Abschwächung des US-Dollar. Beim Auftragseingang wurde mit 35,6 Mio. Euro der Vorjahreswert von 34,5 Mio. Euro (+3%) übertroffen, was vor allem aufgrund der Währungseffekte als Erfolg zu werten ist: Auf Dollarbasis konnte ein Anstieg von 33 Mio. US-Dollar auf 41 Mio. US-Dollar (+25%) erreicht werden. Die Region zeichnet sich grundsätzlich durch einen gesunden Mix aus Geschäft mit manuellen Geräten und Produktionsgeräten aus, wobei wir hier neben Testsystemen derzeit vor allem die Bereiche Verbindungshalbleiter und Mikrosystemtechnik bedienen. Außerdem konnten wir eine entsprechende Belegung bei den Angebotsaktivitäten insbesondere im zweiten Halbjahr 2003 feststellen. Auch die Großkunden zeigten nun wieder gesteigertes Interesse an Equipment, und wir erwarten



dieser Region zukünftig wieder höhere Umsatzanteile aus dem Bereich Advanced Packaging.

Die Region Asien verzeichnete einen Umsatzrückgang von 44,9 Mio. Euro auf 33,1 Mio. Euro (-26%). Auch beim Auftragseingang musste eine rückläufige Entwicklung registriert werden (32,7 Mio. Euro in 2003 gegenüber 37,6 Mio. Euro im Vorjahr; -13%). Vor allem in Taiwan, Singapur und Südkorea werden größtenteils Produktionsgeräte in den Bereich Advanced Packaging verkauft, und daher unterliegt diese Region stärkeren Schwankungen – die Ausführungen bei den Produktlinien Mask Aligner und Spin Coater können 1:1 auf diese Region übertragen werden. Ohne Berücksichtigung von Japan mussten wir hier einen Rückgang beim Umsatz von 33,4 Mio. Euro auf 24,3 Mio. Euro (-27%) verzeichnen, während der Auftragseingang von 27,5 Mio. Euro auf 21,3 Mio. Euro (-22%) zurückging. Japan nimmt innerhalb dieser Region eine Sonderstellung ein, da wir hier derzeit nur in geringerem Maße Produktionsgeräte verkaufen und vor allem in den Bereichen Testsysteme und Mikrosystemtechnik tätig sind. Auch war das Jahr 2002 in Japan extrem schwach, so dass hier die Entwicklung in 2003 sogar positiv war: Die Umsätze fielen zwar noch um 23% von 11,5 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro, aber der Auftragseingang erhöhte sich um 13% von 10,1 Mio. Euro auf 11,4 Mio. Euro.

In Europa bedienen wir neben den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging auch eine Reihe weiterer Anwendungen der allgemeinen Forschung und Entwicklung. Ähnlich wie in Nordamerika sahen wir in Europa aufgrund des geringeren Auftragsbestands zu Jahresbeginn und des nicht hinreichend ansteigenden Auftragseingangs, einen deutlichen Rückgang des Umsatzes von 42,2 Mio. Euro in 2002 auf 30,9 Mio. Euro

(-27%) in 2003. Der Auftragseingangs konnte sich im selben Zeitraum mit 32,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (31,9 Mio. Euro; +2%) leicht verbessern.

## Auftragsbestand

Das Verhältnis zwischen neu eingegangenen Aufträgen und den realisierten Umsätzen, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, lag 2003 bei 1,09 (2002: 0,82). Dieser Wert führte aber nicht zu einer signifikanten Erhöhung des zum jeweiligen Stichtagskurs bewerteten Auftragsbestandes, was vor allem auf zwei Effekte zurückzuführen ist (Jahreswerte):

- -1,9 Mio. Euro Währungseffekte durch den deutlich gefallen US-Dollar;
- -4,9 Mio. Euro Bereinigungen (davon 2,6 Mio. Euro Stornierungen).



Der Auftragsbestand enthält üblicherweise Aufträge für die nächsten 3 bis 6 Monate, wobei in Ausnahmefällen auch spätere und frühere Liefertermine fixiert sein können.

## Finanzielle Entwicklung

### Vermögens- und Finanzlage

In der ersten Jahreshälfte waren vor allem die Zahlungseingänge aus Forderungen für eine stabile Liquiditätsposition verantwortlich. Diese Entwicklung ist saisonal typisch, da in diesem Zeitraum die höheren Umsätze des vorangegangenen vierten Quartals zu entsprechenden Zahlungen führen. Hinzu kam im ersten Halbjahr eine Steuererstattung in den USA von knapp 4 Mio. US-Dollar basierend auf der Möglichkeit, Verluste vollumfänglich auf zurückliegende Gewinne zurückzutragen.

KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

Ebenso typisch war der signifikante Rückgang der Liquidität im dritten Quartal, wobei hier vor allem Sonderposten wirksam wurden. So wurden zurückgestellte Gewerbesteuern für 2001 in Deutschland gezahlt, in Frankreich wurden noch ausstehende Zahlungen für die Restrukturierung 2002 geleistet. Dies zeigt sich in der Bilanz in den im Verlauf des dritten Quartals 2003 deutlich verringerten sonstigen Verbindlichkeiten. Auch bei den in dieser Position enthaltenen Kundenanzahlungen waren kaum Impulse vorhanden (2,7 Mio. Euro Ende 2003 gegenüber 3,4 Mio. Euro Ende 2002), und wir erwarten auch in 2004 keine erheblichen positiven Effekte aus einem Anstieg der Anzahlungsquote von Kunden. Zwar bleibt es unser Ziel, bei neuen Aufträgen eine Anzahlung zu vereinbaren, was aber von der aktuellen Geschäftsentwicklung abhängig ist. Bei der Zahlungsmoral der Kunden ergab sich zum Ende des Jahres 2003 eine nochmalige Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Der Wert für die Außenstandstage (Days Sales Outstanding; DSO) lag bei 67 (Vorjahr: 72). Hier bestätigt sich bereits über mehrere Jahre die hohe Qualität unseres Forderungsbestandes, der beständig nur sehr geringe Ausfallquoten aufweist.

Aufgrund der niedrigen DSO und des insgesamt geringeren Forderungsbestandes zum 31.12.2003 wird jedoch der zusätzliche Liquiditätseffekt aus den Zahlungseingängen im ersten Halbjahr 2004 deutlich geringer sein als in den Vorjahren. Daher rechnen wir für das erste Halbjahr 2004 derzeit nicht mit einem entsprechend positiven Free Cash Flow (Operativer Cash Flow abzüglich der Investitionen in

Anlagevermögen), wie dies in 2003 und insbesondere 2002 noch der Fall war. Beim Lagerbestand wurde, bedingt durch den niedrigen Umsatz, unser Zielwert für das Jahresende von 40 Mio. Euro mit effektiven 42 Mio. Euro nicht ganz erreicht. Das Working Capital hat somit noch nicht die von uns gewünschte Größenordnung und bindet noch immer zu hohe Finanzmittel. Wir sind aber zuversichtlich, vor allem beim Lager im Jahr 2004 deutliche Fortschritte zu machen, wenn vor allem die 200mm-Produktionsgeräte wieder entsprechenden Umsatzbeitrag liefern. Denn diese Geräte bestimmen wesentlich unseren zyklusabhängigen Teil des Lagers, der ca. 35% des Gesamtbestandes betrifft. Soweit eine Lagererhöhung nur auf neuen Produkten, z.B. 300mm oder Bond Cluster, beruht, nehmen wir solche Positionen im technologieorientierten Teil des Lagers (Anteil am Gesamtlager ca. 15%) bewusst in Kauf. Die restlichen 50% des Lagers, der zyklusunabhängige Teil mit Reichweiten innerhalb unseres Zielkorridors von 180 Tagen, betrifft die manuellen Mask Aligner und Spin Coater, die Prober und die Ersatzteile.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung des Working Capital im Jahr 2004 würde vor allem ein schnelles Wachstum die bestehende Liquidität in erhöhtem Maße beanspruchen. Aufgrund der aktuellen Situation der deutschen Großbanken ist eine entsprechende Zurückhaltung bei der Fremdkapitalbereitstellung deutlich erkennbar; dies belegen auch Umfragen hinsichtlich der Entwicklung der Kreditvergaberegulungen. Wir haben uns deshalb im vierten Quartal entschlossen, eine Wandel-

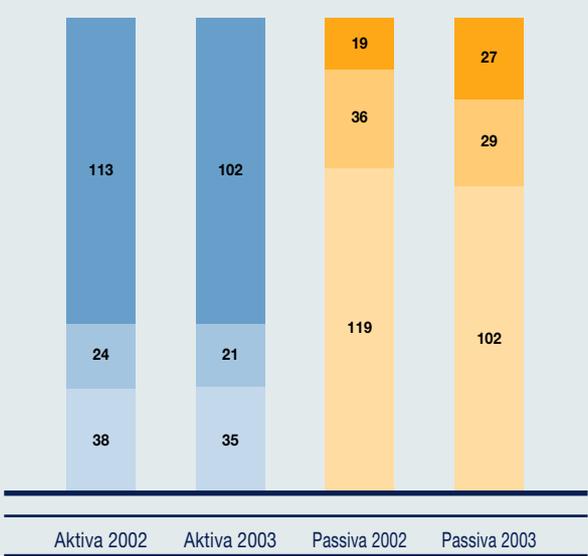
Cash Flow-Zyklus (in Mio. Euro)



schuldverschreibung zu begeben. Die Kursentwicklung zu diesem Zeitpunkt sahen wir als den richtigen Zeitpunkt an: Einerseits war das absolute Kursniveau dazu geeignet, entsprechenden Zufluss darzustellen, andererseits beinhaltete der Kurs noch anteiliges Potenzial für einen weiteren Kursanstieg.

Initial flossen uns aus der Wandelanleihe 11,64 Mio. Euro zu, davon 11,27 Mio. Euro aus der ersten und 0,37 Mio. Euro aus der zweiten Tranche. Bei einer Ausübung der Optionen aus der zweiten Tranche würde ein weiterer Zufluss von 3,57 Mio. Euro entstehen. Mit dieser erhöhten Liquidität sehen wir uns nun in der Lage, die kommende Erholungsphase aus eigener Kraft finanzieren zu können. Mit Einbezug der Wandelanleihe verringerten sich die Finanzschulden im Konzern auf 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro). Unsere mittelfristige Strukturierung der Passivseite für das bestehende Geschäftsmodell sehen wir mit dieser Transaktion als ausreichend an.

**Bilanzstruktur Konzern**  
(in Mio. Euro)



- langfristiges Fremdkapital
- kurzfristiges Fremdkapital
- Eigenkapital
- Umlaufvermögen
- Sonstiges Anlagevermögen
- Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzstruktur des Konzerns stellt sich auch am Ende des Jahres 2003 aufgrund der Eigenkapitalquote und der geringen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten unverändert als sehr gesund und solide dar. Unsere Einschätzung vom vergangenen Jahr, dass auch eine schwache wirtschaftliche Entwicklung in 2003 von der Bilanzstruktur verkraftet werden kann, hat sich bestätigt.

Per Ende des Jahres 2003 verfügte der Konzern über 26,8 Mio. Euro (Vorjahr: 16,9 Mio. Euro) liquide Mittel, denen 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro) kurzfristige Bankverbindlichkeiten gegenüber standen. Die verfügbare offene Barkreditlinie zum Jahresende lag bei 13,2 Mio. Euro (Vorjahr: 14,7 Mio. Euro), so dass die verfügbare Liquidität insgesamt über 37 Mio. Euro (Vorjahr: 28 Mio. Euro) betrug.

**Investitionen**

Wesentliche Investitionen fanden in 2003 nicht statt. Investitionen erfolgten nur im Rahmen von dringend notwendigen Ersatzinvestitionen für Büroeinrichtungen und Equipment für die Fertigungsbereiche.

**Ertragslage**

Die Rohertragsmarge als wesentlicher Indikator für die Ertragskraft stieg in 2003 im Vergleich zum Vorjahr nur marginal. Die wesentlichen Faktoren sind vor allem:

- Der weiter abgeschwächte US-Dollar reduziert die Rohertragsmarge, da ein Großteil der in den USA zu gleichen US-Dollar Preisen verkauften Geräte in der Eurozone hergestellt wurden.
- Im Rahmen der Schließung der Betriebsstätte Singen fielen als Einmaleffekt Sonderabschreibungen auf das Lager an.

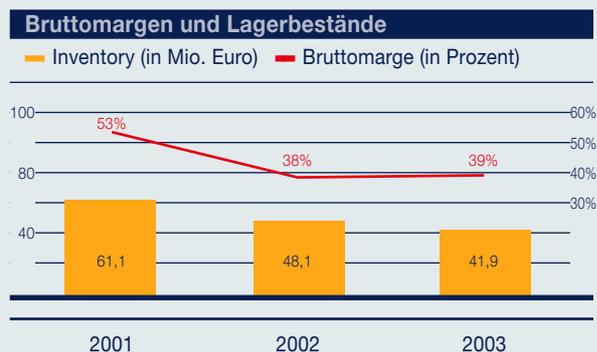
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Überkapazitäten im Produktionsbereich auf ähnlichem Niveau (der positive Effekt aus der Restrukturierung wurde durch den Umsatzrückgang nahezu kompensiert), so dass die Auslastung selbst für den Jahresvergleich der Margen keinen signifikanten Einfluss darstellt. Gleiches gilt für die auf hohem Niveau verharrenden Wertberichtigungen auf Lagerbestände und den Preisdruck, denn auch diese beiden Faktoren waren schon in 2002 zu verzeichnen.

Die für 2003 erwartete deutlichere Margenverbesserung trat vor allem aufgrund des fehlenden Umsatzwachstums und des dadurch ausbleibenden Lagerabbaus nicht ein.

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

Bei den 300mm-Geräten jedoch konnten 2003 positive Lernkurveneffekte registriert werden. Für 2004 sehen wir steigende Margen vor allem dann, wenn Skaleneffekte durch höheren Umsatz wirksam werden. Mittelfristig liegt unsere Zielmarge bei Annahme eines US-Dollar Wechselkurses im Bereich von 1,20 US-Dollar / Euro bei über 45%.

Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter (auf Jahresendwert gerechnet) ging im Vergleich zum Vorjahr nochmals zurück auf 0,129 Mio. Euro (2002: 0,145 Mio. Euro). Die Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten stellten in 2003 44% (2002: 38%) des Gruppenumsatzes dar. Die Änderung der Relation basiert auf dem niedrigen Umsatz, wo wir von einer Auslastung von etwa 65% in 2003 ausgehen. Bei Erreichen einer der Struktur entsprechenden, profitablen Umsatzgröße von ca. 130 Mio. Euro würde sich der prozentuale Satz auf etwa 30% reduzieren,



da bei einem solchen Umsatz keine signifikanten zusätzlichen variablen Kosten in diesem Bereich entstehen würden. Dennoch wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir absolut die Kosten in diesem Bereich seit 2001 von 55 Mio. Euro auf 41 Mio. Euro, also um mehr als ein Viertel gesenkt haben.

Im Finanz- und sonstigen Ergebnis führte der weiter steigende Euro wie bereits im Vorjahr zu signifikanten Buchverlusten bei internen US-Dollar-Darlehen. Diese Buchverluste würden bei einer Abschwächung des Euro wieder anteilig zu Buchgewinnen führen. Nur ein geringer Teil der internen Ausleihungen konnte in 2003 abgesichert werden, so dass Ergebnisschwankungen in dieser Position auch in 2004 erwartet werden.

Im Steuerergebnis ist als eine wesentliche Komponente die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf aktive

latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 1,8 Mio. Euro bei Konzerngesellschaften in Japan und den USA zu nennen. Diese Wertberichtigungen sind länderspezifisch bedingt durch die teilweise zeitlich eingeschränkte Nutzbarkeit.

Die fehlende Belegung des Auftragseingangs im vierten Quartal 2003 war für diese Wertberichtigung entscheidend, da zu Beginn des Jahres 2004 nun nicht genügend Auftragsbestand vorhanden ist, der eine Nutzung dieser Verlustvorträge mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sichern würde. Bei späterer Ausnutzung der Verlustvorträge würde eine entsprechend niedrigere effektive Steuerquote entstehen.



### Die Holding – SÜSS MicroTec AG

(Hinweis: Den Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Investor Relations-Abteilung.)

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt u.a. die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für die Corporate Identity auf den Gebieten Investor Relations und Marketing verantwortlich. Die Holding ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften.



Ohne Sondereffekte erzielt die Holding in der Regel einen Jahresüberschuss aus Ergebnisbeiträgen von den Beteiligungen sowie aus dem Finanzergebnis, wo durch interne Darlehensvergaben und kurzfristige Finanzierungen entsprechende Zinseinkünfte entstehen.



Die Ausleihungen und Forderungen der Muttergesellschaft an verbundene Unternehmen verringerten sich von 55 Mio. Euro in 2002 auf 43 Mio. Euro in 2003, was im Wesentlichen auf die Rückführung von kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen, sowie den Abwertungen auf die Ausleihungen und Forderungen gegen die SÜSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH zurückzuführen ist. Verschiebungen innerhalb dieser Bilanzpositionen ergaben sich durch die Umschuldung von kurzfristigen Forderungen in langfristige Darlehensverträge im Verlauf des Jahres 2003.

Die bereits erwähnte Wandelschuldverschreibung ist bilanziell als Verbindlichkeit in der Holding abgebildet.

**Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding**

**SÜSS MicroTec AG (Handelsrecht, in Tausend Euro)**

|                              | 2003    | 2002    | Änderung | in % |
|------------------------------|---------|---------|----------|------|
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -8.962  | -1.656  | -7.306   | 441  |
| Eigenkapital                 | 92.870  | 99.769  | -6.899   | -7   |
| Bilanzsumme                  | 117.519 | 117.555 | -36      | 0    |
| EK-Quote in %                | 79      | 85      |          |      |
| Anlagevermögen               | 81.065  | 74.844  | 6.222    | 8    |
| ...% der Bilanzsumme         | 69      | 64      |          |      |
| Umlaufvermögen*              | 36.454  | 42.711  | -6.257   | -15  |
| ...% der Bilanzsumme         | 31      | 36      |          |      |

\* inkl. aktiver Rechnungsabgrenzung

**Darstellung der finanziellen Kennzahlen des Konzerns**

**Konzern (US-GAAP in Tausend Euro)**

|                              | 2003    | 2002    | Änderung | in % |
|------------------------------|---------|---------|----------|------|
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | -14.553 | -8.938  | -5.615   | 63   |
| Eigenkapital                 | 102.409 | 118.534 | -16.125  | -14  |
| Bilanzsumme                  | 158.851 | 173.956 | -15.105  | -9   |
| EK-Quote in %                | 64      | 68      |          |      |
| Anlagevermögen               | 56.774  | 61.263  | -4.489   | -7   |
| ...% der Bilanzsumme         | 36      | 35      |          |      |
| Umlaufvermögen               | 102.079 | 112.693 | -10.614  | -9   |
| ...% der Bilanzsumme         | 64      | 65      |          |      |

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Holding für das Geschäftsjahr 2003 waren wie bereits im Vorjahr Sondereffekte für den Jahresfehlbetrag von -9,0 Mio. Euro (Vorjahr: -1,7 Mio. Euro) verantwortlich. Nachstehend die wesentlichen Sondereffekte:

- 2,7 Mio. Euro Buchverluste überwiegend auf gegebene, nicht gesicherte US-Dollar-Darlehen (dieser Effekt war ebenfalls in 2002 vorhanden).
- 0,5 Mio. Euro Kosten aus der Begebung der Wandelanleihe.
- 5,5 Mio. Euro Abwertungen auf die Ausleihungen und Forderungen gegen die SÜSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH.

Das Entstehen weiterer Sondereffekte bei der Muttergesellschaft im Geschäftsjahr 2004 ist abhängig von der weiteren Entwicklung des US-Dollars und vor allem vom weiteren Geschäftsverlauf in der Gruppe. So war in 2003 keine wesentliche Wertberichtigung auf Beteiligungsbuchwerte und Forderungen gegen verbundene Unternehmen notwendig; eine fehlende Geschäftsbelegung in 2004 jedoch könnte zu signifikantem Wertberichtigungsbedarf im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG führen.

**Mitarbeiter**

In der SÜSS MicroTec AG waren zum Ende des Geschäftsjahres 2003 18 (Vorjahr: 18) Mitarbeiter und 2 Vorstände tätig.

Zu Beginn des Jahres 2003 waren 878 Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt. Im ersten Quartal 2003 wurde die Betriebsstättenverlagerung von Singen nach Vaihingen beschlossen und durchgeführt. Ebenso erfolgte ein Mitarbeiterabbau in Dresden im Verlauf des ersten Halbjahres 2003.

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

Ende des Jahres 2003 lag aufgrund dieser Maßnahmen der Mitarbeiterbestand bei 716, davon waren 27 Auszubildende.

Notwendige Kostensenkungsmaßnahmen sind in unserem Unternehmen naturbedingt im Wesentlichen mit Mitarbeiterabbau verbunden. Soweit es möglich und vertretbar ist, versuchen wir, stets sozial ausgewogen die notwendigen Schritte durchzuführen. Zwar lassen sich soziale Härten nicht grundsätzlich vermeiden, jedoch nehmen wir unsere Verantwortung für die Mitarbeiter, auch in solchen Situationen, gemäß unseren Möglichkeiten wahr.

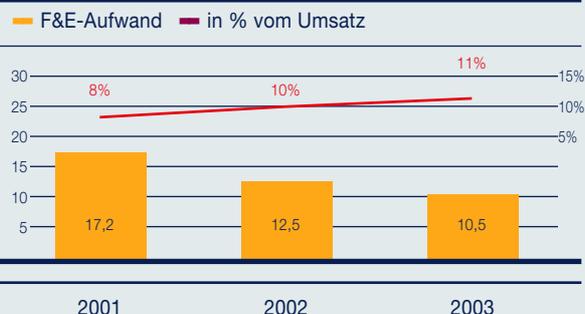


### Forschung und Entwicklung

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) sind von wesentlicher Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit sowohl der bestehenden als auch der zukünftigen Produkte.

Entwicklungsaufwendungen wurden für alle Produktlinien in erheblichem Umfang getätigt, da nur durch die permanente Weiterentwicklung der technologische Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern gehalten oder sogar weiter ausgebaut werden kann. Da auch in 2003 ein entsprechender Anteil der F&E-Aktivitäten direkt im Bezug zu Kundenaufträgen erfolgte, befindet sich ein Teil der F&E-Kosten in den Herstellkosten des Umsatzes. Die in der Grafik dargestellte Quote würde sich unter Hinzurechnung dieser Kosten nochmals erhöhen. Gerade in Zeiten der konjunkturellen Marktschwäche ist es wichtig, die Ausgangsposition für den nächsten Aufschwungzyklus zu verbessern. Dies haben wir durch die Markteinführung neuer Produkte oder Technologien in allen Produktlinien erreicht.

### F&E-Aktivitäten



### Produktlinie Mask Aligner

Für die größte Produktlinie, die Mask Aligner, wurde mit der neuen „SupraYield“-Technologie die Anwendungsgrenze hinsichtlich der Strukturgröße bei Produktionsanwendungen von bisher ca. 5 Mikrometer ( $\mu\text{m}$ ) auf unterhalb 1  $\mu\text{m}$  verschoben. Diese Erweiterung des Anwendungsbereichs eröffnet potentielle Märkte in der Größenordnung von ca. 100 Mio. Euro pro Jahr. Da die Halbleiterindustrie aufgrund der komplexen Herstellungsprozesse extrem zurückhaltend ist, Fertigungsabläufe zu ändern bzw. neue Fertigungsverfahren einzusetzen, wird die nennenswerte Erschließung dieses potenziellen Marktes allerdings einige Jahre in Anspruch nehmen.

„SupraYield“ ist die Kombination verschiedener Technologien, die den Mask Aligner zu einer vorher nie da gewesenen Präzision bei der Strukturübertragung verhilft. Die beiden wichtigsten Elemente sind die sogenannte „Mask Pellicle“- und die „ThermAlign Technology“.

Die „Mask Pellicle“-Technologie (MPT) beruht auf einem von Motorola patentierten Verfahren, das von SÜSS MicroTec lizenziert und in die Mask Aligner integriert wurde. Die Fähigkeit besonders kleine Strukturen von einer Photomaske auf den Silizium-Wafer zu übertragen, hängt bei der Mask Aligner-Lithographie direkt von dem Abstand zwischen Maske und Silizium-Wafer ab. Aufgrund der haftenden Oberfläche der Maske (sticky effect) und den gegebenen Unebenheiten der Maske und des Wafers, konnte dieser Abstand bisher nicht wesentlich kleiner als 20  $\mu\text{m}$  sein, damit ein Kontakt zwischen Maske und Wafer und damit Beschädigungen der Wafer-Oberfläche sicher vermieden werden. Genau hier setzt MPT an. Durch eine Beschichtung der Maskenoberfläche mit einem teflonarti-

gen Material wird die Eigenschaft der Maskenoberfläche so verändert, dass kein Photoresist mehr an der Maske haften bleibt. Damit wird erreicht, dass Berührungen zwischen Maske und Silizium-Wafer nicht mehr zu Fehlern im Belichtungsergebnis führen und folglich der Abstand zwischen Maske und Wafer während der Belichtung kleiner gewählt werden kann. Im Extremfall, bei direkter Kontaktbelichtung, können nun Strukturen bis in die Größenordnung von 0,5 µm sicher übertragen werden.

Die zweite wichtige technologische Verbesserung des Mask Aligners wird über die sogenannte „*ThermAlign*“-Option erreicht. Nachdem der Mask Aligner nun mit Hilfe der „Mask Pellicle“-Technologie sehr viel kleinere Strukturen übertragen kann, rückt die Frage der Positioniergenauigkeit der Übertragungsstrukturen auf dem Wafer wieder in den Vordergrund. Bisher war bei einer Strukturgröße von oberhalb 5 µm eine Positioniergenauigkeit von +/- 1 µm völlig hinreichend, da in diesem Falle zwei übereinander liegende Strukturierungsebenen immer noch hinreichende Überdeckungsgenauigkeit aufwiesen. Wenn die Strukturen nun aber dank MPT kleiner werden, muss auch die Positioniergenauigkeit dieser Struktur auf dem Wafer nachziehen. Durch eine thermische Kopplung der Maske zum Wafer wird die Positioniergenauigkeit während der Belichtung deutlich verbessert. Dank dieser Technologie, „*ThermAlign*“ genannt, können die Auswirkungen schädlicher Temperatureffekte während der Belichtung auf weniger als +/- 0,3 µm verringert werden. Damit wird der Mask Aligner erst zu einem Produktionsgerät, das Strukturierungsaufgaben bis in den Sub-Mikrometerbereich ermöglicht.

### **Produktlinie Spin Coater/ Developer Cluster-System**

Bei den Spin Coater/Developer Cluster-Systemen standen vor allem die Ausentwicklung der automatischen Produktionssysteme und hier insbesondere die Abrundung der Produktportfolios an der unteren Preisgrenze im Vordergrund.

Die von SÜSS MicroTec bedienten Anwendungen liegen im Packaging, im sogenannten „Backend of Line“ (BEOL) der Halbleiterfertigung und weisen einen erheblichen Unterschied zu den Anwendungen im sogenannten „Frontend of Line“ (FEOL) auf. Im Frontend (FEOL) sind aufgrund der kleinen Strukturen die Anforderungen an die Genauigkeit und die Reinraumqualität um ein Vielfaches höher als im Packaging bzw. im gesamten BEOL. Deshalb werden im FEOL die Fabriken immer komplexer und immer weiter

automatisiert. Menschliche Arbeitskräfte müssen soweit wie eben möglich aus der Produktion entfernt werden, da der Mensch der wesentliche Partikelerzeuger in einem Reinraum ist. Dagegen sind im BEOL die Anforderungen an die Reinraumqualität deutlich reduziert, da die hier verarbeiteten Strukturen ca. um einen Faktor 10 bis 100 größer sind als im FEOL. Dies ändert auch die Anforderungen an die Eigenschaften der Produktionsgeräte, die nun eher in Richtung Kostenreduzierung zielen.

SÜSS MicroTec hat diesem Umstand Rechnung getragen und Produktionsgeräte entwickelt, die speziell für die Anwendungen des BEOL konzipiert wurden. Neben den vollautomatischen Coater- und Developercluster, die eher für eine Fabrik mit hohem Automatisierungsgrad, etwa einem IDM (Integrated Device Manufacturer), angeboten werden, rücken heute aufgrund des erhöhten Kostendrucks eher Systeme mit niedrigerem Automatisierungsgrad in den Vordergrund. Diese Produkte werden heute insbesondere in Regionen nachgefragt, in denen halbautomatische Lösungen den vollautomatischen „verclusterten“ Lösungen vorgezogen werden. Dies sind vor allem Länder in Südostasien, in denen Arbeitskräfte im Vergleich zum westlichen Ausland deutlich billiger sind. Die Geräteserie Gamma, die dieser Entwicklung Rechnung trägt, wurde völlig neu überarbeitet und ist heute auf dem neuesten Stand der Entwicklung.

Eine zweite wesentliche Neuentwicklung wurde mit dem neuen *Spray Coater „AltaSpray“* in den Markt eingeführt. Nachdem Spray Coaten seit Anfang der 80er Jahre immer mal wieder als Alternative zum Spin Coaten untersucht wurde, aber nie den Durchbruch geschafft hat, ergeben sich heute aufgrund der Anwendungen in der Mikrosystemtechnik neue Ansatzpunkte für das Spray Coaten. Der wesentliche Vorteil des Spin Coatens ist der sehr einfache Aufbau der Geräte. Der flüssige Photoresist wird in die Mitte des Wafers aufgebracht und durch schnelle Rotation des Wafers (spinning) über die Oberfläche verteilt, im allgemeinen Sprachgebrauch auch: „abgeschleudert“. Dieses Verfahren kommt an seine Grenzen, wenn der Wafer nicht mehr eben ist. Gerade in der Mikrosystemtechnik werden Wafer mit teilweise erheblichen Topographien hergestellt, die dann weiterbearbeitet werden müssen. Ein Auftragen einer Schicht durch Rotation ist in vielen Fällen nicht mehr möglich. Eine Alternative bietet hier das Spray Coaten, bei dem ein stark verdünnter Photoresist mit Hilfe einer Düse auf den Wafer aufgetragen wird. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

beim Spray Coaten bei der Überdeckung von Kanten und Ecken innerhalb der Waferstrukturierung. SÜSS MicroTec hat hierzu ein neues Spray Coat-Verfahren entwickelt und zum Patent angemeldet, das speziell die Kantenüberdeckung beim Spray Coaten verbessert. Dieses Verfahren befindet sich noch in der Anmeldung, so dass hier auf die Darstellung weiterer Details verzichtet werden soll. Erste Aufträge für manuelle Geräte, die dieses Verfahren nutzen, wurden bereits ausgeliefert.

### Produktlinie Testsysteme

Bei den Testsystemen (=Prober) wurden vor allem die Testsysteme für extrem niedrige Temperaturen (*Cryo-Systeme*) und für das *Testen unter Vakuum* weiterentwickelt.

Niedrige Test-Temperaturen bis in den Bereich von minus 250°C, werden sowohl bei Sensoren, die später unter ähnlichen Bedingungen eingesetzt werden sollen, benötigt, als auch bei speziellen Infrarotsensoren, die eine sehr hohe Bildauflösung ermöglichen. Anwendungen finden sich hier vor allem in der Weltraumforschung und in der satelliten-gestützten Sicherheitsüberwachung. Eine neuere Anwendung der hochauflösenden Infrarot-Bildererkennung und Bildverarbeitung ist in der personenbezogenen Temperaturüberwachung zu sehen. Vor dem Hintergrund der SARS-Fälle vor allem in Südostasien hat die berührungslose Temperaturmessung über Distanzen neue Bedeutung erhalten. So werden an den meisten Flughäfen und vielen öffentlichen Gebäuden Kameras eingesetzt, die sehr genau und direkt Temperaturerhöhungen um wenige Grad erkennen können. Das Funktionsprinzip dieser Kameras basiert entweder auf hochempfindlichen Infrarotsensoren oder auf Mikro-Bolometer-Sensoren. Beide Sensoren werden auf SÜSS MicroTec-Probern getestet.

Hochauflösende Infrarotsensoren werden bei Temperaturen des flüssigen Stickstoffs (minus 250°C) betrieben und müssen auch bei diesen Temperaturen getestet werden. Die entsprechenden Testsysteme sind komplexe Maschinen, die die Umgebungstemperaturen nahe des absoluten Nullpunkts realisieren und gleichzeitig beispielsweise ein Niederschlagen der Raumfeuchtigkeit vermeiden müssen. Dies lässt sich sinnvoll nur durch die Verlagerung der gesamten Testanordnung in eine Vakuumanlage realisieren.

Die von SÜSS MicroTec erstmals entwickelten Vakuum-Prober erfreuen sich über diese speziellen Anwendungen

hinaus zunehmender Nachfrage. Viele Anwendungen der Mikrosystemtechnik, wie zum Beispiel die oben genannten Mikro-Bolometer-Sensoren, funktionieren generell nur in Vakuumumgebungen. Bolometer sind Sensoren, die die Temperaturerhöhung eines Testelements infolge Lichteinstrahlung messen. Da die Temperaturerhöhungen in der Regel nur sehr gering sind, würde sich der Messwert unter Atmosphärendruck erheblich verfälschen, da die Umgebungsluft das Sensorelement gleichzeitig zur Messung kühlt. Andere Beispiele finden sich in der Mikromechanik, wo beispielsweise mikroskopisch kleine Schwingkörper von der Umgebungsluft gedämpft und damit abgebremst würden.

Der Markt der Mikrosystemtechnik wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. SÜSS MicroTec ist der wichtigste Anbieter von Testsystemen, die für diesen Markt angepasst wurden. MEMS-Testsysteme von SÜSS MicroTec verknüpfen die charakteristische Kenngröße eines Sensors mit den elektrischen Signalen, die der Sensor als Messsignal liefert. Beispielsweise werden Drucksensoren mit einem definierten Druckstoß beaufschlagt und die elektrische Signalantwort des Sensors wird ausgewertet. In anderen Fällen werden Beschleunigungssensoren auf einem Vibrator physisch beschleunigt oder Mikrophonesensoren einem definierten Schalldruck ausgesetzt. Die neuen MEMS-Testsysteme von SÜSS MicroTec sind heute weltweit führend, wenn es um die Verknüpfung von nicht-elektrischer Anregung mit der elektrischen Signalantwort eines Sensors geht. Nur diese direkte Verknüpfung gibt eine genaue Auskunft über die Funktionsfähigkeit des betreffenden Sensors.

Das Testen kleinster Strukturen innerhalb der neuesten Chipgenerationen nimmt immer größere Bedeutung ein. Mit den sogenannten *MFI-Testgeräten*, die von SÜSS MicroTec weiterentwickelt werden, können Strukturen bis in den Bereich von 150 Nanometer getestet werden. MFI steht dabei für die Firma Micron Force Instruments, die dieses Verfahren erfunden hat und die im Jahre 2001 von SÜSS MicroTec übernommen wurde. Der Name deutet auf das Messprinzip hin, das sich der Technologie der „Atomic Force Microscopy“ bedient.

Dieses Verfahren kann sowohl als Kontaktsystem genutzt werden als auch als System für das berührungslose Testen von Halbleiterschaltungen. Die erste Entwicklungsstufe des Kontaktprobens befindet sich derzeit in der Markteinführung und auch für die zweite Stufe, das kontaktfreie Proben,



wurde bereits ein erster Auftrag gewonnen. Mit Hilfe dieser Technologie werden auch in Zukunft SÜSS MicroTec-Prober führend bei den hochauflösenden Testanwendungen bleiben.

### **Produktlinie Device Bonder**

Mit dem neuen Device Bonder „*Triade*“ wurde ein modifiziertes und weiterentwickeltes Gerät in den Markt eingeführt, das der Forderung nach deutlich höherem Durchsatz bei kleinen Bauteilabmessungen Rechnung trägt. Dabei wurden Veränderungen im Maschinenaufbau vorgenommen, die eine schnellere Handhabung ermöglichen, ohne auf die Genauigkeit beim Bondergebnis zu verzichten.

Mit dem Wegfall des Hauptmarktes für die SÜSS MicroTec-Device Bonder, der Montage von Glasfaser-Laserdioden Verbindungen infolge des Rückgangs der optischen Kommunikationsanwendungen, wurden neue Märkte für diese Geräte gefunden. Insbesondere die Entwicklungen bei speziellen Chipverbindungen für besonders kritische Anwendungen bieten neue Einsatzfelder. Stichworte sind hier die Anwendungen Chip on Wafer oder auch Chip Stacking. Auch wenn diese Anwendungen heute nur relativ kleine Nischen darstellen, so kommt ihnen doch vor dem Hintergrund der immer fortschreitenden Verkleinerung der Package-Abmessungen und der Erhöhung der Leistungsdichte innerhalb eines Packages besondere Bedeutung zu.

Auf der Basis des Device Bonders wurden im Geschäftsjahr 2003 die ersten Aufträge eines „*Nano-Imprint Steppers*“ gewonnen. Das neue Verfahren des Nano-Imprintings wird heute in weiten Bereichen als interessantestes Verfahren zum kostengünstigen Strukturieren von Materialien der Mikrosystemtechnik gesehen. In einigen Bereichen kann Nano-Imprinting als Alternative der grundsätzlich kostenintensiveren Photolithographie gesehen werden.

Bei der Photolithographie wird die optische Struktur einer Photomaske mittels Belichtung in eine Schicht aus Photoresist übertragen. Durch chemische Behandlung während der Entwicklung werden die belichteten Bereiche aus der Photoresistschicht herausgelöst und es wird somit eine topographische Strukturierung der Resistschicht erreicht.

Das Nano-Imprinting kann vereinfacht betrachtet als Stempeltechnik verstanden werden. Dabei wird eine mechanisch strukturierte Glasplatte wie ein Stempel in ein zähflüssiges Material gedrückt, das dann durch Bestrah-

lung mit UV-Licht oder auch durch Temperaturerhöhung des entsprechenden Materials aushärtet. Nach dem Aushärten kann der Stempel entfernt werden und die topographische Strukturierung bleibt in dem Material zurück.

Die Anforderungen an einen Nano-Imprint Stepper werden bereits fast vollständig von dem Device Bonder erfüllt. Anstelle eines Devices, das auf ein Substrat gebondet wird (Device Bonder) greift der Bonder nun eine Glasplatte, setzt diese wie ein zu bondendes Device ab und härtet mittels Temperatur oder UV-Licht aus (bondet!). Anders als beim Devicebonden, wo das Bauteil zum Schluss auf dem Substrat verbleibt, nimmt der Device Bonder beim nano-imprinten die Glasplatte wieder vom Substrat ab und stempelt dann das nächste Feld.

Bei genauerer Betrachtung sind einige Modifizierungen an dem Device Bonder erforderlich, um einen marktauglichen Nano-Imprint Stepper zu erhalten. Diese Modifizierungen sind weitgehend abgeschlossen und es wurde bereits ein erster Auftrag gewonnen.

### **Produktlinie Substrat Bonder**

Mit den neuen automatischen Bond Clustern zum Waferbonden wurde ein wesentlicher Schritt in Richtung Marktführerschaft beim Waferbonden erreicht. Neben der Zuverlässigkeit wurde vor allem die Bondjustiergenauigkeit deutlich verbessert. Mit diesen Überarbeitungen werden unsere Bond Cluster vom Markt als führend angesehen und konnten sich vor allem innerhalb der letzten 6 Monate deutlich durchsetzen.

Eine neue Methode zur Oberflächenvorbehandlung zum Waferbonden wurde mit dem „*nanoPrep*“-Verfahren in den Markt eingeführt. Dieses inzwischen zum Patent angemeldete Verfahren setzt eine Plasma-Aktivierung der Wafer-Oberfläche unter Atmosphärendruck ein und ermöglicht damit das Verbinden von zwei Silizium-Wafern bei für diesen Prozess extrem niedrigen Temperaturen von nur 200°C. Im Temperaturbereich von 200°C bis 300°C werden klassische CMOS-Halbleiterstrukturen nicht zerstört, so dass mit diesem Verfahren selbst Wafer verbondet werden können, auf denen bereits fertige Mikrochips gefertigt wurden. Ohne eine Plasma-Aktivierung müssten Temperaturen im Bereich von 1000°C angewendet werden, um die gleiche Bondfestigkeit zu erreichen. Bei diesen Temperaturen von 1000°C würden allerdings sämtliche CMOS-Strukturen auf dem Wafer wieder verbrennen.

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

Das von SÜSS MicroTec zum Patent angemeldete Verfahren unterscheidet sich von anderen im Markt angebotenen Verfahren zur Plasma-Aktivierung dadurch, dass es unter Atmosphärendruck betrieben wird. Für jeden Produktionsablauf ist die Vakuumanwendung eine ungewünschte, in der Regel aber unvermeidbare Verkomplizierung. Das „nanoPrep“-Verfahren von SÜSS MicroTec trägt hier zu einer wesentlichen Vereinfachung des Produktionsablaufs bei.

### Ausblick

Bei unseren Kunden wurde teilweise bereits im zweiten Halbjahr eine Belebung des Geschäftes in den Quartals- und Jahresabschlusszahlen sichtbar. Daher gehen auch wir nun deutlich optimistischer in das Jahr 2004, als das noch vor einem Jahr für 2003 der Fall war.

Unser Primärziel eines positiven Free Cash Flow haben wir erreicht; eine Ergebnisprognose wurde von unserer Seite aufgrund der extremen Unsicherheiten im Markt nicht gegeben. Entscheidend war und bleibt die Gestaltung einer vernünftigen Konzernstruktur, die den kommenden Aufschwung aktiv mitgestalten kann.

Wir erwarten für 2004 eine Belebung beim Auftragsein-

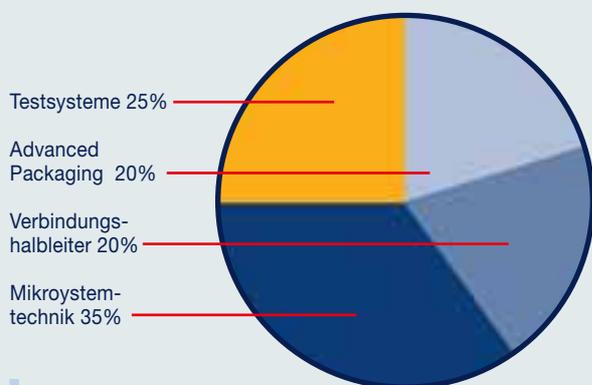
gang, der währungsbereinigt um bis zu 20% über dem Wert dieses Jahres liegen sollte. Entscheidend für den Umsatz im Gesamtjahr 2004 werden vor allem zwei Faktoren sein:

- Zeitpunkt, an dem sich die Erholung in einer Steigerung des Auftragseingangs niederschlägt.
- Die Entwicklung der Wechselkurse, vor allem des Euro gegenüber dem US-Dollar.

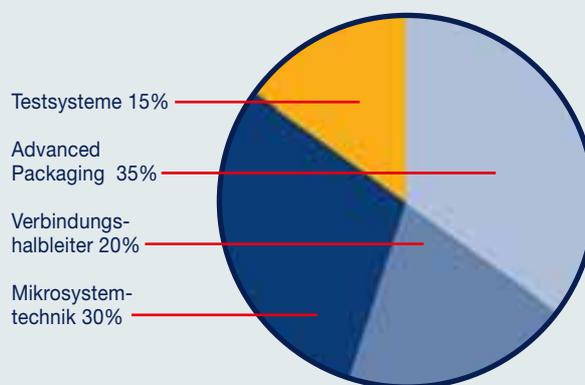
Bei entsprechender Entwicklung beider Faktoren sind wir überzeugt, die Break Even-Schwelle (Umsatz von ca. 115-120 Mio. Euro beim Ergebnis erreichen zu können. Unser primäres Ziel im Jahr 2004 ist die Rückkehr in die Gewinnzone, wobei wir auch hier erst für das dritte Quartal das Erreichen der Gewinnschwelle auf Quartalsebene erwarten. Erst mit Ablauf des vierten Quartals wäre die Gewinnzone für das Gesamtjahr erreicht.

Beim Free Cash Flow hängt die Entwicklung von der Stärke des Umsatzwachstums ab. Bei einem moderaten Wachstum und entsprechend positiven Entwicklungen bei den Lagerbeständen und Kundenanzahlungen erwarten wir erneut einen positiven Free Cash Flow für 2004. Im Falle hoher Umsatzanteile erst im vierten Quartal des Jahres könnte sich die positive Entwicklung im Free Cash Flow auch erst im ersten Quartal des Folgejahres 2005 niederschlagen.

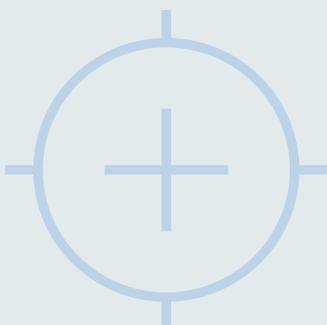
### Aktualisierter Blick auf die Märkte (in Prozent)



Aktuelle Umsatzaufteilung



Langfristige Umsatzaufteilung



### **Advanced Packaging (ADP)**

- Viele Chiphersteller oder so genannte Packaging Foundries haben in den vergangenen Jahren die Technologie des Advanced Packaging eingeführt. Dabei wurde aufgrund des schwierigen Marktumfeldes nur die minimal mögliche Produktionskapazität installiert. Es bestehen bereits erste Kapazitätsengpässe, so dass eine baldige Geschäftsbelebung erwartet wird.
- Weitergehende Entwicklungen hin zu kleineren leistungsstärkeren Geräten erfordern neue Chip-Verbindungstechniken. Nach den Mikroprozessoren werden inzwischen auch weniger komplexe Chips, wie DSP- oder Logic-Bausteine, mit den Methoden des Advanced Packaging verarbeitet.
- Ein zukünftig sehr wichtiges Anwendungssegment des Advanced Packaging wird im Bereich der Speicher-Chips (DRAM) liegen. Während die DRAM-Fertigung sich heute noch ausschließlich klassischer Packaging-Techniken bedient, wird auch dieser Markt zukünftig mehr und mehr die Vorteile des Advanced Packaging nutzen. Vor allem bei der Fertigung von DRAM-Chips auf den neuen 300mm-Wafer-Formaten erwarten wir erst in den Jahren 2005 und 2006 nennenswerte Auftragseingänge.

### **Verbindungshalbleiter (Compound Semiconductors, CSE)**

- Dieser Bereich ist im Wesentlichen durch Anwendungen der Telekommunikation beeinflusst. In den Jahren 1999 und 2000 ist es zu erheblichen Überinvestitionen, insbesondere bei den optischen Datennetzwerken, gekommen. Die hiermit verbundenen Überkapazitäten in den Produktionsstätten der Hersteller optischer Übertragungselemente werden erst langsam ausgelastet, so dass es hier erst bei stärkerem Anstieg der Nachfrage wieder zu neuen Investitionen kommen wird. Auch in 2004 erwarten wir hier keine nennenswerten Impulse.
- Der Bereich LED-Produktion und Laserdioden entwickelt sich positiv. Einzelne Aufträge erhielten wir bereits 2003; in 2004 ist ein weiteres Wachstum aus unserer Sicht relativ wahrscheinlich.

### **Mikrosystemtechnik (MEMS oder MOEMS, MST)**

- Die Mikrosystemtechnik unterscheidet sich von den anderen Feldern durch eine deutlich höhere Diversifizierung, sowohl bei den Produkten selbst, als auch bei den Herstellern dieser Produkte. Im Gegensatz zum

Mikrochip, der in der Regel in großen Stückzahlen extrem kostengünstig gefertigt wird, sind bei den Mikrosystemen die Stückzahlen deutlich geringer und die Variantenvielfalt deutlich höher. Damit hängt die Mikrosystemtechnik nicht an einzelnen Endmärkten, sondern wird vielmehr durch die allgemeine Konjunktur und das Investitionsklima generell beeinflusst.

- Die derzeit stärksten Impulse für die Mikrosystemtechnik kommen nach wie vor von der Automobilindustrie und den Computer-Peripheriegeräten wie Tintenstrahldrucker oder Projektordisplays. Aber auch andere Endmärkte, wie die Umweltsensorik, die Biotechnologien, die chemische Industrie und die neuen Nanotechnologien bieten neue Produktchancen für die Mikrosystemtechnik. 2003 entwickelte sich dieser Bereich bereits positiv; wir erwarten eine Fortsetzung dieses Trends auch in 2004.
- Mit Bezug auf das im letzten Jahr dargestellte Ziel einer Umsatzsteigerung und des Ausbaus unseres Marktanteils auf deutlich über 50% in diesem Bereich sind wir überzeugt, hier unsere Ziele in naher Zukunft erreichen zu können.

### **Testsysteme (TS)**

- Die Produktlinie der Testsysteme hängt für SÜSS MicroTec historisch weit weniger von den Halbleiterzyklen ab, da hier keine Produktionsgeräte, sondern nur Geräte für Anwendungen im analytischen Bereich der Entwicklung oder der Fehleranalyse angeboten werden. Diese Anwendungen werden sehr stark von dem allgemeinen Investitionsklima der Halbleiterindustrie oder anderer Märkte der Hochtechnologie beeinflusst. Mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmendaten weltweit werden hier wieder stärkere Zuwächse auch für SÜSS MicroTec erwartet.
- Die positiven Aussichten für 2003 aus dem letzten Jahr haben sich bei den Testsystemen bestätigt:
- Auf der Basis der Technologie des im Jahre 2001 übernommenen Unternehmens MFI wurden weitere Verbesserungen entwickelt. Ab 2004 erwarten wir Umsatzbeiträge, die aufgrund der technologischen Alleinstellungsmerkmale über die Folgejahre kontinuierlich gesteigert werden sollen.
- Der sogenannte *Cryo-Prober*, der das Testen von Schaltkreisen bei extrem niedrigen Temperaturen von unter minus 250°C erlaubt, wird vom Markt sehr gut angenommen. Gleiches gilt für die *MEMS-Prober*, die für das Testen von Sensoren eingesetzt werden. Dabei werden erstmals die aktiven Sensorelemente in der jeweils relevanten

## KONZERNLAGEBERICHT UND LAGEBERICHT

Kenngroße angeregt. Die Auswertung der elektrischen Reaktion des Sensors ermöglicht dann eine wesentlich genauere Aussage als wenn wie bisher nur ein elektrisches Vermessen des Sensors erfolgt. Mit diesen neuen Verfahren werden beispielsweise Druckmembranen mit einem Druckstoß beaufschlagt, Silizium-Mikrofone mit einem definierten Schalldruck, usw.

Innerhalb der Regionen sehen wir langfristig etwa gleich starke Regionen Nordamerika und Europa mit jeweils ca. 30%, während Asien die stärkste Region darstellen wird.

Wir sehen das langfristige Potenzial unserer Produkte, insbesondere beim Advanced Packaging, unverändert positiv. Die gesamte Industrie befindet sich am Ende einer rezessiven Phase, die auch unsere Geschäftsfelder nicht unberührt gelassen hat. Innerhalb dieser Geschäftsfelder hat sich jedoch die Marktposition unserer Firma relativ zu den direkten Wettbewerbern weiterhin verbessert, und wir bleiben bei unserer Aussage vom Vorjahr: SÜSS MicroTec ist für den kommenden Aufschwung bestens gerüstet.

### Risiken für die weitere Geschäftsentwicklung

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

#### Allgemeine Risiken

##### *Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung*

Die anhaltende Krise des Halbleitermarktes und die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesem Risiko begegnen wir durch die angepassten Strukturen, die bei wieder zunehmender Geschäftstätigkeit vor allem extern durch Outsourcing ausgeweitet werden sollen.

##### *Zugang zu Fremdkapital*

Wir erwarten zukünftig geänderte Rahmenbedingungen in der Fremdkapitalbereitstellung vor allem durch die Ein-

führung von „Basel II“. Die Minimierung der Abhängigkeit insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir entgegen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cash Flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten.

##### *Währungseinflüsse*

Ein grundsätzliches Risiko könnte ein weiteres langfristiges Erstarren des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen bedeuten, da ab einer gewissen Grenze die derzeitige Aufteilung der Wertschöpfung nicht mehr ergebnisoptimal wäre. Kurzfristige Schwankungen gleichen wir in der Regel durch Sicherungsgeschäfte aus.

##### *Marktpositionierung*

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und dem laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Leitkunden.

##### *Haftungsrisiken*

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potentielle Risiko soweit möglich limitiert.

##### *Abhängigkeit von einzelnen Know-how-Trägern*

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung, abhängig. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert werden soll.



## **Aktuelle Risiken**

### *Struktur und Organisation*

Die notwendigen Anpassungen der Mitarbeiterzahlen und die damit einhergehenden organisatorischen Veränderungen bergen ein Risiko geringerer Prozessqualität in den Abläufen. Dies könnte sich auch auf die Geschäftsentwicklung auswirken.

### *Vermögens- und Ertragslage*

Sowohl bei Aktivwerten der Holding als auch bei der Konzernbilanz könnten bei anhaltend geringen Umsätzen signifikante Wertberichtigungen notwendig werden. Diese hätten wesentliche Auswirkungen auf die Holding Vermögens- und Ertragslage der Muttergesellschaft und des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden. Durch konzernweit gültige Bewertungsregelungen werden bei den Lagerwerten durch entsprechende Wertberichtigungen latente Überbewertungen vermieden.

### *Preisdruck und Währungsentwicklung*

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlich erhöhter Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko entgegnen wir mit einer stetigen Preispolitik, wo wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge verzichten, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten. Weniger kontrollierbar ist die aktuell sehr rasche Abschwächung vor allem des US-Dollars, da Geschäfte in diesem Währungsraum in der Regel mit unverändertem US-Dollarpreis getätigt werden. Hier haben wir bereits aktiv reagiert und werden die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöhen. Jedoch kann dies nicht in der Geschwindigkeit erfolgen, wie es derzeit bei der Währungsentwicklung der Fall ist.

### *Finanzlage*

Kurz- und mittelfristig ist die Liquiditätslage insbesondere durch die Begebung einer Wandelanleihe im abgelaufenen Geschäftsjahr gesichert. Eine langfristig andauernde schwache Entwicklung würde entsprechende Maßnahmen zur Anpassung der Ausgaben bedingen.

### *Politische Rahmenbedingungen*

Neben dem weiter bestehenden Konfliktpotenzial im Nahen Osten könnten im Wesentlichen die Spannungen zwischen China und Taiwan erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf 2004 nehmen. Hinzu kommen Risiken bei der Embargopolitik in mehreren asiatischen Ländern bzw. bei speziellen Kunden der Gruppe, wobei diese Risiken von deutlich geringerem Ausmaß sind.

Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor.

## **Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Am 06.02.2004 wurde uns für insgesamt 200.000 Aktien die Wandlung angezeigt. Dadurch verringern sich die Finanzschulden um 2 Mio. Euro und es erfolgt eine entsprechende Einstellung in die Kapitalrücklage (Eigenkapital).

Garching, 15. März 2004  
Der Vorstand

  
Dr. Franz Richter

  
Stephan Schulak

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| TEUR  | Anhang Nr. | 01.01.2002-<br>31.12.2002 | 01.01.2003-<br>31.12.2003 |
|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>   | VI.4       | <b>132.379</b>            | <b>95.500</b>             |
| Frachtkosten und Provisionen  |            | -4.864                    | -2.885                    |
| <b>Umsatzerlöse netto</b>   |            | <b>127.515</b>            | <b>92.615</b>             |
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen |            | -79.598                   | -56.168                   |
| <b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>  |            | <b>47.917</b>             | <b>36.447</b>             |
| Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten                                 |            | -48.006                   | -40.985                   |
| Forschungs- und Entwicklungskosten  |            | -12.537                   | -10.496                   |
| Abschreibung Goodwill   |            | 0                         | 0                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge                              | V.1        | -401                      | 859                       |
| Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung                                |            | -3.319                    | -2.916                    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>  |            | <b>-16.346</b>            | <b>-17.091</b>            |
| Zinsaufwendungen  |            | -1.309                    | -1.245                    |
| Zinserträge   |            | 479                       | 358                       |
| Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis                                 |            | 6                         | 24                        |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>   |            | <b>-17.170</b>            | <b>-17.954</b>            |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag  | V.2        | 8.232                     | 3.401                     |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>   |            | <b>-8.938</b>             | <b>-14.553</b>            |
| Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*                                  |            | -16.340                   | -17.067                   |
| Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)* |            | -9.419                    | -10.996                   |
| Pro Aktie   | IV.5       |                           |                           |
| Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR                                    |            | -0,60                     | -0,97                     |
| Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR                                      |            | -0,60                     | -0,97                     |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>   |            | <b>-8.938</b>             | <b>-14.553</b>            |
| <b>Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern</b>                          |            |                           |                           |
| Fremdwährungsdifferenzen  |            | -3.192                    | -2.255                    |
| Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung                             |            | -42                       | -14                       |
| Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren                                      |            | 0                         | 47                        |
| <b>Comprehensive Income</b>   |            | <b>-12.172</b>            | <b>-16.775</b>            |

\*) ungeprüft

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses



I KONZERNBILANZ

| TEUR   | Anhang Nr. | zum<br>31.12.2002 | zum<br>31.12.2003 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVA</b>  |            |                   |                   |
| Flüssige Mittel  |            | 16.914            | 26.785            |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto  | III.3      | 34.105            | 23.606            |
| Sonstige kurzfristige Forderungen  | III.4      | 9.249             | 6.603             |
| Vorräte, netto   | III.5      | 48.062            | 41.900            |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | III.6      | 958               | 1.094             |
| Kurzfristige aktive latente Steuern  | V.2        | 3.405             | 2.091             |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>  |            | <b>112.693</b>    | <b>102.079</b>    |
| Sachanlagen  | III.7      | 16.592            | 11.935            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände  | III.8      | 9.679             | 7.305             |
| Goodwill   | III.8      | 28.009            | 28.009            |
| Finanzanlagen  | III.9      | 148               | 144               |
| Langfristige aktive latente Steuern  | V.2        | 4.895             | 7.480             |
| Sonstige langfristige Vermögensgegenstände   | III.10     | 1.940             | 1.901             |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  |            | <b>61.263</b>     | <b>56.774</b>     |
| <b>Summe Aktiva</b>  |            | <b>173.956</b>    | <b>158.853</b>    |
| <b>PASSIVA</b>   |            |                   |                   |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   | IV.1       | 3.531             | 3.154             |
| Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten  | IV.2       | 275               | 158               |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |            | 3.934             | 5.972             |
| Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten   | IV.2       | 223               | 214               |
| Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten   | IV.1       | 3.546             | 2.991             |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  | IV.3       | 24.432            | 16.929            |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>35.941</b>     | <b>29.418</b>     |
| Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten   | IV.1       | 14.501            | 22.423            |
| Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten  | VI.2       | 613               | 473               |
| Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten   | IV.2       | 3.580             | 3.581             |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten  | IV.4       | 735               | 517               |
| Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften  |            | 52                | 32                |
| <b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>19.481</b>     | <b>27.026</b>     |
| Gezeichnetes Kapital/ Genehmigte Anzahl von Aktien zu<br>EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2002 und 31.12.2003); davon<br>ausgegeben (in tsd.) 14.957 (31.12.2002 und 31.12.2003) | IV.5       | 14.957            | 14.957            |
| Kapitalrücklage  |            | 80.911            | 81.561            |
| Gewinnrücklagen  |            | 433               | 433               |
| Gewinnvortrag  |            | 25.637            | 11.084            |
| Kumuliertes Other Comprehensive Income   | IV.5       | -3.404            | -5.626            |
| <b>Summe Eigenkapital</b>  |            | <b>118.534</b>    | <b>102.409</b>    |
| <b>Summe Passiva</b>   |            | <b>173.956</b>    | <b>158.853</b>    |

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses

| KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

| TEUR  | 01.01.2002-<br>31.12.2002 | 01.01.2003-<br>31.12.2003 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |                           |                           |
| Jahresfehlbetrag  | -8.938                    | -14.553                   |
| Wechselkursbedingte Veränderung des kurzfristigen Nettovermögens  | -1.505                    | 134                       |
| <b>Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages zum Mittelabfluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b> |                           |                           |
| Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte  | 1.430                     | 650                       |
| Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhöhung   | 514                       | 0                         |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.200                     | 1.965                     |
| Abschreibung auf den Goodwill   | 0                         | 0                         |
| Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis   | 106                       | 0                         |
| Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen   | 4.174                     | 3.784                     |
| Abschreibungen auf Leasinggegenstände   | 547                       | 322                       |
| Änderung der aktiven latenten Steuern   | -2.556                    | -1.271                    |
| Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen  | -20                       | 551                       |
| Verlust / Gewinn aus Beteiligungen  | -1                        | 4                         |
| Änderung der Wertberichtigung auf Forderungen   | -167                      | 333                       |
| Änderung der Wertberichtigung auf Vorräte   | 811                       | 337                       |
| <b>Veränderungen von Aktiva und Passiva</b>   |                           |                           |
| Änderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 16.866                    | 10.166                    |
| Änderung der Vorräte  | 15.047                    | 5.825                     |
| Änderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens  | 100                       | 366                       |
| Änderung der sonstigen Aktiva   | -5.895                    | 2.685                     |
| Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | -3.543                    | 2.038                     |
| Änderung der sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen   | -10.106                   | -7.503                    |
| Änderung der Pensionsverbindlichkeiten  | -243                      | -8                        |
| Änderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten  | -2.721                    | -238                      |
| <b>Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>6.100</b>              | <b>5.587</b>              |
| <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  |                           |                           |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen   | -2.935                    | -1.010                    |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände                                       | -139                      | -10                       |
| Auszahlungen für Unternehmenserwerb   | -3.356                    | 0                         |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen   | 203                       | 3                         |
| <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.227</b>             | <b>-1.017</b>             |

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses



**TEUR****01.01.2002-  
31.12.2002****01.01.2003-  
31.12.2003****Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus der Begebung einer Wandel- und Optionsanleihe

0

11.642

Kosten der Wandel- und Optionsanleihe

0

-502

Aufnahme von Bankdarlehen

5.677

0

Tilgung von Bankdarlehen

-2.666

-4.275

Änderung von Kontokorrentverbindlichkeiten

-25.991

-377

Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing

-844

-257

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung

34.465

0

Einzahlungen aus Ausübung von Bezugsrechten

317

0

Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung

-1.376

0

**Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit****9.582****6.231****Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes****9.455****10.801**

Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes

-239

-930

Finanzmittelbestand zum Jahresanfang

7.698

16.914

**Finanzmittelbestand zum Jahresende****16.914****26.785****Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung**

Zinszahlungen während der Periode

1.103

773

Einkommensteuererstattungen / -zahlungen während der Periode incl. Vorauszahlungen

3.304

5.273

**Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten**

Zugang zum Finanzierungsleasing

710

0

ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS (ANLAGENGITTER)

| TEUR   | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |                        |                             |                                |              | 31.12.2003    |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
|  | 01.01.2003                            | Währungs-<br>differenz | Zugang aus<br>Investitionen | Umbuchungen/<br>Umgliederungen | Abgang       |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                                       |                        |                             |                                |              |               |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte sowie<br>Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15.339                                | -524                   | 10                          | 0                              | 233          | 14.592        |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert  | 40.581                                | 0                      | 0                           | 0                              | 0            | 40.581        |
|  | <b>55.920</b>                         | <b>-524</b>            | <b>10</b>                   | <b>0</b>                       | <b>233</b>   | <b>55.173</b> |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                                       |                        |                             |                                |              |               |
| 1. Gebäude, Grundstücke  | 7.900                                 | -336                   | 81                          | 0                              | 101          | 7.544         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 10.525                                | -1.534                 | 603                         | 0                              | 57           | 9.537         |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 13.881                                | -598                   | 303                         | -32                            | 771          | 12.783        |
| 4. Fahrzeuge   | 639                                   | -36                    | 23                          | 0                              | 49           | 577           |
| 5. Anlagen im Bau  | 95                                    | 0                      | 0                           | 0                              | 95           | 0             |
| 6. Aktivierte Leasinggegenstände   |                                       |                        |                             |                                |              |               |
| Gebäude, Grundstücke, Einbauten  | 600                                   | 0                      | 0                           | 0                              | 0            | 600           |
| Technische Anlagen und Maschinen   | 933                                   | -53                    | 0                           | 0                              | 0            | 880           |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.297                                 | 135                    | 0                           | 32                             | 0            | 1.464         |
|  | <b>35.870</b>                         | <b>-2.422</b>          | <b>1.010</b>                | <b>0</b>                       | <b>1.073</b> | <b>33.385</b> |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |                                       |                        |                             |                                |              |               |
| 1. Equity-konsolidierte Beteiligungen  | 2.187                                 | 0                      | 0                           | 0                              | 4*)          | 2.183         |
| 2. Übrige Beteiligungen  | 202                                   | 0                      | 0                           | 0                              | 0            | 202           |
|  | <b>2.389</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>4</b>     | <b>2.385</b>  |
|  | <b>94.179</b>                         | <b>-2.946</b>          | <b>1.020</b>                | <b>0</b>                       | <b>1.310</b> | <b>90.943</b> |

\*) Bewertung aus Equity Bilanzierung

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses



| Abschreibungen |                        |              |                                |            | Restbuchwerte |               |               |
|----------------|------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| AfA 01.01.2003 | Währungs-<br>differenz | Zugang       | Umbuchungen/<br>Umgliederungen | Abgang     | 31.12.2003    | 31.12.2002    | 31.12.2003    |
| 5.660          | -177                   | 1.965        | 0                              | 161        | 7.287         | 9.679         | 7.305         |
| 12.572         | 0                      | 0            | 0                              | 0          | 12.572        | 28.009        | 28.009        |
| 18.232         | -177                   | 1.965        | 0                              | 161        | 19.859        | 37.688        | 35.314        |
| 2.874          | -166                   | 709          | 0                              | 26         | 3.391         | 5.026         | 4.153         |
| 5.284          | -715                   | 1.431        | 0                              | 37         | 5.963         | 5.241         | 3.574         |
| 8.741          | -362                   | 1.608        | -19                            | 493        | 9.475         | 5.140         | 3.308         |
| 568            | -31                    | 36           | 0                              | 35         | 538           | 71            | 39            |
| 0              | 0                      | 0            | 0                              | 0          | 0             | 95            | 0             |
| 190            | 0                      | 56           | 0                              | 0          | 246           | 410           | 354           |
| 559            | -38                    | 127          | 0                              | 0          | 648           | 374           | 232           |
| 1.062          | -31                    | 139          | 19                             | 0          | 1.189         | 235           | 275           |
| <b>19.278</b>  | <b>-1.343</b>          | <b>4.106</b> | <b>0</b>                       | <b>591</b> | <b>21.450</b> | <b>16.592</b> | <b>11.935</b> |
| 2.073          | 0                      | 0            | 0                              | 0          | 2.073         | 114           | 110           |
| 168            | 0                      | 0            | 0                              | 0          | 168           | 34            | 34            |
| <b>2.241</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>2.241</b>  | <b>148</b>    | <b>144</b>    |
| <b>39.751</b>  | <b>-1.520</b>          | <b>6.071</b> | <b>0</b>                       | <b>752</b> | <b>43.550</b> | <b>54.428</b> | <b>47.393</b> |

KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG

| TEUR   | Anzahl der Aktien in tausend Stück | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Gewinnvortrag | Kumuliertes Other Comprehensive Income | Total          |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| <b>Stand 01.01.2002</b>  | <b>13.802</b>                      | <b>13.802</b>        | <b>46.716</b>   | <b>433</b>     | <b>34.575</b> | <b>-170</b>                            | <b>95.356</b>  |
| Einzahlung aufgrund Kapitalerhöhung                                | 1.130                              | 1.130                | 33.335          |                |               |  | 34.465         |
| Kosten der Kapitalerhöhung nach Steuereffekt                       |                                    |                      | -862            |                |               |  | -862           |
| Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten                       |                                    |                      | 1.430           |                |               |  | 1.430          |
| Einzahlung aufgrund Ausübung von Bezugsrechten                     | 25                                 | 25                   | 292             |                |               |  | 317            |
| Jahresfehlbetrag   |                                    |                      |                 |                | <b>-8.938</b> |  | -8.938         |
| Fremdwährungsanpassung   |                                    |                      |                 |                |               | -3.192                                 | -3.192         |
| Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung, nach Steuereffekt |                                    |                      |                 |                |               | -42                                    | -42            |
| <b>Stand 31.12.2002</b>  | <b>14.957</b>                      | <b>14.957</b>        | <b>80.911</b>   | <b>433</b>     | <b>25.637</b> | <b>-3.404</b>                          | <b>118.534</b> |
| <b>Stand 01.01.2003</b>  | <b>14.957</b>                      | <b>14.957</b>        | <b>80.911</b>   | <b>433</b>     | <b>25.637</b> | <b>-3.404</b>                          | <b>118.534</b> |
| Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten                       |                                    |                      | 650             |                |               |  | 650            |
| Jahresfehlbetrag   |                                    |                      |                 |                | -14.553       |  | -14.553        |
| Fremdwährungsanpassung   |                                    |                      |                 |                |               | -2.255                                 | -2.255         |
| Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung, nach Steuereffekt |                                    |                      |                 |                |               | -14                                    | -14            |
| Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren                             |                                    |                      |                 |                |               | 47                                     | 47             |
| <b>Stand 31.12.2003</b>  | <b>14.957</b>                      | <b>14.957</b>        | <b>81.561</b>   | <b>433</b>     | <b>11.084</b> | <b>-5.626</b>                          | <b>102.409</b> |

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses



**AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE**

|   | Aktien zum<br>30.09.03 | Optionen zum<br>30.09.03 | Aktien zum<br>31.12.03 | Optionen zum<br>31.12.03 |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>VORSTAND</b>                             |                        |                          |                        |                          |
| Dr. Franz Richter (Vors.)                   | 400.000                | 105.000                  | 400.000                | 105.000                  |
| Stephan Schulak                             | 0                      | 40.286                   | 0                      | 40.286                   |
| <b>AUFSICHTSRAT</b>                         |                        |                          |                        |                          |
| Dr. Winfried Süß (Vors.)                    | 1.039.780              | 0                        | 1.025.000              | 0                        |
| Thomas Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.) | 6.909                  | 0                        | 6.909                  | 0                        |
| Horst Görtz                                 | 3.894                  | 0                        | 3.894                  | 0                        |
| Prof. Dr. Anton Heuberger                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        |
| Dr. Christoph Schücking                     | 500                    | 0                        | 500                    | 0                        |
| Dr. Thomas Sesselmann                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                        |

**UNTERNEHMENSKALENDER**

**2004**

|        |  |
|--------|--|
| 04.05. | Quartalsbericht 2004                       |
| 16.06. | Hauptversammlung SÜSS MicroTec AG, München |
| 03.08. | Halbjahresbericht 2004                     |
| 09.11. | Neunmonatsbericht 2004                     |



**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

**I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit**

Die SÜSS MicroTec AG (das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft") ist durch Umwandlung der Karl SÜSS Verwaltungs GmbH entstanden. Das Unternehmen ist ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching, Sacka und Vaihingen, Deutschland, Waterbury und Palo Alto, USA, und Saint Jeoire, Frankreich. Der Standort Aßlar, Deutschland, wird im Wesentlichen als verlängerte Werkbank (vor allem Auslagerung von Montageleistungen) benutzt. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbständige Vertriebsgesellschaften in Großbritannien, Japan, Thailand, Taiwan und China. In den Ländern, in denen die Gesellschaft nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

**II. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze**

**II.1 Grundlage der Darstellung**

Die Gesellschaft ist seit dem 18. Mai 1999 am geregelten Markt in Frankfurt notiert und ist eines der 30 Tec-DAX-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den Vorschriften der US-amerikanischen Rechnungslegung (US-GAAP) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuch muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Nach § 292a HGB braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsvorschriften wie US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die Gesellschaft die Befreiungsmöglichkeit des § 292a HGB in Anspruch. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 290 Abs. 1 ff. HGB erstellt.

Alle Angaben erfolgen in tausend EURO, sofern nichts anderes vermerkt ist.

**II.2 Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und US-GAAP**

Nachstehend eine Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen US-GAAP und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die für die Gesellschaft von besonderer Relevanz sind:

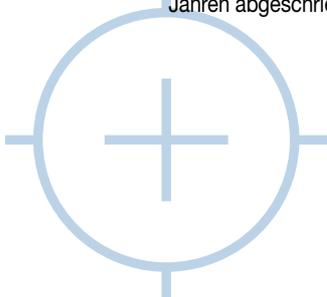
**Sachanlagen**

Bewegliche Sachanlagen werden im Konzernabschluss nach US-GAAP linear abgeschrieben, während nach deutschen Grundsätzen in Anwendung steuerlicher Vorschriften Abschreibungen auch degressiv vorgenommen werden.

Nach US-GAAP werden gemietete Grundstücke, Gebäude und betriebliche Anlagen aktiviert, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Abschreibungen werden über die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter oder über die Laufzeit des Leasingvertrages vorgenommen, je nachdem welche kürzer ist. Die sich aus zukünftigen Leasingzahlungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen werden als Verbindlichkeiten erfasst. Nach deutschen Grundsätzen ist die buchhalterische Behandlung der Anlagengegenstände entsprechend, allerdings sind die zu erfüllenden Kriterien abweichend.

**Goodwill**

Nach US-GAAP wird Goodwill seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens jährlich auf Werthaltigkeit überprüft. Nach deutschem Recht wird Goodwill weiterhin planmäßig über die geschätzte Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren abgeschrieben. Eine Überprüfung der Werthaltigkeit erfolgt nur wenn Anhaltspunkte dafür bestehen.



## **Latente Steuern**

Nach deutschen Grundsätzen werden aktive latente Steuerabgrenzungsposten, die von einem steuerlichen Verlustvortrag herrühren, nicht angesetzt. Allein aus den Bewertungsunterschieden zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften sich ergebende aktive latente Steuerabgrenzungsposten dürfen angesetzt werden. Für die passive latente Steuerabgrenzung ist eine Rückstellung zu bilden.

Nach US-GAAP besteht eine Aktivierungspflicht für aktive latente Steuern, unabhängig ihres Ursprungs, und eine Passivierungspflicht für passive latente Steuern. Hinsichtlich des Bilanzausweises als kurz- und langfristig folgen diese Abgrenzungsposten der Klassifizierung derjenigen Posten, die zu den Bewertungsunterschieden Anlass gaben. Aktive latente Steuerabgrenzungsposten werden daraufhin untersucht, ob die Realisierung dieser Posten wahrscheinlich ist und, falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

## **Sonstige Rückstellungen**

Nach US-GAAP sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nur zu bilden, wenn mit dem Eintritt der Verpflichtung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist und der Verpflichtungsbetrag hinreichend sicher geschätzt werden kann. Nach deutschen Grundsätzen sind Rückstellungen auch dann zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme gerechnet wird, d.h. diese hinlänglich wahrscheinlich ist.

## **Pensionsrückstellungen**

Nach US-GAAP werden die entstandenen Rentenverpflichtungen nach dem Ansammlungsverfahren der "Projected Unit Credit" Methode berechnet. Dabei wird der rückstellungspflichtige Barwert der Pensionsverpflichtung von Jahr zu Jahr um den Barwert des von den Arbeitnehmern hinzuverdienten Anspruchs erhöht. Berechnungsgrundlage für diese jährlichen Pensionskosten ist der Barwert der erdienten Pensionsansprüche unter Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltsanpassungen. Der Abzinsungssatz basiert auf dem langfristigen Zinssatz.

Nach deutschen Grundsätzen werden Rückstellungen für Pensionsverbindlichkeiten der Mitarbeiter, die am Abschlusstichtag existieren, gemäß dem steuerlichen Teilwertverfahren ermittelt. Angleichungen für zukünftige Lohn- und Gehaltssteigerungen bleiben unberücksichtigt. Die Verbindlichkeiten werden vollständig als Leistungspflicht gemäß versicherungsmathematischer Bewertung im Hinblick auf Rentenalter, Lebenserwartung und anderer Faktoren unter Verwendung eines festen Jahreszinssatzes von üblicherweise 6% angesetzt.

## **Wandel- und Optionsanleihe**

Nach US-GAAP ist der bei der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung vereinnahmte Betrag in voller Höhe als Verbindlichkeit zu passivieren. Eine Aufteilung in einen Fremdkapitalteil einerseits und einen den Wert des Wandlungsrechtes darstellenden Eigenkapitalteil andererseits ist nicht vorgesehen. Die Aufteilung kann nach HGB vorgenommen werden. Entsprechend wird der zugeflossene Betrag für das Wandlungsrecht als Aufgeld in die Kapitalrücklage eingestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem zu passivierenden Rückzahlungsbetrag der Anleihe und dem Ausgabebetrag einer reinen Anleihe ohne Wandlungsrecht hat Zinscharakter und kann als Disagio aktiviert werden.

Durch die atypische Ausgestaltung der Optionsanleihe, wonach im Ergebnis das Gläubigerrecht bei Optionsausübung untergeht, entfällt die grundsätzlich nach US-GAAP vorgesehene Trennung in Eigen- und Fremdkapital. Folglich erfolgt wie bei der Wandelanleihe eine Passivierung des zugeflossenen Betrages als Verbindlichkeit.

Die Kosten im Zusammenhang mit der Wandel- und Optionsanleihe sind nach US-GAAP nicht bei ihrer Entstehung als Aufwand zu erfassen, sondern von der passivierten Verbindlichkeit abzugrenzen.

## **Fremdwährungsumrechnung**

Nach US-GAAP werden Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden erfolgswirksam behandelt. Nach deutschen Grundsätzen gilt für Fremdwährungsforderungen das Niederstwertprinzip und für Fremdwährungsverbindlichkeiten das Höchstwertprinzip. Daraus folgt, dass nur unrealisierte Verluste

I **ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

erfolgswirksam antizipiert werden, während unrealisierte Gewinne aus Wechselkursentwicklungen zum Bilanzstichtag unberücksichtigt bleiben.

**II.3 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach US-GAAP**

**Derivative Finanzinstrumente**

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) NO. 133 „Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities“ ergänzt durch SFAS NO. 137 „Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities – Deferral of the Effective Date of FASB Statement NO. 133 an amendment of FASB Statement No.133“, SFAS NO. 138 „Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities“ und SFAS NO. 149 „Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments and Hedging Activities“. Derivative Finanzinstrumente werden zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen Vermögensgegenständen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Marktwertänderungen werden grundsätzlich erfolgswirksam erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

**Flüssige Mittel**

Die flüssigen Mittel beinhalten sowohl Bankguthaben als auch kurzfristige Kapitalanlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als drei Monaten.

**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen.

Die Kunden des Unternehmens sind konzentriert in der Halbleiterindustrie, sie sind jedoch geographisch gestreut. Keiner der einzelnen Kunden hat einen wesentlichen Anteil an den Gesamterlösen des Unternehmens. Ebenso bestehen keine wesentlichen Forderungen gegenüber einzelnen Kunden.

**Wertpapiere**

Wertpapiere und Beteiligungen werden mit Marktpreisen bewertet, sofern diese verfügbar sind. Unrealisierte Gewinne und Verluste von Wertpapieren, die nach SFAS NO. 115 als zum „Verkauf bestimmt“ klassifiziert werden („available for sale“), werden unter Berücksichtigung von Steuern im übrigen Comprehensive Income ausgewiesen. Die sonstigen Wertpapiere werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Auf alle Wertpapiere oder Beteiligungen werden bei nicht vorübergehenden Wertminderungen Abschreibungen vorgenommen.

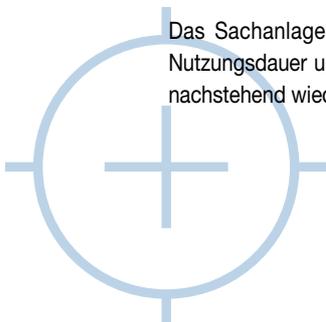
**Vorräte**

Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet. Herstellungskosten beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten. Für alle Vorräte mit Ausnahme von halbfertigen und fertigen Erzeugnissen wird die FIFO-Methode (first-in, first-out) für die Bewertung verwendet. Die Herstellungskosten beinhalten auch Service-Umsätzen direkt zuordenbare Kosten.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer oder geminderten Verwendbarkeit ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

**Sachanlagen**

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauer für die wesentlichen Anlagekategorien ist nachstehend wiedergegeben:



|  |               |
|--|---------------|
| Gebäude, Außenanlagen und Mietereinbauten          | 10 – 40 Jahre |
| Software   | 3 – 5 Jahre   |
| Technische Anlagen und Maschinen                   | 4 - 5 Jahre   |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3 – 5 Jahre   |
| Fahrzeuge  | 5 Jahre       |

Reparatur- und Wartungsaufwendungen werden sofort erfolgswirksam erfasst. Wesentliche Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen werden, soweit sie den Wert des Anlagegegenstandes erhöhen bzw. dessen Nutzungsdauer wesentlich verlängern, aktiviert. Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Fremdkapitalzinsen, die für einen Vermögensgegenstand während seiner Bauzeit anfallen, werden aktiviert und beginnend mit der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme über die voraussichtliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird zwischen Finanzierungsleasing und Operating Lease unterschieden. Finanzierungsleasinggegenstände werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen aktiviert bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim Operating Lease erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der Leasingzahlungen im Aufwand.

### **Goodwill**

Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmter Nutzungsdauer werden gemäß SFAS NO. 142 "Goodwill and Other Intangible Assets" seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Goodwill wird jährlich bzw. bei Eintritt besonderer Ereignisse, die zu einer Verringerung des Marktwertes der jeweiligen Berichtseinheit (Reporting Unit) führen können, auch unterjährig, einer Werthaltigkeitsprüfung (Impairment Test) unterzogen. Als Reporting Units identifizierte das Unternehmen im Wesentlichen die einzelnen Konzerngesellschaften.

Die Werthaltigkeitsprüfung des Goodwill umfasst zwei Schritte: In einem ersten Schritt wird der Marktwert einer Reporting Unit mit dem Buchwert einschließlich Goodwill verglichen. Falls der Buchwert den Marktwert einer Reporting Unit übersteigt, gilt dieses als Anzeichen für einen möglichen Wertberichtigungsbedarf des Goodwill, und es ist ein zweiter Schritt erforderlich. In diesem zweiten Schritt wird der implizite Marktwert des Goodwill einer Reporting Unit mit dem Buchwert dieses Goodwill verglichen. Der implizite Marktwert des Goodwill entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert der Reporting Unit und den auf sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Reporting Unit zugeordneten Marktwerten, ähnlich der Vorgehensweise im Rahmen einer Unternehmensakquisition gemäß SFAS NO. 141. Unterschreitet der implizite Marktwert den Buchwert dieses Goodwill, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen.

Im Rahmen der Anwendung von SFAS NO. 142 führte das Unternehmen den Goodwill-Impairment Test durch, der zu keiner Wertberichtigung des Goodwill führte.

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmter Nutzungsdauer werden seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr abgeschrieben. Diese Vermögensgegenstände werden jährlich - bzw. im Falle von Ereignissen, die auf eine Wertminderung hindeuten können - auch unterjährig auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Der Impairment Test für immaterielle Vermögensgegenstände mit unbestimmbarer Nutzungsdauer basiert auf einem Vergleich des Marktwertes mit dem Buchwert des immateriellen Vermögensgegenstands. Sollte der Buchwert den Marktwert übersteigen, wird eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung gebucht.

Immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauer werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

## **ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003**

### **Außerplanmäßige Abschreibungen auf langfristige Vermögensgegenstände**

Entsprechend den Vorschriften des SFAS NO. 144 „Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets“ überprüft der Konzern langfristiges Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände mit bestimmbarer Nutzungsdauer auf Werthaltigkeit, sobald Ereignisse oder veränderte Umstände darauf hindeuten, dass der Buchwert eines Vermögensgegenstandes oder einer Gruppe von Vermögensgegenständen den beizulegenden Wert überschreiten könnte. Die Werthaltigkeit des langfristig genutzten Vermögens wird durch Vergleich des Buchwertes mit den zukünftig aufgrund dessen Nutzung erwarteten Netto-Cash Flows beurteilt. Ist ein Vermögensgegenstand oder eine Gruppe von Vermögensgegenständen nicht mehr werthaltig, so wird die vorzunehmende Abschreibung als Unterschied zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Marktwert bestimmt. Sachanlagen, die gemäß den Voraussetzungen als zum Verkauf bestimmt gelten, werden zum niedrigeren Wert aus Buchwert und Marktwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet.

### **Pensionsverpflichtungen**

Die Pensionsverpflichtungen werden bilanziert gemäß SFAS NO. 87, „Employers Accounting for Pensions“. Die Verpflichtungen, die sich aus den Plänen der deutschen Gruppengesellschaften ergeben, werden mittels der "Projected Unit Credit" Methode berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt.

### **Other Comprehensive Income**

US-GAAP erfordern die Darstellung von Other Comprehensive Income innerhalb des Konzernabschlusses. Other Comprehensive Income wird dabei folgendermaßen definiert:

Alle Veränderungen des Eigenkapitals innerhalb des Geschäftsjahres, die nicht durch Anteilseigner verursacht sind und gewöhnlich nach US-GAAP nicht in den Konzernabschluss eingehen. Solche Vorgänge betreffen Fremdwährungsanpassungen, bestimmte unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren und den über die ansetzbaren immateriellen Vermögensgegenstände hinausgehenden Teil der Mindestverpflichtung aus Pensionsverpflichtungen.

### **Aktionsoptionspläne**

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus Aktienoptionsplänen nach SFAS NO. 123, „Accounting for Stock-Based Compensation“, unter Anwendung der Fair-Value-Methode.

### **Ergebnis pro Aktie (EPS-Earnings per Share)**

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach SFAS NO. 128, „Earnings per Share“.

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird. Die im Jahr 2001 und 2002 ausgegebenen Aktien wurden ab dem Zeitpunkt des Unternehmenserwerbes bzw. der Ausgabe einbezogen.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wurde ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wurde.

### **Umsatzrealisierung**

Das Unternehmen wendet EITF 00-21 „Revenue Arrangements with Multiple Deliverables“ für Verkaufsverträge an, die nach dem 30. Juni 2003 abgeschlossen wurden und mehrere Komponenten beinhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt wird für Mehrkomponentenverträge und für alle anderen Verträge Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 101, "Revenue Recognition in Financial Statements", angewendet.

Umsätze aus Produktverkäufen werden mit Eigentumsübergang an den Kunden realisiert, wenn das Entgelt vertraglich festgesetzt oder



bestimmbar und die Erfüllung der damit verbundenen Forderungen wahrscheinlich ist. Umsätze werden erst nach erfolgter Abnahme durch den Kunden realisiert. Soweit die noch zu erbringenden Leistungen nach der Lieferung wesentlich im Sinne des Auftrages sind, erfolgt eine Realisierung erst nach vollständig erbrachter Leistung.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeiteilig realisiert.

### **Garantieverpflichtungen**

Nach FIN 45 „Guarantors Accounting and Disclosure Requirements für Guarantees, Including Indirect Guarantees of Indebtness of Others“ muss der Garantiegeber Verpflichtungen aus bestimmten eingegangenen Garantien zum Marktwert bilanzieren.

### **Frachten und Provisionen**

Ausgangsfrachten und Provisionszahlungen an Dritte werden, soweit sie mit dem Verkauf und Vertrieb der Produkte verbunden sind, als Umsatzschmälerung ausgewiesen. Eingangsfrachten für erworbene Produkte im Herstellungsprozess werden den Herstellkosten zugeordnet. Provisionszahlungen an Mitarbeiter des Konzerns werden in den allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebskosten ausgewiesen.

### **Aufwendungen für Werbung, Forschung & Entwicklung**

Aufwendungen für Werbung, Forschung & Entwicklung werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

### **Sonstige Aufwendungen und Erträge**

Die sonstigen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

### **Steuern**

Das Unternehmen wendet SFAS NO. 109 "Accounting for Income Taxes" an. Nach der „Liability-Method“ werden dabei für künftige Steuerzahlungen, die sich aus den Unterschieden von Vermögensgegenständen und Schulden zwischen US-GAAP und lokalen steuerlichen Vorschriften ergeben, aktive latente Steuerabgrenzungsposten sowie Rückstellungen für latente Steuern gebildet. Dabei werden die jeweils gültigen bzw. erwarteten Steuersätze (aktuelle Rechtslage) angewendet, die zum Zeitpunkt der Aufhebung dieser Unterschiede gelten.

Verlustvorträge werden ebenfalls aktiviert und auf ihre zukünftige Realisierbarkeit untersucht. Falls erforderlich, wird eine angemessene Abwertung vorgenommen.

Der jeweils verwendete Durchschnittssteuersatz wird in der Überleitungsrechnung dargestellt. Hierzu verweisen wir auf V.2. Nur für 2003 erhöhte sich der Körperschaftsteuersatz aufgrund des Flutopfersolidaritätsgesetzes von 25% auf 26,5%. Die Effekte wurden bei der Berechnung der latenten Steuern in 2002 berücksichtigt.

Die Verlustbehandlung im deutschen Steuerrecht wurde durch das am 22. Dezember 2003 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung der Protokollklärung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz (sog. Korb II-Gesetz) geändert. Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 sind grundsätzlich künftige Verlustvorträge bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR voll und darüber zu 60% verrechenbar.

Diese Regelung gilt entsprechend für gewerbsteuerliche Verlustvorträge. Außerdem wurde durch das Korb II-Gesetz ein pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an in- und ausländischen Kapitalgesellschaften sowie für Inlandsdividenden eingeführt. 5% dieser Veräußerungsgewinne unterliegen als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

**Bilanzierung von Zuschüssen**

Bei der Bilanzierung von Zuschüssen wird zwischen Investitionszuschüssen und Zuschüssen für Forschungs- und Entwicklungskosten bzw. anderen Aufwandszuschüssen unterschieden. Investitionszuschüsse werden bei Zahlungseingang direkt von den Anschaffungskosten der erworbenen Anlagegüter abgezogen. Die anderen Zuschüsse werden bei Zahlungseingang erfolgswirksam unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen.

**Verwendung von Schätzungen**

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen verlangt Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung, die die im Konzernabschluss aufgeführten Beträge beeinflussen. Die tatsächlichen Werte können von den geschätzten Beträgen abweichen.

**II.4 Konsolidierung**

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Beteiligungsgesellschaften (in der Regel Anteilsbesitz zwischen 20 und 50%), bei denen das Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik ausüben kann, werden nach der Equity-Methode bewertet.

Andere Beteiligungen und Unternehmen, auf die kein wesentlicher Einfluss ausgeübt werden kann bzw. die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

**Unternehmenszusammenschlüsse**

Seit dem 1. Juli 2001 wendet das Unternehmen das Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 141 "Business Combinations" an. Danach werden sämtliche Unternehmenszusammenschlüsse nach der Erwerbsmethode (Purchase Method) bilanziert, d.h. die erworbenen Vermögensgegenstände und übernommenen Schulden werden zu Marktwerten (fair values) angesetzt. Ein nach anteiliger Aufdeckung stiller Reserven und Lasten verbleibender positiver Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und neu bewerteten Vermögensgegenständen und Schulden wird in der Bilanz als Firmenwert (Goodwill) aktiviert. Ist der Zeitwert des übernommenen Reinvermögens höher als die Anschaffungskosten, ergibt sich ein negativer Goodwill nur insoweit, als dieser nach Abstockung der Wertansätze bestimmter langfristiger Vermögenswerte verbleibt. Dieser Badwill wird im Erwerbsjahr als außerordentlicher Ertrag erfasst. Beim Erwerb von Gesellschaften, die nach der Equity-Methode bewertet werden, werden die oben genannten Grundsätze analog angewendet.

**Transaktionen in Fremdwährungen**

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Tageskurs umgerechnet. Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam als Aufwand oder Ertrag im Fremdwährungsergebnis gebucht.

**Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung**

Die funktionale Währung des Konzerns ist der EURO. Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.



|                  | 2003   | 2003   | 2002   | 2002   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  | Bilanz | G&V    | Bilanz | G&V    |
| 1 EUR vs 1 USD   | 1,26   | 1,13   | 1,04   | 0,95   |
| 1 EUR vs 100 JPY | 134,85 | 131,17 | 124,20 | 118,10 |
| 1 EUR vs 1 GBP   | 0,71   | 0,69   | 0,62   | 0,63   |
| 1 EUR vs 1 CHF   | 1,56   | 1,52   | 1,45   | 1,47   |

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (OCI – Other Comprehensive Income) ausgewiesen.

## II.5 Angaben zum Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 sind folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresüberschuss der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung; (\*) = untestiert):

| Gesellschaft   | gezeichnetes Kapital | Beteiligung | Eigenkapital      | Jahresergebnis    | Konsolidierung |
|--|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SÜSS MICROTEC AG, Garching                               | 14.956.884,00 EUR    | Holding     | 92.869.591,86 EUR | -8.961.679,22 EUR |                |
| SUSS MICROTEC LITHOGRAPHY GMBH, Garching                 | 2.000.100,00 EUR     | 100%        | 18.441.095,01 EUR | -5.958.259,64 EUR | voll           |
| SUSS MICROTEC TEST SYSTEMS GMBH, Sacka                   | 511.291,88 EUR       | 100%        | 8.024.520,31 EUR  | 34.035,80 EUR     | voll           |
| SÜSS MICROTEC LAB. EQUIPMENT GMBH, Singen (*)            | 26.000,00 EUR        | 100%        | 63.064,13 EUR     | 2.142.557,52 EUR  | voll           |
| SUSS MICROTEC LTD., Wokingham Berkshire (*)              | £10.000,00           | 100%        | £1.465.495,00     | £53.644,00        | voll           |
| SUSS MICROTEC KK, Yokohama                               | 30.000,00 TJPY       | 100%        | 311.155,00 TJPY   | -140.203,00 TJPY  | voll           |
| SUSS MICROTEC S.A.S., St. Jeoire                         | 1.275.000,00 EUR     | 100%        | 1.809.655,55 EUR  | -760.228,83 EUR   | voll           |
| SUSS MICROOPTICS S.A., Neuchatel (*)                     | 500.000,00 CHF       | 85%         | 263.956,74 CHF    | -236.043,26 CHF   | voll           |
| SUSS MICROTEC INC., Waterbury                            | \$105.000,00         | 100%        | \$13.819.328,00   | -\$5.087.218,00   | voll           |
| SUSS MICROTEC (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (*)        | 5.000.000,00 NTD     | 100%        | 8.927.978,00 NTD  | 3.927.978,00 NTD  | voll           |
| SUSS MICROTEC Company Ltd., Shanghai (*)                 | 1.655.320,00 CNY     | 100%        | 1.980.669,90 CNY  | 325.349,90 CNY    | voll           |
| IMAGE TECHNOLOGY INC., Palo Alto (*)                     | \$24.287,00          | 100%        | \$5.877,00        | -\$920.924,00     | voll           |
| MFI TECHNOLOGIES Group (*)                               | \$2.737.476,00       | 100%        | -\$3.795.200,00   | -\$356.056,00     | voll           |
| HUGLE LITHOGRAPHY INC., Sunnyvale (*)                    | \$1.190.442,00       | 53,1%       | n/a               | n/a               | at equity      |
| SUSS MICROTEC COMP. LTD, Bangkok (*)                     | 4.000,00 TTHB        | 49%         | 10.697,00 TTHB    | 470,00 TTHB       | at equity      |
| KARL SÜSS GESCHÄFTSFÜHRUNGS-GMBH, Garching (*)           | 50.000,00 EUR        | 100%        | 40.940,42 EUR     | -180,94 EUR       | at cost        |
| Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz (*) | 51.129,19 EUR        | 10%         | n/a               | n/a               | at cost        |
| ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand (*)                        | n/a                  | 10%         | n/a               | n/a               | keine          |

Neu im Konsolidierungskreis sind die Vertriebsgesellschaften in China und Taiwan. Beide Gesellschaften wurden im Geschäftsjahr im Wege von Bargründungen errichtet. An beiden Gesellschaften hält die SÜSS MicroTec AG 100% der Anteile.

## II.6 Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2003 keinerlei Akquisitionen vorgenommen. Im Vorjahr fand der im folgenden beschriebene Unternehmenserwerb statt:

### Betrieb der BLE GmbH, Singen

Mit Kaufvertrag vom 16.01.2002 erwarb die Karl Süß GmbH den Geschäftsbetrieb der in Insolvenz befindlichen BLE GmbH, Singen. Die Anschaffungskosten betragen 3.356 TEUR. Mit der folgenden Aufnahme operativer Geschäftstätigkeit wurde die Karl Süß GmbH nebst Sitzverlegung in SUSS MicroTec Laboratory Equipment GmbH, Singen, umbenannt. Die ehemalige Karl Süß GmbH wird daher seit dem 01. Januar 2002 voll konsolidiert.

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003**

**Aufteilung der erworbenen Vermögensgegenstände:**

Durch den Kauf des Betriebs erwarb das Unternehmen alle Rechte an Produkten der Linie Spin Coater. Diese stellen eine strategische Ergänzung des Produktportfolios dar und ersetzen teilweise die eigenen manuellen Spin Coater, da die erworbenen Produkte ein besseres Marktpotenzial aufweisen.

|                                   | Wert TEUR    |
|-----------------------------------|--------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 250          |
| Sachanlagen                       | 246          |
| Vorräte                           | 2.860        |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>3.356</b> |

**II.7 Neue Rechnungslegungsvorschriften**

**FIN 46**

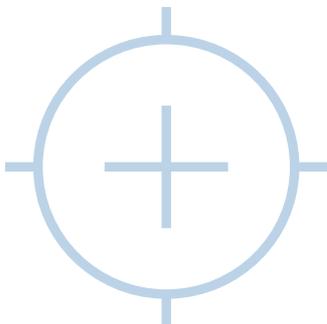
Im Januar 2003 hat der FASB die Interpretation (FIN) 46 „Consolidation of Variable Interest Entities“ veröffentlicht. Mit dieser Interpretation wird die Frage geklärt, wann eine Gesellschaft in Form der Zweckgesellschaft (Variable Interest Entity - VIE) zu betrachten ist und wann die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Minderheitsbeteiligungen und Betriebsergebnisse einer VIE im Konzernabschluss eines Unternehmens auszuweisen sind. Die Interpretation verlangt, dass existierende, nicht konsolidierte Objektgesellschaften vom Meistbegünstigten konsolidiert werden, wenn die Risiken nicht wirklich auf die Beteiligten verteilt sind. Die Interpretation findet sofort Anwendung auf alle Objektgesellschaften, die nach dem 31. Januar 2003 gegründet wurden oder an denen ein Unternehmen nach diesem Datum Anteile erworben hat. FIN 46 ist auf alle Zweckgesellschaften anzuwenden für Berichtsperioden, die nach dem 15. Juni 2003 beginnen. Am 24. Dezember 2003 wurde FIN 46 „Revised“ veröffentlicht. Das Unternehmen plant die Interpretation im 1. Quartal 2004 anzuwenden. Die Gesellschaft erwartet aus der Anwendung der Interpretation keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

**SFAS 150 – Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of Liabilities or Equity or both**

Im Mai 2003 hat das FASB das Statement SFAS NO. 150, Bilanzierung bestimmter Finanzinstrumente mit sowohl Verbindlichkeits- als auch Eigenkapital-Charakter, veröffentlicht. Das Statement regelt, wie Emittenten bestimmte Finanzinstrumente mit Verbindlichkeits- als auch Eigenkapital-Charakter zu klassifizieren und bewerten haben. Es verlangt, dass ein Emittent Finanzinstrumente, die bislang häufig als Eigenkapital klassifiziert worden sind, als Verbindlichkeit (oder bei bestimmten Umständen als Aktiva) auszuweisen hat. Es regelt auch die Klassifizierung bestimmter Finanzinstrumente, die die Verpflichtung zur Ausgabe eigener Aktien enthalten. Das Statement findet Anwendung für Finanzinstrumente, die nach dem 31. Mai 2003 begeben oder modifiziert wurden. Die Anwendung von SFAS NO. 150 hatte keinen materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

**EITF 00-21 „Revenue Arrangements with Multiple Deliverables“**

Im Juli 2003 hat die Emerging Issues Task Force (EITF) eine Übereinkunft für Issue 00-21, “Revenue Arrangements with Multiple Deliverables” (Verkaufsverträge mit mehreren Lieferbestandteilen) (EITF 00-21), getroffen. Diese Vorschrift setzt Kriterien für die Umsatzlegung bei Vereinbarungen, wenn mehrere Vertragsbestandteile in einem Vertrag kombiniert werden. EITF 00-21 erlaubt erst eine Umsatzlegung, wenn ein Marktwert der nicht gelieferten Bestandteile verfügbar ist und der einzelne Bestandteil allein einen Wert für den Kunden besitzt. EITF 00-21 gibt auch Hinweise, wie der gesamte Auftragsumsatz auf die einzelnen Lieferungen aufgeteilt wird. Diese Übereinkunft findet für alle Quartale, die nach dem 15. Juni 2003 begonnen haben, Anwendung. Die Anwendung von EITF 00-21 hatte keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.



### III. Erläuterungen zu den Bilanzaktiva (Werte in Tausend EUR)

#### III.1 Marktwerte der Finanzinstrumente

Die geschätzten Marktwerte der nicht-derivativen Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde.

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

**Flüssige Mittel:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:** Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

**Langfristige Darlehen:** Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten wird durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

**Wandelanleihe:** Zur Ermittlung des fairen Wertes der auf Basis der Wandelanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden würde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Wandelanleihe berücksichtigt. Ebenso wurden Annahmen für das aktuelle Rating des Konzerns getroffen. Dem ausgewiesenen um Mio. 1,4 EUR geringeren fairen Wert der Wandelanleihe steht der Wert der Wandlungsrechte gegenüber.

**Derivative Instrumente** sind zu Marktwerten gemäß den Bankmitteilungen angesetzt.

**Marktwerte** der Finanzinstrumente, die sowohl Aktiv- als auch Passivpositionen der Bilanz betreffen:

|   | 2003<br>Buchwert | 2003<br>Marktwert | 2002<br>Buchwert | 2002<br>Marktwert |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Flüssige Mittel   | 26.785           | 26.785            | 16.914           | 16.914            |
| Forderungen   | 23.606           | 23.606            | 34.105           | 34.105            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                              | -3.154           | -3.154            | -3.531           | -3.531            |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten (inkl. kurzfristiger Teil) | -13.772          | -14.144           | -18.047          | -18.843           |
| Wandel- und Optionsanleihe                                      | -11.642          | -10.233           | 0                | 0                 |
| <b>Gesamt</b>   | <b>21.823</b>    | <b>22.860</b>     | <b>29.441</b>    | <b>28.645</b>     |

#### III.2 Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen zu begrenzen. Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des USD und des YEN, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem EURO-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen.

Derivative Finanzinstrumente werden nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt.

## ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003

Zum 31. Dezember 2003 und 2002 bestanden folgende Devisentermingeschäfte:

|                                 | 2003<br>Nominalvolumen | 2003<br>Marktwert in TEUR | 2002<br>Nominalvolumen | 2002<br>Marktwert in TEUR |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Verkauf von US-Dollar (in TUSD) | 5.621                  | 599                       | 3.093                  | 517                       |
| ...davon bis zu einem Jahr      | 5.261                  | 556                       | 2.693                  | 450                       |
| ...davon bis Jahr 2005          | 360                    | 43                        | 400                    | 67                        |
| Verkauf von Yen (in Mio JPY)    | 28,5                   | 5                         | 0,0                    | 0                         |
| ...davon bis zu einem Jahr      | 28,5                   | 5                         | 0,0                    | 0                         |
| Kauf von US-Dollar (in TUSD)    | 400                    | -25                       | 155                    | -11                       |
| ...davon bis zu einem Jahr      | 400                    | -25                       | 155                    | -11                       |

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen ermittelt. Zum 31. Dezember 2003 wurden die Devisentermingeschäfte mit ihren Marktwerten bilanziert und unter Rückstellungen bzw. sonstige kurzfristige Forderungen ausgewiesen. Die dargestellten Kontraktwerte stellen die Summe der zum 31. Dezember 2003 bestehenden Verpflichtungen dar. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

### III.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

|                                | 2003          | 2002          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Forderungen gegen Dritte       | 25.461        | 35.628        |
| Wertberichtigungen             | -1.855        | -1.523        |
| <b>Forderungsbestand netto</b> | <b>23.606</b> | <b>34.105</b> |

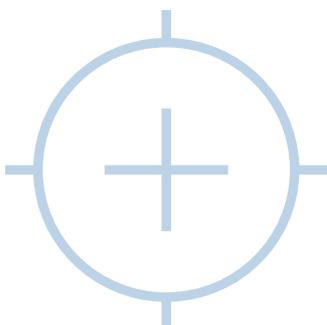
### III.4 Sonstige kurzfristige Forderungen

Als „available for sale“ im Sinn von SFAS NO. 115 weist die Gesellschaft unter dieser Position Aktienbesitz an der JMAR Technologies, Inc. aus, die aus der Veräußerung von Patenten und der Technologie betreffend Röntgenlithographie im Geschäftsjahr 2001 stammen.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Börsenkurs abgeleitet wurde. Der durch die Marktwertänderung entstandene unrealisierte Gewinn in Höhe von TEUR 47 wurde ergebnisneutral innerhalb des Eigenkapitals im Other Comprehensive Income (OCI) ausgewiesen. Der Wert der Aktien in den sonstigen kurzfristigen Forderungen beträgt zum Jahresende TEUR 110 (2002: TEUR 63).

In den sonstigen kurzfristigen Forderungen sind folgende Positionen enthalten:

|  | 2003         | 2002         |
|--|--------------|--------------|
| Umsatzsteuer                             | 548          | 429          |
| Devisentermingeschäfte                   | 604          | 505          |
| Geleistete Anzahlungen                   | 208          | 476          |
| Steuervorauszahlungen                    | 4.180        | 5.560        |
| Sonstiges                                | 1.063        | 2.279        |
| <b>Sonstige kurzfristige Forderungen</b> | <b>6.603</b> | <b>9.249</b> |



### III.5 Vorräte

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

|                             | 2003          | 2002          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Materialien und Hilfsstoffe | 18.767        | 21.445        |
| Unfertige Erzeugnisse       | 12.668        | 12.154        |
| Fertigerzeugnisse           | 6.788         | 8.965         |
| Demonstrationsgeräte        | 10.745        | 11.981        |
| Handelswaren                | 162           | 410           |
| Wertberichtigungen          | -7.230        | -6.893        |
| <b>Vorräte netto</b>        | <b>41.900</b> | <b>48.062</b> |

### III.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen und die Kosten der Wandel- und Optionsanleihe.

### III.7 Sachanlagen

Für die Darstellung der Sachanlagen verweisen wir auf den beigefügten Anlagenspiegel.

|                              | 2003  | 2002  |
|------------------------------|-------|-------|
| Abschreibung auf Sachanlagen | 4.106 | 4.721 |

### Leasing

Das Unternehmen hat bestimmte Sachanlagen über langfristige Mietverträge angemietet. Diese Verträge stellen aufgrund ihrer Charakteristika Finanzierungsleasing dar und werden entsprechend buchhalterisch behandelt. Zur detaillierten Darstellung verweisen wir auf den Anlagenspiegel und auf VI.2. Daneben mietet das Unternehmen Gebäude, Büroeinrichtungen und Fahrzeuge, die Operating Lease darstellen.

### III.8 Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände

#### Goodwill

Entsprechend den Regelungen des SFAS NO. 142 wird Goodwill in Höhe von 28 Mio. EUR seit dem 1. Januar 2002 nicht länger planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich oder wenn Indikatoren auf eine Wertminderung hinweisen, auf seine Werthaltigkeit hin überprüft.

Die erstmalige Anwendung von SFAS NO. 142 verlangte, dass alle im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen vor dem 1. Juli 2001 erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände, welche die in SFAS NO. 141 beschriebenen Voraussetzungen für einen separaten Ausweis nicht erfüllen, als Goodwill auszuweisen sind. Ebenso sind immaterielle Vermögensgegenstände, welche die Kriterien für einen separaten Ausweis erfüllen, bisher aber als Goodwill aus der Erstkonsolidierung erfasst waren, als immaterielle Vermögensgegenstände auszuweisen. Das Unternehmen stellte in diesem Zusammenhang keinen Bedarf an Umgliederungen fest.

Die erforderliche jährliche Überprüfung des Goodwill auf Wertminderung hat die Gesellschaft jeweils im dritten Quartal eines Geschäftsjahres vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Geschäftsjahren 2003 und 2002 außerplanmäßige Abschreibungen nicht notwendig waren.

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003**

**Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände**

Die sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2003 bzw. 2002 bestehen aus Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von TEUR 7.305 bzw. TEUR 9.679.

Die Abschreibungen auf die sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände betragen TEUR 1.965 für das Geschäftsjahr 2003 sowie TEUR 2.200 für das Geschäftsjahr 2002. Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden weder im Geschäftsjahr 2003 noch in 2002 vorgenommen.

Im Zusammenhang mit der Erstanwendung von SFAS NO. 142 wurden im Mai 2002 die Nutzungsdauern aller erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände überprüft. Dabei wurden keine immateriellen Vermögensgegenstände festgestellt, die eine unbestimmbare Nutzungsdauer haben. Nach Ablauf der planmäßigen Nutzungsdauer werden Restwerte für diese immateriellen Vermögensgegenstände nicht erwartet.

Auf Basis des Bestands an immateriellen Vermögensgegenständen, die ausnahmslos eine bestimmbare Nutzungsdauer haben, werden die folgenden Abschreibungsbeträge für die folgenden fünf Berichtsjahre erwartet:

|            | Wert TEUR |
|------------|-----------|
| 2004       | 1.898     |
| 2005       | 1.848     |
| 2006       | 1.729     |
| 2007       | 1.296     |
| 2008       | 1.138     |
| ... Später | 9         |

Diese Schätzungen können von den tatsächlichen Beträgen in der Zukunft abweichen.

In folgender Tabelle werden die Auswirkungen aus der Erstanwendung von SFAS NO. 142 zum 1. Januar 2002 auf den Konzernabschluss sowie auf das Ergebnis je Aktie gezeigt, als wären diese Regelungen bereits am 1. Januar 2001 in Kraft getreten:

|                                    | Wert TEUR<br>2001 pro forma | Wert TEUR<br>2001 wie berichtet |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Jahresüberschuss                   | 25.423                      | 21.079                          |
| enthaltene Goodwill-Abschreibung   | 0                           | 4.344                           |
| Ergebnis je Aktie unverwässert EUR | 1,85                        | 1,53                            |
| Ergebnis je Aktie verwässert EUR   | 1,84                        | 1,53                            |

**III.9 Finanzanlagen**

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                    | 2003       | 2002       |
|------------------------------------|------------|------------|
| Equity-konsolidierte Beteiligungen | 110        | 114        |
| Übrige Beteiligungen               | 34         | 34         |
| <b>Finanzanlagen</b>               | <b>144</b> | <b>148</b> |

Mittels der Equity-Methode wurde die Beteiligung an der Hugle Lithography Inc., USA (Anteil 53,1%) bewertet. Die Beteiligung wurde zum 31. Dezember 2003 mit ihrem anteiligen Eigenkapital in Höhe von TEUR 22 (Vorjahr TEUR 22) bilanziert. Die Geschäftstätigkeit war in 2003 immateriell.



Die 49%-Beteiligung an der SUSS MicroTec Company Ltd., Bangkok wurde ebenfalls mittels der Equity-Methode bewertet. Es ergab sich bedingt durch Währungskurseffekte eine Verminderung des Beteiligungsansatzes auf TEUR 88 (Vorjahr TEUR 92). Angaben zum Unternehmen in tausend BAHT (Umrechnungskurs: 1 EUR = 49,935 BAHT):

|                              | 2003          | 2002          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Umsätze                      | 29.414        | 30.321        |
| Aufwendungen                 | 28.807        | 29.146        |
| Steuern                      | 137           | 240           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b> | <b>470</b>    | <b>935</b>    |
| Umlaufvermögen               | 6.483         | 5.217         |
| Anlagevermögen               | 5.604         | 6.727         |
| <b>Aktiva</b>                | <b>12.087</b> | <b>11.944</b> |
| Verbindlichkeiten            | 1.390         | 1.960         |
| Eigenkapital                 | 10.697        | 9.984         |
| <b>Passiva</b>               | <b>12.087</b> | <b>11.944</b> |

Daneben bestehen weitere Beteiligungen mit Anteilen am Aktienkapital von weniger als 20%. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.

### III.10 Sonstige langfristige Vermögensgegenstände

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen.

|                                     | 2003         | 2002         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Rückdeckungsversicherung            | 1.422        | 1.395        |
| Kautionen                           | 59           | 256          |
| Ausleihungen                        | 208          | 96           |
| Sonstiges                           | 212          | 193          |
| <b>Sonstige langfristige Aktiva</b> | <b>1.901</b> | <b>1.940</b> |

## IV. Erläuterungen zu den Bilanzpassiva

### IV.1 Kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten

#### Finanzierung

Die Gesellschaft hat mit einem Bankenconsortium unter der Führung der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank eine Konsortialkreditvereinbarung abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung verfügt über das Unternehmen über eine bis 30. April 2005 vereinbarte Kreditlinie in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Kreditlinie ist an die Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen gebunden. Dem Konsortium gehören neben der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank das Bankhaus Reuschel & Co. sowie die ING BHF Bank an. Die Kreditlinie ist zum 31. Dezember 2003 in Höhe des unter den langfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehens des Bankhauses Reuschel & Co. in Höhe von TEUR 590 beansprucht.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft weitere Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

|                               | 2003          | 2002          |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Kreditlinie                   | 16.923        | 19.431        |
| Inanspruchnahme               | 3.730         | 3.531         |
| <b>Verfügbare Kreditlinie</b> | <b>13.193</b> | <b>15.900</b> |

**Kurzfristige Bankverbindlichkeiten**

Die kurzfristigen Kredite zum 31. Dezember 2003 und 2002 betragen TEUR 3.154 und TEUR 3.531. Zum Bilanzstichtag bestehen neben den in Anspruch genommenen Kreditlinien noch TEUR 13 Kontokorrentverbindlichkeiten. Der durchschnittliche Zinssatz der Kreditlinien betrug 6,16% (2002: 6,05%).

**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**

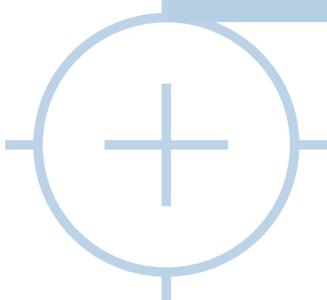
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

|   | 2003          | 2002          |
|---|---------------|---------------|
| Anleihen  | 11.642        | 0             |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten                | 13.772        | 18.047        |
| <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten gesamt</b>                    | <b>25.414</b> | <b>18.047</b> |
| Abzüglich kurzfristige Beträge  | 2.991         | 3.546         |
| <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristige Beträge</b> | <b>22.423</b> | <b>14.501</b> |

Zum 31.12.2003 waren Bankdarlehen in Höhe von nominal TEUR 1.432 durch Grundschulden besichert. Für Bankdarlehen über TEUR 7.648 hat die SÜSS MicroTec AG ihre Anteile an der SUSS MicroTec Lithography GmbH., an der SUSS MicroTec S.A.S. und an der SUSS MicroTec Inc. verpfändet.

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

|                               | 2003          | 2002          | Zinssatz | Fälligkeit |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|
| Bankdarlehen I (EUR)          | 3.813         | 4.449         | 3,25%    | 2009       |
| Bankdarlehen II (EUR)         | 3.835         | 4.474         | 3,75%    | 2009       |
| Bankdarlehen III (EUR)        | 590           | 1.865         | 5,45%    | 2003       |
| Bankdarlehen IV (EUR)         | 735           | 882           | 3,75%    | 2009       |
| Bankdarlehen V (USD) in EUR   | 1.025         | 1.518         | 8,42%    | 2007       |
| Bankdarlehen VI (USD) in EUR  | 302           | 467           | 8,42%    | 2007       |
| Bankdarlehen VII (USD) in EUR | 981           | 1.514         | 9,39%    | 2007       |
| Sonstige Darlehen < 1 Mio EUR | 2.491         | 2.878         |          |            |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>13.772</b> | <b>18.047</b> |          |            |
| ...davon kurzfristig fällig   | 2.991         | 3.546         |          |            |
| ...davon langfristig fällig   | 10.781        | 14.501        |          |            |
| ... fällig in 2004            | 2.991         |               |          |            |
| 2005                          | 2.450         |               |          |            |
| 2006                          | 2.499         |               |          |            |
| 2007                          | 1.955         |               |          |            |
| 2008                          | 1.663         |               |          |            |
| ...später                     | 2.214         |               |          |            |
|                               | <b>13.772</b> |               |          |            |



Am 4. November 2003 hat die SÜSS MicroTec AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Wandel- und Optionsanleihe im Gesamtbetrag von EUR 11.642.000 ausgegeben.

Hiervon entfallen EUR 11.268.730 auf eine Wandelanleihe, die mit 6% p.a. verzinst wird und in zwei gleichen Tranchen am 31. Oktober 2005 und am 30. April 2006 rückzahlbar ist, sofern sie nicht während dieser Laufzeit in bis zu 1.119.810 Aktien der SÜSS MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis hierfür beträgt EUR 10,063075 pro Aktie. Die SÜSS MicroTec AG kann den Umtausch von bis zu 30% des Nennbetrages verlangen, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 140% des Wandlungspreises liegt. Ein Umtausch von bis zu 50% des Nennbetrages kann von der Gesellschaft verlangt werden, wenn der Aktienkurs während 23 von 25 aufeinander folgenden Handelstagen bei mehr als 200% des Wandlungspreises liegt.

Des weiteren entfallen EUR 373.270 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6% p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 rückzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt EUR 10,566229 und liegt um 5% über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von EUR 9,566229 je Aktie. Die SÜSS MicroTec AG kann ab dem 4. November 2004 die Ausübung von 33 1/3% der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135% über dem Bezugspreis liegt. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die komplette Ausübung der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200% über dem Bezugspreis liegt.

Wandel- und Optionsanleihe sind unbesichert.

#### IV.2 Pensionsverbindlichkeiten

Das Unternehmen hat verschiedene Versicherungspläne, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität versichern. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | 2003         | 2002         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Inländische Verpflichtungen  | 3.461        | 3.520        |
| ... davon kurzfristig        | 212          | 223          |
| Ausländische Verpflichtungen | 334          | 283          |
| ... davon kurzfristig        | 2            | 0            |
| <b>Gesamt</b>                | <b>3.795</b> | <b>3.803</b> |
| <b>... davon kurzfristig</b> | <b>214</b>   | <b>223</b>   |

#### Deutsche Pläne

Die Pensionszusagen umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

|  | 2003  | 2002 |
|--|-------|------|
| Abzinsungsfaktor                                 | 5,25% | 5,5% |
| Gehaltssteigerung                                | 0,0%  | 0,0% |
| Rentensteigerung                                 | 1,0%  | 1,0% |
| Lebenserwartung gem. Richttafel Dr. Heubeck 1998 |       |      |

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

Die nachfolgende Aufstellung leitet den "funded status" der Pläne über auf die in der Bilanz gebuchte Verbindlichkeit:

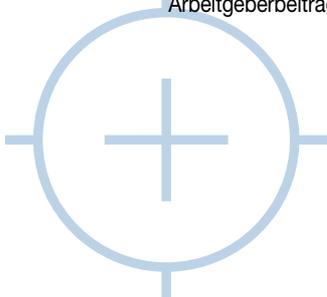
|   | 2003         | 2002         |
|---|--------------|--------------|
| Überleitung der erwarteten Pensionsverbindlichkeit  |              |              |
| <b>Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 01.01.</b>   | <b>3.520</b> | <b>3.474</b> |
| Servicekosten   | 9            | 3            |
| Zinskosten  | 186          | 200          |
| Versicherungsmathematischer Gewinn (Verlust)  | 24           | 110          |
| Pensionszahlungen   | -278         | -267         |
| <b>Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 31.12.</b>   | <b>3.461</b> | <b>3.520</b> |
| <b>Versicherungsmathematischer Barwert der kumulierten Pensionsverbindlichkeit (ABO) 31.12.</b> | <b>3.461</b> | <b>3.520</b> |
| Darstellung des Bilanzwertes  |              |              |
| <b>Projizierte Pensionsverbindlichkeit (PBO) 31.12.</b>   | <b>3.461</b> | <b>3.520</b> |
| Plankapitalanlagen  | 0            | 0            |
| <b>Errechnete Pensionsverbindlichkeit</b>   | <b>3.461</b> | <b>3.520</b> |
| Nicht realisierte Überleitungsbeträge   | -71          | -107         |
| Nicht realisierte Servicekosten früherer Perioden   | -18          | -19          |
| Nicht realisierte versicherungsmathematische Gewinne und Verluste                               | -96          | -73          |
|   | <b>3.276</b> | <b>3.321</b> |
| Zusätzliche Mindestverbindlichkeit  | 185          | 199          |
| ... davon immaterielle Vermögensgegenstände   | 89           | 126          |
| ... davon Other Comprehensive Income  | 96           | 73           |
| <b>Pensionsrückstellung</b>   | <b>3.461</b> | <b>3.520</b> |
| Aufstellung der Pensionsaufwendungen  |              |              |
| Servicekosten   | 9            | 3            |
| Zinskosten  | 186          | 200          |
| Amortisation der Überleitungsbeträge  | 36           | 36           |
| Amortisation der Servicekosten früherer Perioden  | 1            | 1            |
| Amortisation der versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste                                   | 1            | 0            |
| <b>Pensionsaufwendungen</b>   | <b>233</b>   | <b>240</b>   |

**U.S.-Pläne**

Das Unternehmen hat einen "Defined Contribution Plan" welcher im Wesentlichen sämtliche Arbeitnehmer, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, umfasst. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Der Vorstand der U.S. Gesellschaft bestimmt jährlich die Beiträge neu, die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließen. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem "Trust Fund" gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von 6 Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.



Im Geschäftsjahr 2003 betragen die Aufwendungen des Unternehmens für den Gewinnbeteiligungsplan TUSD 0 (2002 TUSD 0) und für den 401 (k) Plan TUSD 0 (2002 TUSD 196).

### IV.3 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten teilt sich wie folgt auf:

|  | 2003          | 2002          |
|--|---------------|---------------|
| Steuerrückstellungen                           | 1.005         | 1.625         |
| Erhaltene Anzahlungen                          | 2.688         | 3.409         |
| Abgegrenzte Personalkosten                     | 3.865         | 5.606         |
| Prämien und Provisionen                        | 1.950         | 4.169         |
| Fremdleistungen                                | 1.145         | 2.400         |
| Umsatzsteuer                                   | 329           | 2.019         |
| Garantierückstellungen                         | 1.275         | 1.735         |
| Passive Rechnungsabgrenzung                    | 825           | 593           |
| Sonstiges                                      | 3.847         | 1.876         |
| <b>Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b> | <b>16.929</b> | <b>23.432</b> |

In den abgegrenzten Personalkosten war im Vorjahr eine Rückstellung für Restrukturierung in Höhe von TEUR 2.102 enthalten.

Die Garantierückstellungen werden jährlich auf Basis der entstandenen Garantiekosten im Verhältnis zum erzielten Umsatz neu kalkuliert.

|                                | Betrag TEUR  |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Stand 1. Januar 2003</b>    | <b>1.735</b> |
| Zuführung                      | 682          |
| Verbrauch                      | 1.142        |
| <b>Stand 31. Dezember 2003</b> | <b>1.275</b> |

### IV.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

In den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

|  | 2003       | 2002       |
|--|------------|------------|
| Lieferantenverbindlichkeiten                   | 221        | 351        |
| Darlehen von Mitarbeitern                      | 96         | 103        |
| Sonstiges                                      | 200        | 281        |
| <b>Sonstige langfristige Verbindlichkeiten</b> | <b>517</b> | <b>735</b> |

### IV.5 Eigenkapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG beträgt EUR 14.956.884 und ist eingeteilt in 14.956.884 Stück Mio. Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,00.

Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß des handelsrechtlichen Jahresabschlusses der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

## ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003

Am 16. Januar 2002 wurde eine Kapitalerhöhung in Höhe von nominal EUR 1.130.000 gegen Bareinlage aus dem genehmigten Kapital durchgeführt. Dadurch flossen der SÜSS MicroTec Barmittel in Höhe von EUR 34.465.000 brutto zu.

Auf der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde beschlossen, das genehmigte Kapital auf 7.466.242 EUR zu erhöhen. Das bedingte Kapital von insgesamt 5.822.800 EUR kann für bis zu 5.000.000 EUR für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden; 500.000 EUR können für den neuen Optionsplan genutzt werden. Der Restbetrag von 322.800 EUR ist dem alten, geschlossenen Optionsplan zuzuordnen. Infolge des Ausscheidens mehrerer Mitarbeiter sind im Berichtsjahr weitere Optionen verfallen, so dass sich zum Bilanzstichtag das bedingte Kapital auf 5.807.296 EUR beläuft.

|                     | 2003   | 2002   |
|---------------------|--------|--------|
| Grundkapital        | 14.957 | 14.957 |
| genehmigtes Kapital | 7.466  | 7.466  |
| bedingtes Kapital   | 5.807  | 5.823  |

### Other Comprehensive Income (OCI)

Die Entwicklung des OCI stellt sich wie folgt dar:

|  | 2003          | 2002          |
|--|---------------|---------------|
| Fremdwährungsanpassungen               | -3.358        | -166          |
| Mindestverbindlichkeit Pensionen       | -46           | -4            |
| <b>OCI zu Beginn der Periode</b>       | <b>-3.404</b> | <b>-170</b>   |
| <b>Veränderungen vor Steuern</b>       |               |               |
| Fremdwährungsanpassungen               | -2.255        | -3.192        |
| Mindestverbindlichkeit Pensionen       | -23           | -67           |
| Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren | 47            | 0             |
| <b>Steuereffekte</b>                   |               |               |
| Fremdwährungsanpassungen               | 0             | 0             |
| Mindestverbindlichkeit Pensionen       | 9             | 25            |
| Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren | 0             | 0             |
| <b>OCI am Ende der Periode</b>         | <b>-5.626</b> | <b>-3.404</b> |

### Aktionsoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu EUR 800.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. März 2004 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können zu 50% nach Ablauf einer Wartefrist von 3 Jahren, zu 50% nach Ablauf einer Wartefrist von 5 Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft den Bezugspreis bei Ausübung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50%, nach vier Jahren um mindestens 75% bzw. nach fünf Jahren um mindestens 100% übersteigt. Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde das bedingte Kapital für diesen Optionsplan auf EUR 350.000 gesenkt. Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde für die Zukunft aufgehoben.

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde weiterhin der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und



weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von 2 Jahren zu 100% ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts den Basispreis um mindestens 0,625% pro vollem Kalendermonat zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts (entspricht 7,5% für 12 Monate) übersteigt und zusätzlich sich im selben Zeitraum der Börsenkurs prozentual gleich oder besser entwickelt hat, als der Nemax Technology Index oder ein eventuell an seine Stelle tretender vergleichbarer Nachfolindex

oder

- der Börsenkurs der Aktien im Zeitpunkt der Ausübung den Basispreis um mindestens durchschnittlich 0,833% pro vollem Kalendermonat (10% pro Jahr) zwischen dem Ende der Erwerbsfrist des ausgeübten Bezugsrechts und dem Zeitpunkt der Ausübung übersteigt.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. drei Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 650 (2002: TEUR 1.430) für diese Pläne vorgenommen.

Aus dem in der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 genehmigten Kapital wurden im Berichtsjahr insgesamt 216.500 Bezugsrechte mit einem Bezugskurs von EUR 1,11 gewährt. Davon sind im Geschäftsjahr infolge des Ausscheidens von Mitarbeitern 6.500 Bezugsrechte verfallen. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals bestanden folglich zum Bilanzstichtag noch 493.500 Bezugsrechte.

In 2002 wurden keine neuen Optionen gewährt. Am 31. Dezember 2003 bestanden 523.796 Bezugsrechte (2002: 322.800 Bezugsrechte).

Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2003 gewährten Optionen in Höhe von EUR 1,25 wurde unter Verwendung des Black-Scholes Optionsbewertungsmodells geschätzt. Dabei wurden folgende Annahmen getroffen:

|                                   | 2003    | 2002    | 2001    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Erwartete durchschnittl. Laufzeit | 6 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Risikofreier Zinssatz             | 3,23%   | ---     | 4,61%   |
| Erwartete Volatilität SÜSS-Aktie  | 38%     | ---     | 57%     |
| Erwartete Dividende               | 0%      | ---     | 0%      |

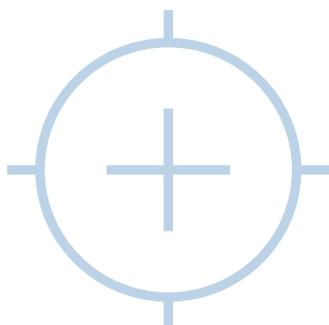
**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003**

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienerwerb haben sich wie folgt entwickelt:

|                      | Anzahl         | gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis EUR |
|----------------------|----------------|--|
| <b>31.12.1998</b>    | <b>0</b>       |  |
| gewährt 1999         | 136.000        | 13,00  |
| ausgeübt 1999        | 0              |  |
| verfallen 1999       | 9.600          | 13,00  |
| <b>31.12.1999</b>    | <b>126.400</b> | <b>13,00</b>                                   |
| gewährt 2000         | 157.662        | 28,64  |
| ausgeübt 2000        | 0              |  |
| verfallen 2000       | 0              |  |
| <b>31.12.2000</b>    | <b>284.062</b> | <b>21,68</b>                                   |
| gewährt 2001         | 68.000         | 35,44  |
| ausgeübt 2001        | 0              |  |
| verfallen 2001       | 3.432          | 27,31  |
| <b>31.12.2001</b>    | <b>348.630</b> | <b>24,31</b>                                   |
| gewährt 2002         | 0              |  |
| ausgeübt 2002        | 24.400         | 13,00  |
| verfallen 2002       | 1.430          | 28,64  |
| <b>31.12.2002</b>    | <b>322.800</b> | <b>25,14</b>                                   |
| gewährt 2003         | 216.500        | 1,11   |
| ausgeübt 2003        | 0              |  |
| verfallen 2003       | 15.504         | 9,31   |
| <b>31.12.2003</b>    | <b>523.796</b> | <b>15,68</b>                                   |
| <b>ausgeübt</b>      | <b>24.400</b>  |  |
| <b>noch begebbar</b> | <b>283.500</b> |  |

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

| Bereich des Bezugspreises | Anzahl Bezugsrechte | gewichteter durchschnittl. Bezugspreis EUR | gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit Monate |
|---------------------------|---------------------|--|---|
| unter EUR 10,00           | 210.000             | 1,11                                       | 65  |
| EUR 10,00 - EUR 19,99     | 94.140              | 13,00                                      | 5   |
| EUR 20,00 - EUR 24,99     | --                  | --   | --  |
| EUR 25,00 - EUR 29,99     | 127.656             | 27,31                                      | 23  |
| EUR 30,00 - EUR 35,99     | 68.000              | 35,44                                      | 29  |
| ab EUR 36,00              | 24.000              | 36,00                                      | 17  |
|                           | <b>523.796</b>      | <b>15,68</b>                               | <b>37</b>                                     |



## Ergebnis pro Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses pro Aktie.

|  | 2003         | 2002         |
|--|--------------|--------------|
| <b>Zähler:</b>                                 |              |              |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag                   | -14.553      | -8.938       |
| <b>Nenner:</b>                                 |              |              |
| Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien |              |              |
| unverwässert                                   | 14.956.884   | 14.893.023   |
| Verwässerung                                   | 0            | 0            |
| verwässert                                     | 14.956.884   | 14.893.023   |
| <b>Ergebnis pro Aktie in EUR:</b>              |              |              |
| <b>unverwässert</b>                            | <b>-0,97</b> | <b>-0,60</b> |
| <b>verwässert</b>                              | <b>-0,97</b> | <b>-0,60</b> |

Im Geschäftsjahr 2003 wurden 1.119.810 Aktien aus der Begebung der Wandelanleihe und 373.270 aus der Begebung der Optionsanleihe bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

Die im Geschäftsjahr ausgegebenen Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft wurden bei der Berechnung der verwässerten Ergebnisses nicht berücksichtigt, da ihre Einbeziehung zu einem negativen Verwässerungseffekt führen würde.

## V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### V.1 Sonstige Aufwendungen und Erträge

|   | 2003         | 2002         |
|---|--------------|--------------|
| Stornogebühren                                | 593          | 581          |
| Rückstellungsaufösungen                       | 997          | 1.461        |
| Verkauf Patente                               | 0            | 0            |
| Versicherungsleistungen                       | 51           | 14           |
| Mieterträge                                   | 47           | 81           |
| Sonstige Zuschüsse                            | 320          | 400          |
| Sonstiges                                     | 875          | 617          |
| <b>Summe Erträge</b>                          | <b>2.883</b> | <b>3.154</b> |
| Vertragsstrafen, Schadenersatz                | 479          | 32           |
| Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen | 33           | -236         |
| Einzelwertberichtigung                        | 621          | 1.941        |
| Abgang Anlagevermögen                         | 551          | 289          |
| Sonstige Steuern                              | 165          | 64           |
| Rückzahlung Zuschüsse                         | 47           | 0            |
| Sonstiges                                     | 128          | 1.465        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                     | <b>2.024</b> | <b>3.555</b> |
| <b>Saldo</b>                                  | <b>859</b>   | <b>-401</b>  |

Die sonstigen Zuschüsse betreffen insbesondere erhaltene Zuschüsse der SUSS Test Systems GmbH, Dresden, für Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

**V.2 Steuern**

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellt sich wie folgt dar:

|  | 2003          | 2002          |
|--|---------------|---------------|
| Deutsche Körperschaftsteuer                                  | 1.764         | -2.089        |
| Deutsche Gewerbeertragsteuer                                 | 1.523         | 275           |
| Ausländische Ertragsteuer                                    | -1.788        | -6.053        |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>1.499</b>  | <b>-7.867</b> |
| Inanspruchnahme/Bildung latenter Steuern auf Verlustvorträge | -4.900        | -365          |
| Sonstiges  | 0             | 0             |
| <b>Gesamtertrag/ -aufwand</b>                                | <b>-3.401</b> | <b>-8.232</b> |
| <b>... davon laufend</b>                                     | <b>-1.851</b> | <b>-4.724</b> |
| Inland   | 930           | 660           |
| Ausland  | -2.781        | -5.384        |
| <b>... davon latent</b>                                      | <b>-1.550</b> | <b>-3.508</b> |
| Inland   | -2.542        | -2.475        |
| Ausland  | 992           | -1.033        |

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

|  | 2003           | 2002           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Angenommener Steuersatz</b>   |                |                |
| Körperschaftsteuer   | 25,00%         | 25,00%         |
| Solidaritätszuschlag   | 5,50%          | 5,50%          |
| Gewerbesteuersatz  | 14,90%         | 14,90%         |
| <b>Kombinierter Steuersatz</b>   | <b>37,34%</b>  | <b>37,34%</b>  |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>  | <b>-17.954</b> | <b>-17.170</b> |
| <b>erwartete Ertragssteuern</b>  | <b>-6.704</b>  | <b>-6.411</b>  |
| Abweichende Steuersätze im Ausland   | 753            | -1.166         |
| Kein Ansatz latenter Steuern bei dem Verlust der MFI Technologies  | 0              | 0              |
| Steuerlich nicht zu berücksichtigender Aufwand im Konzern für erworbene laufende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten | 0              | 0              |
| Nicht abzugsfähige Goodwill-Abschreibungen im Konzern  | 0              | 0              |
| Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen  | 92             | 88             |
| Abwertung von konzerninternen Darlehenspositionen  | 156            | -574           |
| Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben  | 281            | 12             |
| Nicht angesetzte, aber steuerlich genutzte Verlustvor- und rückträge   | 0              | -674           |
| Wertberichtigung auf Verlustvorträge   | 1.793          | 453            |
| Sonstiges  | 228            | 40             |
| <b>Effektive Ertragssteuern</b>  | <b>-3.401</b>  | <b>-8.232</b>  |

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern aus Verlustvorträgen in Höhe von TEUR 1.793 vorgenommen. Der größte Teil der Wertberichtigung in Höhe von TEUR 1.354 betrifft die Konzerngesellschaft in Japan und ergibt sich aus der zeitlich eingeschränkten Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge.

Durch den Transfer immaterieller Vermögensgegenstände von Kanada nach Deutschland wurden im Vorjahr wertberichtigte aktive latente Steuern auf Verlustvorträge der MFI in Höhe von TEUR 674 genutzt.



Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

|                                      | Aktiva<br>2003 | Aktiva<br>2002 | Passiva<br>2003 | Passiva<br>2002 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Bonusrückstellungen                  | 101            | 162            |                 |                 |
| Pensionsrückstellungen               | 1.277          | 1.269          |                 |                 |
| Urlaubsrückstellungen                | 143            | 258            |                 |                 |
| Sonstige Rückstellungen              | 620            | 645            |                 |                 |
| Devisentermingeschäfte               |                |                | 232             | 195             |
| Wandelanleihe                        |                |                | 222             | 0               |
| Goodwill                             | 5              | 5              |                 |                 |
| SAB 101 Anpassungen                  | 156            | 0              |                 |                 |
| Zwischengewinneliminierung           | 2.218          | 3.060          |                 |                 |
| Unterschiedl. Abschreibungen         |                |                | 616             | 1.029           |
| Sonstiges                            | 639            | 501            |                 |                 |
| Verlustvorträge                      | 9.108          | 5.656          |                 |                 |
| ./. Wertberichtigung Verlustvorträge | -3.626         | -2.032         |                 |                 |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>10.641</b>  | <b>9.524</b>   | <b>1.070</b>    | <b>1.224</b>    |
| <b>Gesamt netto</b>                  | <b>9.571</b>   | <b>8.300</b>   |                 |                 |
| ... davon kurzfristig                | 2.091          | 3.405          |                 |                 |
| ... davon langfristig                | 7.480          | 4.895          |                 |                 |

### V.3 Nahestehende Personen

#### SÜSS Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hungar Mountains (vormals: Suss Real Estate)

Verschiedene Konzerngesellschaften (SUSS MicroTec Lithography GmbH, SUSS Dresden Test Systems GmbH, SUSS MicroTec Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der SÜSS Grundstücksverwaltungs GbR oder der Hungar Mountains. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Verträgen ergebenden zukünftigen Mindestleasingraten sind in VI.2 dargestellt.

|               | 2003  | 2002  |
|---------------|-------|-------|
| Mieteinnahmen | 1.828 | 1.786 |

#### Familie Süs

Die Familie Süs als ehemalige Gesellschafter und heutige Aktionäre des Unternehmens hat Bezüge in verschiedenster Form, u.a. als Pensionsansprüche und Mietzahlungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süs dar. Die Pensionsansprüche sind in IV.2 Pensionsverpflichtungen, deutsche Pläne, dargestellt.

|                        | 2003       | 2002       |
|------------------------|------------|------------|
| Gehälter und Pensionen | 254        | 274        |
| Beratungsleistungen    | 0          | 43         |
| <b>Summe</b>           | <b>254</b> | <b>317</b> |

## ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003

### CMS

Das Mitglied des Aufsichtsrates Dr. Schücking ist Gesellschafter der CMS, einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Gruppe erhält Rechtsberatung von dieser Kanzlei.

|                     | 2003 | 2002 |
|---------------------|------|------|
| Beratungsleistungen | 86   | 138  |

### Leistungen an nahestehende Personen

|                        | 2003         | 2002         |
|------------------------|--------------|--------------|
| Gehälter und Pensionen | 254          | 274          |
| Beratungsleistungen    | 86           | 181          |
| Mieteinnahmen          | 1.828        | 1.786        |
| <b>Summe</b>           | <b>2.168</b> | <b>2.241</b> |

## VI. Sonstige Angaben

### VI.1 Besondere Aufwandspositionen

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

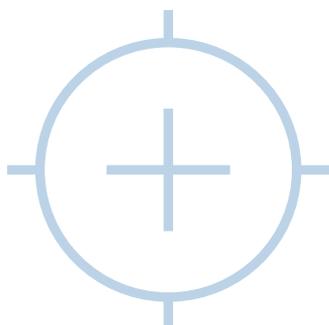
|                                 | 2003          | 2002          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Löhne und Gehälter              | 33.532        | 44.887        |
| Soziale Abgaben                 | 6.287         | 8.413         |
| Aufwendungen zur Altersvorsorge | 472           | 961           |
| <b>Personalaufwand gesamt</b>   | <b>40.291</b> | <b>54.261</b> |
| Ausgaben für Werbung            | 2.880         | 2.742         |
| Forschung und Entwicklung       | 10.496        | 12.537        |

Die Materialaufwendungen betragen in 2003 TEUR 35.921 (2002: TEUR 47.961).

### VI.2 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

#### Leasing

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen Fertigung, Geschäftsführung und Verwaltung sowie verschiedene Ausrüstungsgegenstände unter Operating-Leasing-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Betriebs- und Geschäftsausstattung Capital-Leasing-Verträge.



Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

|                         | Financial<br>Lease | Operating<br>Lease | davon Operating Lease mit<br>nahestehenden Personen |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Aufwendungen 2002       | --                 | 3.183              | 1.786   |
| Aufwendungen 2003       | --                 | 2.633              | 1.828   |
| ... fällig in 2004      | 185                | 2.573              | 1.734   |
| 2005                    | 156                | 2.366              | 1.667   |
| 2006                    | 148                | 2.208              | 1.654   |
| 2007                    | 102                | 1.498              | 1.340   |
| 2008                    | 89                 | 37                 | 1.340   |
| ... später              | 74                 | 6.451              | 6.451   |
| <b>Gesamt zukünftig</b> | <b>754</b>         | <b>15.133</b>      | <b>14.186</b>                                       |
| Zinsanteil              | 123                |                    |   |
| <b>Verbindlichkeit</b>  | <b>631</b>         |                    |   |
| ... davon kurzfristig   | 158                |                    |   |
| ... davon langfristig   | 473                |                    |   |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

|                   | 2003         | 2002         |
|-------------------|--------------|--------------|
| Bestellobligo     | 5.492        | 2.150        |
| Wechselbligo      | 0            | 0            |
| Rückkaufgarantien | 133          | 1.577        |
| Sonstiges         | 690          | 166          |
| <b>Summe</b>      | <b>6.315</b> | <b>3.893</b> |

Das Bestellobligo verpflichtet uns zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Rückkaufgarantien basieren in der Regel auf unseren eigenen Herstellkosten: Normalerweise entspricht der initiale Rückkaufspreis unseren eigenen Herstellkosten und damit nicht mehr als 60% des Verkaufspreises. Der Rückkaufspreis reduziert sich um 20% pro Jahr und die Garantie läuft nach 3 Jahren aus.

### VI.3 Restrukturierung

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2002 wurde aufgrund der Marktentwicklung eine Restrukturierung mit betriebsbedingten Kündigungen durchgeführt. Insgesamt wurden zum 31. Dezember 2002 Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 2.102 gebildet. Der damit verbundene Personalabbau von 112 Mitarbeitern wurde im ersten Quartal des Berichtsjahres durchgeführt. Der Personalabbau erfolgte in folgenden Bereichen:

|                           | Mitarbeiter |
|---------------------------|-------------|
| Verwaltung                | 12          |
| Marketing und Vertrieb    | 14          |
| Produktion und Technik    | 72          |
| Forschung und Entwicklung | 14          |
| <b>Gesamt</b>             | <b>112</b>  |

Die zum 31. Dezember 2002 gebildete Rückstellung wurde im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 1.911 verbraucht und in Höhe von TEUR 190 aufgelöst.

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2003**

Im Berichtsjahr mussten im ersten Quartal weitere Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. So wurde einerseits der Standort Singen nach Vaihingen verlagert, andererseits wurde am Standort Dresden ein Mitarbeiterabbau durchgeführt. Es fielen Kosten in Form von Abfindungen und Freistellungen der Mitarbeiter in Höhe von TEUR 476 an. Angaben zu dieser weiteren Restrukturierung sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

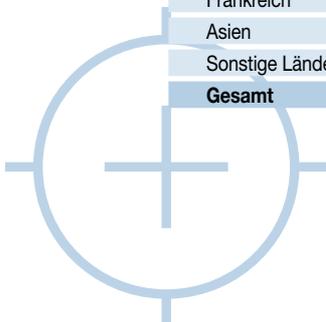
|                           | Mitarbeiter |
|---------------------------|-------------|
| Verwaltung                | 4           |
| Marketing und Vertrieb    | 14          |
| Produktion und Technik    | 23          |
| Forschung und Entwicklung | 8           |
| <b>Gesamt</b>             | <b>49</b>   |

**VI.4 Segmentsberichterstattung**

Die Gruppe ist mit dem Verkauf von technischen Produkten und Service nur in einem Segment tätig. Die Gruppe entwickelt, produziert und verkauft im Bereich Mikrosystemtechnik und Mikroelektronik. Hauptkunden sind der Automobilsektor und die Halbleiterindustrie, wo diese Geräte für ähnliche Zwecke eingesetzt werden.

In 2003 und 2002 wurden mit keinem Kunden 10% oder mehr des Konzernumsatzes erzielt.

|  | 2003          | 2002           |
|--|---------------|----------------|
| <b>Externe Umsatzerlöse - Produkte</b> |               |                |
| Deutschland                            | 39.877        | 55.462         |
| USA                                    | 30.212        | 41.648         |
| Frankreich                             | 5.844         | 11.719         |
| Asien                                  | 8.721         | 10.125         |
| Sonstige Länder                        | 1.865         | 1.556          |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>86.519</b> | <b>120.510</b> |
| <b>Externe Umsatzerlöse - Service</b>  |               |                |
| Deutschland                            | 2.787         | 2.516          |
| USA                                    | 1.843         | 2.155          |
| Frankreich                             | 714           | 741            |
| Asien                                  | 416           | 1.099          |
| Sonstige Länder                        | 336           | 494            |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>6.096</b>  | <b>7.005</b>   |
| <b>Langfristige Aktiva</b>             |               |                |
| Deutschland                            | 21.400        | 21.460         |
| USA                                    | 5.046         | 8.085          |
| Frankreich                             | 2.470         | 2.798          |
| Asien                                  | 1.243         | 2.476          |
| Sonstige Länder                        | 698           | 956            |
| Konsolidierung                         | -2.092        | -2.669         |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>28.765</b> | <b>33.106</b>  |
| <b>Goodwill</b>                        |               |                |
| Deutschland                            | 9.082         | 9.082          |
| USA                                    | 16.169        | 16.169         |
| Frankreich                             | 1.166         | 1.166          |
| Asien                                  | 187           | 187            |
| Sonstige Länder                        | 1.405         | 1.405          |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>28.009</b> | <b>28.009</b>  |



## VI.5 Vorstand und Aufsichtsrat

### Vorstand der Konzernobergesellschaft

Mitglieder des Vorstandes der Konzerngesellschaft im Jahr 2003 waren:

#### **Herr Dr. Franz Richter, Dipl.-Ingenieur, Eichenau (Vorstandsvorsitzender)**

Zuständigkeitsbereiche: Vertrieb, Marketing, Personal, Investor Relations, Forschung und Entwicklung, Recht und Versicherungen, Mergers und Acquisitions, Operations

#### **Herr Stephan Schulak, Dipl.-Betriebswirt FH, Rohrbach (Mitglied des Vorstands)**

Zuständigkeitsbereiche: Finanzen, Informatik, Risikomanagement

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als kurzfristige variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert. Eine nachträgliche Änderung der definierten Ziele ist ausgeschlossen.

Die Bezüge bestehen zudem aus einer variablen Vergütungskomponente mit langfristiger, renditeorientierter Anreizwirkung in Form eines Stock Option Plans.

Die Gesamtbarvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr EUR 556.723 und bestand ausschließlich aus fixen Bestandteilen (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und der Leasingraten für den Firmenwagen).

Für den Jahresbonus des Vorstandes wurde im Geschäftsjahr 2003 eine Rückstellung von EUR 63.349 gebildet.

Zudem wurden an die Mitglieder des Vorstands jeweils 40.000 Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft ausgegeben. Der Marktwert pro Option betrug bei Ausgabe EUR 1,2490.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

|                | Dr. Franz Richter | Stephan Schulak |
|----------------|-------------------|-----------------|
| Barvergütung   |                   |                 |
| Fixum          | 330.090           | 226.633         |
| Erfolgsbezogen | 38.348            | 25.001          |
| <b>Summe</b>   | <b>368.438</b>    | <b>251.634</b>  |
| Aktienoptionen |                   |                 |
| Anzahl         | 40.000            | 40.000          |
| Ausübungspreis | 1,11              | 1,11            |

Weiterhin wurden aufgrund der in 1999, 2000, 2001 und 2003 an Vorstände gewährten Optionen TEUR 313 als Personalaufwand in der Holding erfasst. Es erfolgten hieraus aber keinerlei Zahlungen an die Vorstände.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von TEUR 20.

**ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

**Aufsichtsrat**

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2003:

**Dr. Winfried Süß, München, Aufsichtsratsvorsitzender**

weitere Mandate:  
ISiT, Itzehoe, (Kurator)

**Thomas Schlytter-Henrichsen, Kronberg/Taunus, Geschäftsführer, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender**

**Horst Görtz, Neu-Anspach, Kaufmann**

weitere Mandate:  
Ultimaco Safeware AG, Oberursel (Aufsichtsratsvorsitzender)  
GITS AG, Bochum (Aufsichtsratsvorsitzender)

**Prof. Dr. Anton Heuberger, München, Professor an der TU CAU Kiel**

weitere Mandate:  
West Steag Partners AG, Essen (Mitglied im Beirat)  
IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)  
MicroParts Gesellschaft für Mikrostrukturtechnik mbH, Karlsruhe (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Solid Energy, Itzehoe (Mitglied im Beirat)  
Sensor Dynamics, Graz, Österreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

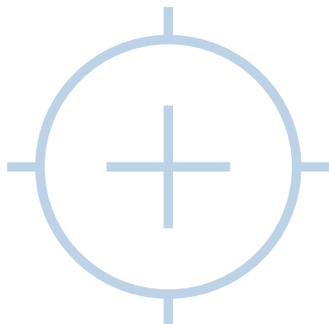
**Dr. Christoph Schücking, Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar**

weitere Mandate:  
Lambda Physik AG, Göttingen (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M. (Mitglied im Gesellschafterausschuss)  
Kennametal Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Freudenberg & Co., Weinheim/Bergstraße (Mitglied im Gesellschafterausschuss)

**Dr. Thomas Sesselmann, Tittmoning, Geschäftsführer**

weitere Mandate:  
Heidenhain Holding Inc., Wilmington, DE., USA (Mitglied Board of Directors)  
Heidenhain Holding K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)  
Heidenhain K.K., Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)  
SUMTAK Corporation, Tokio, Japan (Mitglied Board of Directors)  
ACURITE Inc., Jamestown, NY., USA (Mitglied Board of Directors)

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr insgesamt EUR 42.182. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates verzichtete auf seine Bezüge. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten je EUR 7.669 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates erhielt EUR 11.504.



### Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum 31. Dezember 2003:

|                             | Aktien    | Optionen |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Dr. Franz Richter           | 400.000   | 105.000  |
| Stephan Schulak             | 0         | 40.286   |
| Dr. Winfried Süß            | 1.025.000 | 0        |
| Thomas Schlytter-Henrichsen | 6.909     | 0        |
| Horst Görtz                 | 3.894     | 0        |
| Prof.Dr. Anton Heuberger    | 0         | 0        |
| Dr. Christoph Schücking     | 500       | 0        |
| Dr. Thomas Sesselmann       | 0         | 0        |

### Angaben nach Ziffer 6.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex

Am 23. Januar 2003 hat Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 7.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 2,75 je Aktie erworben.

Am 24. Januar 2003 hat Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 13.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 2,76 je Aktie erworben.

Am 9. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 4.500 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 1,60 je Aktie erworben.

Am 9. April 2003 hat Frau Maritta Süß, die Frau des Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Winfried Süß, 5.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 1,75 je Aktie erworben.

Am 10. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 20.500 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 1,75 je Aktie erworben.

Am 11. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 10.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 1,94 je Aktie erworben.

Am 14. April 2003 hat Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 10.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 1,985 je Aktie erworben.

Am 7. November 2003 gab Herr Dr. Winfried Süß, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 79.780 Aktien der Gesellschaft, die fälschlicherweise seinem Depot zugeschrieben wurden, zurück an seine Ehefrau.

### VI.6 Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 737 Mitarbeiter (2002: 941 Mitarbeiter) in der SÜSS MicroTec-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

|                        | 2003       | 2002       |
|------------------------|------------|------------|
| Verwaltung             | 104        | 136        |
| Marketing und Vertrieb | 236        | 262        |
| Produktion und Technik | 376        | 480        |
| <b>Summe</b>           | <b>716</b> | <b>878</b> |

| **ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
ZUM 31. DEZEMBER 2003**

In den at equity einbezogenen Gesellschaften waren durchschnittlich Mitarbeiter 15 (2002: 19 Mitarbeiter) tätig.

**Corporate Governance**

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben die nach §161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 4. Juli 2003) im Oktober 2003 abgegeben und im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

**Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG**

Julius Bär Asset Management & Investment Funds, Zürich, Schweiz, hat der Gesellschaft am 11. September 2003 gem. § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 15b Abs. 2 AuslInvG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil des Julius Baer Multistock, Luxemburg, die Schwelle von 5% überschritten hat und 5,16% (entspricht 771.705 Stammaktien) beträgt.

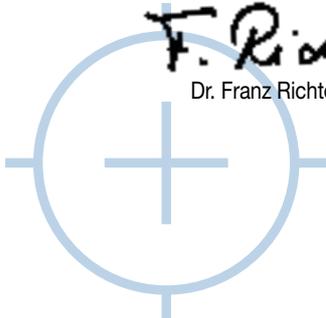
Die Capital Group Companies, Los Angeles, USA, hat der Gesellschaft am 25. März 2003 mitgeteilt, dass die Schwelle von 5% unterschritten wurde und ihr Stimmrechtsanteil 4,85% (entspricht 724.695 Stammaktien) beträgt.

Die Nobel S.A., Paris, Frankreich, hat der Gesellschaft am 22. Januar 2003 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil 5,08% (entspricht 760.000 Stammaktien) beträgt.

Garching, 15. März 2004  
Der Vorstand

  
Dr. Franz Richter

  
Stephan Schulak



| **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben die von der SÜSS MicroTec AG aufgestellte konsolidierte Bilanz und die zugehörige konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung sowie Anhangangaben (Konzernabschluss) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles-US-GAAP) liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den US-GAAP entspricht.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung stellt der oben genannte Konzernabschluss die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2003 sowie dessen Ertragslage und Zahlungsströme für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 in Übereinstimmung mit den US-GAAP in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

Unsere Prüfung, die sich auch auf den vom Vorstand aufgestellten, mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zusammengefassten, Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht zusammen mit den übrigen Angaben des Konzernabschlusses insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen.

München, den 16. März 2004

**PRICEWATERHOUSECOOPERS**

GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Krawietz)                      (Eichler)  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

**SÜSS MicroTec AG**

Schleissheimer Strasse 90  
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-0  
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: [ir@suss.de](mailto:ir@suss.de)

[www.suss.de](http://www.suss.de)